

股票代碼：2311
NYSE：ASX

日月光半導體製造股份有限公司
九十二年度年報

日月光集團

本年報可於以下網址查詢：公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/　本公司網站 http://www.aseglobal.com　中華民國九十三年三月二十六日刊印

本公司發言人

張洪本□ 職稱：副董事長兼總經理

代理發言人

董宏思□ 職稱：財務副總

劉詩亮□ 職稱：財務處長

電話：(02) 87805489

電子郵件信箱：stock@aseglobal.com

總公司

地址：高雄市楠梓加工出口區經三路26號

電話：(07) 3617131~8　　傳真：(07) 3613094, 3614546

台北辦公室

地址：台北市基隆路一段333號19樓1901室

電話：(02) 87805489　　傳真：(02) 27576121

公司網址：http://www.aseglobal.com

工廠地址（電話：07-3617131）

一廠：高雄市楠梓加工出口區經三路26號

二廠：高雄市楠梓加工出口區經六路66號7樓, 8樓, 9樓及10樓

三廠：高雄市楠梓加工出口區開發路47號2樓

四廠：高雄市楠梓加工出口區開發路47號3樓

五廠：高雄市楠梓加工出口區經六路66號4樓, 5樓及6樓

六廠：高雄市楠梓加工出口區開發路47號1樓及4樓

七廠：高雄市楠梓加工出口區經六路66號2樓及3樓

八廠：高雄市楠梓加工出口區開發路25號

九廠：高雄市楠梓加工出口區內環北路109號8樓

十廠：高雄市楠梓加工出口區內環北路109號10樓

凸晶一廠：高雄市楠梓加工出口區經六路66號1樓

凸晶二廠：高雄市楠梓加工出口區內環北路109號5樓及6樓

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區東興路8號地下一樓

電話：(02) 27463797

網址：http://www.pscnet.com.tw

最近年度簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信會計師事務所

（原勤業會計師事務所於92年6月1日與眾信聯合會計師事務所
共同組設勤業眾信會計師事務所）

會計師姓名：曾光敏會計師、陳政弘會計師

地址：高雄市中正四路168號7樓

電話：(07) 2514311

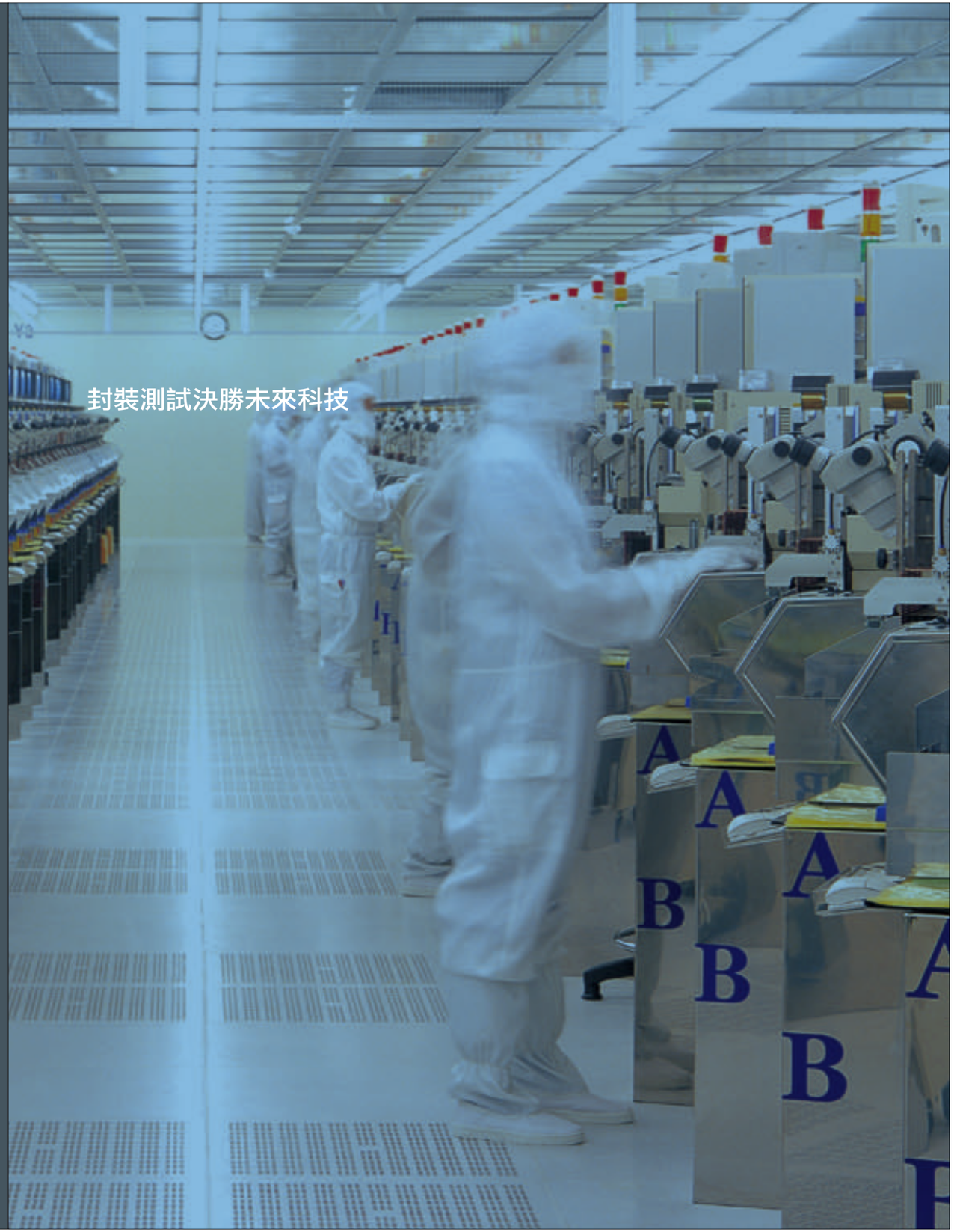
網址：http://www.deloitte.com.tw

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所（NYSE）

查詢該海外有價證券資訊之方式

http://www.aseglobal.com



目 次

II 封裝測試決勝未來科技

V 晶圓凸塊與覆晶封裝

VI 細間距銲線封裝

VII 綠色環保封裝

VIII 系統級封裝

IX 影像感測器模組封裝

X 致股東報告書

XII 經營摘要

XV 九十二年度年報

封裝測試
決勝未來科技

市場上琳瑯滿目的智慧型電子產品，無論是小巧輕盈的可照相手機、筆記型電腦、PDA、隨身碟、高畫素數位相機等，其多樣化的功能及輕薄短小的特性為現代人的生活帶來無限便利與樂趣。其中影像感測器、高效能的電腦處理器、每秒傳輸速度高達gigabyte的網際網路連線裝置、無線通訊設備，以及具備生物辨識技術的智慧型車主身份辨識系統等，都是從前無法想像的科技應用。而這些迅速茁壯的革命性科技產品，皆由技術日益精湛的半導體製造服務所成就。

電子產品的革命性應用與快速世代交替，讓晶片相關業者持續推出具備更多新型晶片與技術。而半導體市場的整體趨勢，上中下游的技術發展息息相關；晶圓製程在短短五、六年內從0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米，發展到目前的90奈米製程，讓晶片的功能日益提升；而緊接上游晶圓製造的晶片封裝測試技術也在製程技術上與供應鍊的前端技術同步並進，從早期的低腳數引腳封裝技術發展至今天的球型閘陣列封裝（BGA）、覆晶封裝，以及晶圓級封裝等高階封裝，不斷創新與精進的製程賦予電子元件及系統突破性的發展。

然而，每種新元件及系統技術問世，都為晶片測試技術帶來更多挑戰。從20 Mhz時脈速度的測試技術，發展到目前時脈速度高達GHz、高腳數，以及高整合度元件測試，皆能迎合晶片應用層面的種種嚴峻要求。

二十年來，日月光均以前瞻性的發展與投資策略，因應快速成長的半導體市場趨勢，執晶片封裝測試技術之牛耳，領先推出各種創新技術和採用最新型的設備，為客戶提供高附加價值、彈性及成本優勢的高品質半導體製造服務，成就各種尖端科技產品，讓客戶的新產品以最短的時程上市。

封裝測試技術先驅

在電子產品輕薄短小的趨勢下，更快速的資料處理能力、多樣化的功能，都有賴於日益精湛的晶片技術——一顆晶片包含愈來愈多功能。為滿足市場在這方面的需求，日月光不斷發展關鍵的晶片封裝技術並改進相關製程，藉此提升晶片的效能，如細間距銲線封裝（Fine Pitch Bonding）、晶圓凸塊（Wafer Bumping）與覆晶封裝（Flip Chip Packaging）、系統級封裝（System-in-Package）、影像感測器模組封裝（Image Sensor Modules）、綠色環保封裝（Green Packaging）等先進技術，都是造就新穎智慧型電子產品的推手。

而作為全球最大專業半導體封測廠商，日月光更致力滿足客戶的晶片從原型開發階段一直到封裝階段及成品測試之多元化需求。我們提供邏輯／混合訊號以及記憶體元件各種測試服務，涵蓋GHz級的數位晶片，甚至是業界最高標準的射頻（RF）高階元件。

整合型解決方案

高科技產業是一個講求產品快速上市的產業，那家公司的產品能成功搶先上市就是贏家，也能取得最大的市場利機。日月光勝於提供一套整合型的後段製程解決方案，讓客戶節省寶貴的時間、資源和成本。我們與客戶的合作關係始於提供基板（封裝材料）設計與製造服務、晶圓針測、晶圓凸塊、晶片封裝、成品測試、到最後將成品運送給最終客戶的一元化後段製造服務。

前瞻性策略決策

基板 — 供應鍊中具高附加價值的決勝關鍵

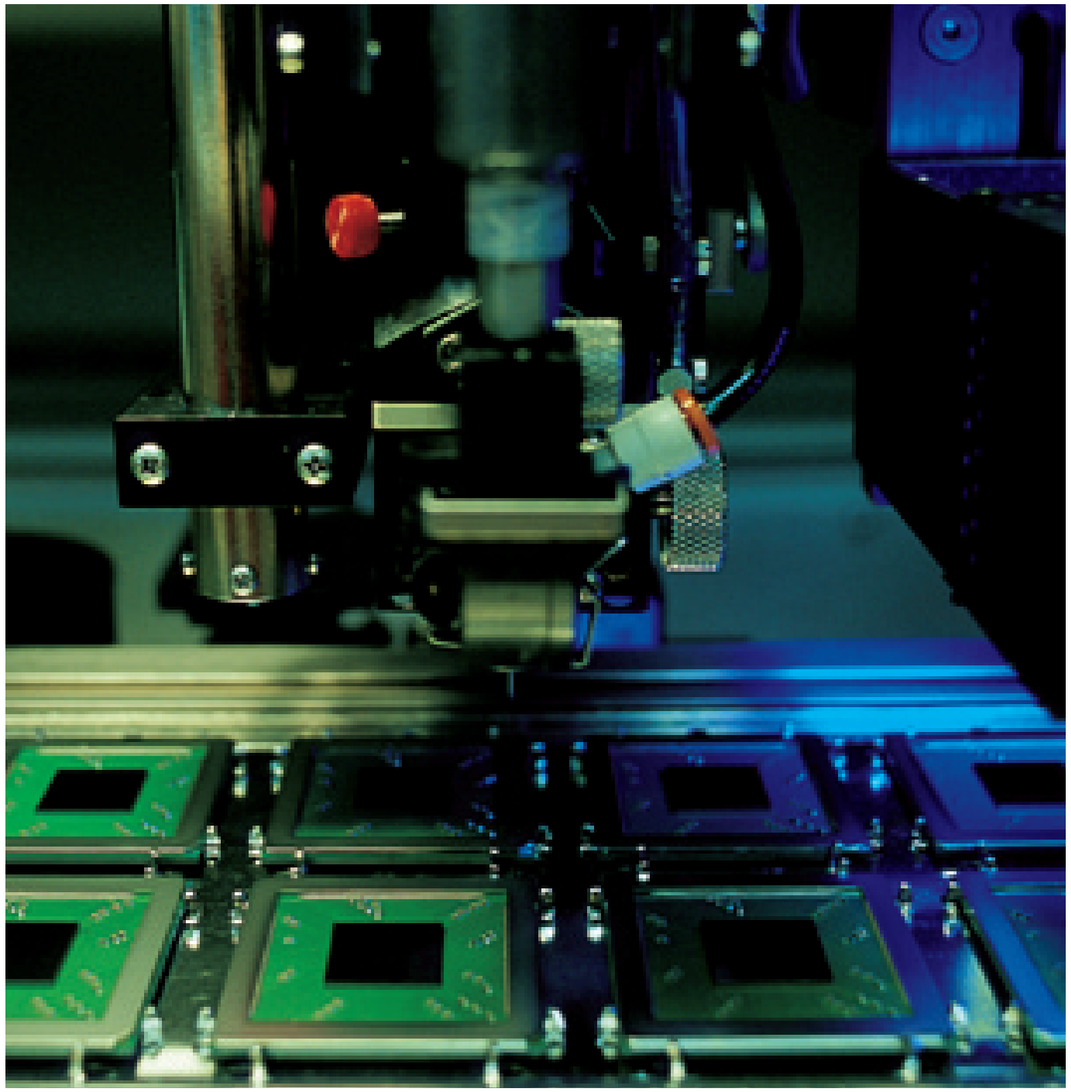
掌握基板的來源是高階晶片封裝製程中一項關鍵，而及時與充裕的基板供應更是加速製程的必備條件。日月光洞悉將基板設計與製造整合於供應鏈的價值及重要性，在2003年10月與台灣最大基板製造商華通電腦合資成立基板廠並成為策略聯盟的夥伴。此舉不但有效解決了高階球型陣列封裝（BGA）基板產能吃緊的問題，讓日月光掌握了覆晶封裝基板技術及產能等關鍵要素，更能大幅提升產能，滿足後段製程對於整合型解決方案持續成長的需求。在不久的未來，基板的自給率，將成為客戶選擇半導體製造服務夥伴的一項重要考量因素。毫無疑問，日月光在這方面擁有絕對的領先優勢。

擴展日本市場版圖

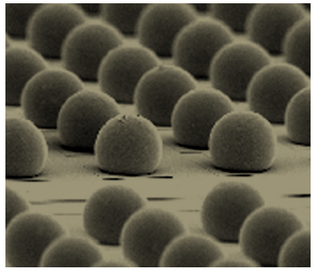
相較於其他市場，日本在封裝與測試產業中仍是開放程度較低的委外代工市場。然而，隨著許多日本大廠逐漸發現委外代工是在全球市場競爭的致勝要素，讓原本的市場生態開始產生轉變。為了在日本建立穩固的營運平台，日月光與NEC在今年初成為策略聯盟夥伴，並併購NEC位於日本山形縣的封測廠。此舉讓我們有效地協助日本半導體廠商降低整體製造成本，並提升生產效率。目前，我們將日本山形縣的世界級廠房在品管、製程技術，以及整體生產效率方面作為標竿，並將進一步擴充營運規模，以爭取日本市場持續成長的半導體製造服務委外的商機。

鞏固的夥伴關係

日月光長久以來視深耕客戶關係與供應商關係同樣重要：我們與晶圓製造夥伴、設備與材料供應商保持緊密的合作關係，確保我們的製程技術能符合客戶對晶片功能與規格的需求，以及與各種上、中、下游的先進製程技術之發展同步並進。日月光與全球最大晶圓廠台積電的合作關係，就是最好的例證，讓我們的晶片封裝技術能迎合0.13微米、90奈米到65奈米晶圓製程的發展腳步。此外，我們與安捷倫、蔚華科技、LTX、恩浦科技，以及Teradyne等頂尖測試儀器供應商建立雙贏的夥伴關係，提供我們各種測試高效能晶片最佳的平台與工具。透過這些策略聯盟的關係，日月光充盈的產能可為客戶在半導體製造需求快速膨脹之際，提供高度的彈性空間。



晶圓凸塊與覆晶封裝

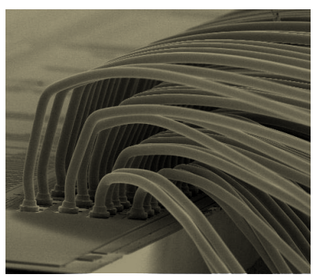


覆晶封裝是現今市場上最先進的封裝製程之一。日月光透過與3C產業的客戶同共研發，在開發覆晶封裝技術上取得領先地位。自2000年，日月光已為客戶提供超過2,000萬組覆晶球型閘陣列（Flip Chip BGA）元件。另外，日月光在覆晶封裝中的關鍵製程——晶圓凸塊技術方面，也擁有完整的六吋／八吋／十二吋晶圓凸塊技術及產能，加上在基板設計與製造及測試方面的高品質服務，為客戶提供完整的一元化覆晶封裝解決方案。我們仍積極擴充覆晶與晶圓凸塊的產能，以迎合迅速成長的高階封測市場需求。

< 晶圓凸塊



細間距銲線封裝



細間距銲線接合是一種連接晶粒與封裝體的傳統封裝方法，目前在日月光的封裝產能中屬主流封裝技術。日月光擁有業界最大的銲線技術產能，銲線機數量超過5,000台，而銲線接合設備的各種創新設計，讓日月光為客戶提供更高腳數的產品，並大幅提高打線的速度。日月光的研發團隊已開發多種打線製程，其2層、3層、4層鋁墊內層細間距打線技術已通過客戶之認證，為客戶提供更多提升晶片效能之技術。為迎合未來客戶多元化的產品需求，我們已大量投資於目前最先進之銲線機，提供45微米內層細間距銲線服務。日月光的研發團隊擁有完整成熟的技術開發經驗，並與業界頂尖設備供應商通力合作，持續建立日月光在先進封裝測試領域之領導地位。

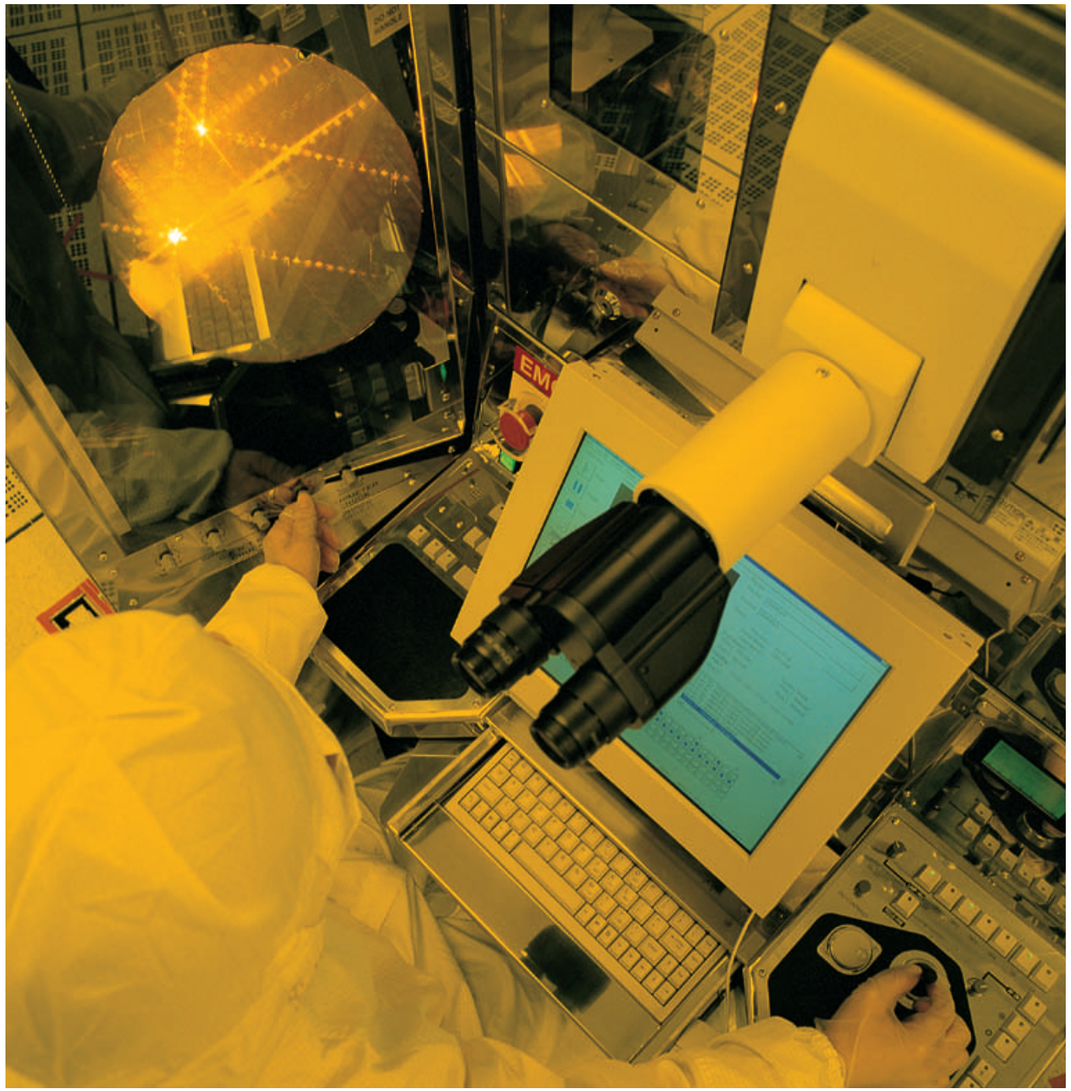
< 四層鋁墊細間距銲線技術

綠色環保封裝

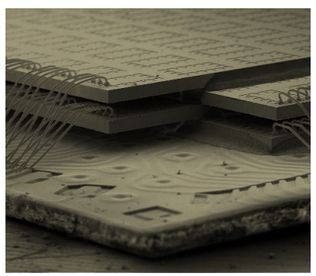


降低電子產品中鉛金屬含量的壓力來自於環保與法令的層面，並促使位處電子產業供應鍊上游的半導體廠商積極發展無鉛製程。日月光在過去數年一直努力為全系列產品開發各種無鉛與綠色環保封裝解決方案。目前，日月光提供多種無鉛封裝產品及解決方案，均符合業界嚴苛的標準。我們致力於2004年底，為客戶提供全系列無鉛與綠色環保封裝製程及產品。

< 日月光綠色環保封裝



系統級封裝

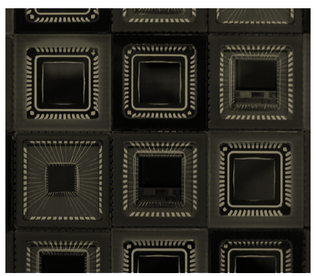


系統級封裝（SiP）發展至今，已被業界視為系統單晶片（SoC）的最佳替代方法，透過SiP可以將晶片、被動元件，以及系統中的其他元件整合在單一封裝模組中，以建立一套完整的系統功能組合。日月光在開發系統級封裝的多層晶片堆疊式封裝、多個晶片封裝，以及多重晶片模組封裝等領域，已累積超過4年的經驗。而日月光在晶圓薄化技術方面擁有成熟的技術與完善的設備，因此在晶片堆疊和維持最薄封裝體方面，均有絕佳的優勢。

< 四層晶片三明治式堆疊封裝



影像感測器模組封裝



具備照相功能的行動電話、個人電腦和PDA，以及數位相機／攝錄影機等產品，都是目前3C市場中炙手可熱的商品。這些內建影像感測器模組的酷炫電子商品能擷取栩栩如生的影像，同時也是推動影像感測器晶片技術發展的驅動力。日月光為全球多家影像感測器模組大廠提供完整的一元化封裝測試服務，而專門負責影像感測器封裝製程的生產線均維持極高水準的生產規格和環境控制，以配合影像感測器晶片對落塵度極為敏感的特性。

< 影像感測器晶片

致股東報告書

各位股東：

2003年半導體產業逐漸走出不景氣的陰霾，而日月光集團也在產業景氣復甦的帶動下，創造了全年合併營業額達到573億台幣，比2002年成長26%，並超越最大競爭對手，成為全球第一大專業封測廠。我們在此與長期支持日月光的股東們與全體同仁分享這令人雀躍的成就。

日月光半導體在過去不景氣的三年利用競爭對手無力擴充之際，憑著我們健全的財務結構，積極進行策略佈局與強化體質，不論在技術研發、專業人員培養和產能方面皆大幅提昇，於2003年總投資額超過4億2千萬美元，讓我們引以為傲的「一元化服務」──從前端的晶圓針測、基板設計及製造、封裝、成品測試到系統組裝更為完善，而我們在業界中最大規模的先進產能，更可有效因應未來各地區及各應用領域及不同性質客戶的多元需求與成長。

根據市場分析機構迪訊（Dataquest）資料顯示，由於繪圖晶片、網路通訊晶片、晶片組等高階產品大多已趨於採用覆晶封裝，因此2004年將是覆晶封裝需求勁量成長的一年。日月光在晶圓凸塊、覆晶封裝及其關鍵材料覆晶基板等方面，已擁有成熟的製程技術及高良率的出貨量，對於搶攻這塊高利潤的高階封裝市場具備絕對優勢。在過去一年，日月光除了透過子公司日月宏科技股份有限公司積極擴充廠房和生產線外，更於去年10月與台灣最大基板製造商華通電腦股份有限公司合資成立基板廠並成為策略聯盟的夥伴。此舉不但有效解決了高階球型陣列封裝（BGA）基板產能不足的問題，更讓日月光掌握了覆晶封裝基板技術及產能等關鍵要素。由於封裝技術的演進，封裝產業的成本結構也將有所質變，未來專業封裝廠的獲利能力，將取決於基板的自給率、良率及獲利率，公司自去年下半年以來，隨著基板自給率不斷的提高和良率的提昇，連帶也使得公司整體毛利大幅上揚，便是最好的例證。此外，日月光不斷提昇如晶圓級封裝（WLCSP）、多晶片模組封裝（MCM）、系統級封裝（SIP）等高階封測技術；同時日月光也提供因應環保需求的無鉛（Lead-free）封裝服務，以因應美國、歐洲及日本等主要市場對於環保電子產品的需求。而為了透過經濟規模的模式以降低營運成本，日月光更積極進行集團內資源的整合，透過合併子公司日月欣半導體股份有限公司與日月宏科技股份有限公司，有效提供客戶具經濟效益的完整半導體後段一元化服務解決方案。

展望2004年，全球的電子消費性產品、個人電腦、網路通訊等相關晶片需求，以及國際IDM大廠（整合元件製造廠）委外代工的趨勢持續上揚，專業封測產業持續整合，封裝技術也正面臨結構性的變化，日月光集團以積極策略來擴大我們的競爭優勢：

鞏固市場，再擴版圖

日月光憑著領先業界的封測與製程技術、完整的一元化半導體後段服務，成功贏得歐美地區主要IDM大廠及IC設計公司的委外訂單。將來我們更有信心以高品質製程服務及多元的技術加強彼此的合作關係。此外，日月光為了爭取日本客源，亦在今年（2004年）初與NEC成立策略聯盟，同時並與NEC簽約併購其位於日本山形縣的封測廠，未來將是日月光擴展日系IDM大廠業務的重要營運平台。

不斷擴充，持續領先

在過去幾年，日月光無畏產業的不景氣，以前瞻性的策略進行水平與垂直整合，並積極投資技術研發與擴充高階封測產能。另外，有鑒於封裝基板市場的成長潛力及其在高階封裝上的重要性，結合集團內日月宏及日月光華通公司在BGA基板及覆晶基板之技術與產能，將可提供比競爭對手成本較低的封裝材料。我們深信掌握了這項高階封裝的關鍵，日月光無論在商機的爭取及獲利的提昇，將擁有大幅超越同業的競爭優勢。在產能方面，今年相繼投入生產的高雄廠區及中壢廠區的新廠房，將可提供未來數年集團在台灣的成長，更鞏固我們在業界領導者的地位。

加強研發，降低成本

在先進技術研發方面，日月光持續加碼投資覆晶封裝測試及相關基板技術之研發，發展最佳化的一元化覆晶封裝服務：在無鉛與綠色封裝技術方面，日月光也擬定於2004年全面進入綠色製程之目標，持續加強新產品、新技術與新材料的導入，提供具成本效益及多元化的環保製程解決方案，以更多的附加價值滿足客戶在產品、價格以及品質上更多的需求。

基於集團資源分配的整體考量下，日月光重新分配全球各廠區的主力產品，其中台灣高雄及中壢廠主力發展如晶圓凸塊、覆晶封裝及高階BGA封裝等高階封測技術產品、韓國廠主攻射頻（RF）與影像感測器晶片封裝，而馬來西亞廠則將針對模組及低腳數產品作重點發展。藉由各廠區區域與技術優勢的發揮，以節省營運成本，發揮綜效以提升整體的價值貢獻。

日月光集團多年來一直朝向建立一個完整的資訊產品專業代工服務體系，提供客戶高附加價值的服務，為一直支持我們的股東和員工創造最大的利益。感謝各位員工過去一年來的辛勤付出，更感謝各位股東長久以來對公司的支持。在未來的日子裡，日月光將以最佳的團隊、尖端的技術及服務、最具彈性的產能，創造最佳的營收及獲利，與各位股東及員工共同邁向豐碩的2004年。

董事長 張虔生



副董事長 張洪本

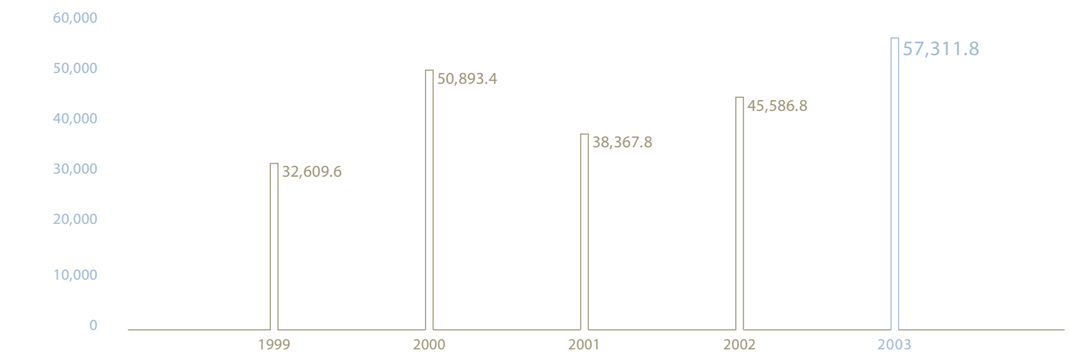
經營摘要

經營摘要（含聯屬公司）	1999	2000	2001	2002	2003
營業淨收入	32,609.6	50,893.4	38,367.8	45,586.8	57,311.8
營業毛利	8,650.0	15,326.1	5,410.8	7,094.6	10,845.3
營業利益	4,848.6	9,877.1	(462.1)	(685.2)	3,270.5
稅前淨利	9,062.4	8,403.6	(2,985.5)	(2,709.7)	1,487.7
稅後淨利	7,794.7	5,837.2	(2,142.2)	129.0	2,742.8
每股盈餘（元／股，追溯調整後之稀釋每股盈餘）	2.23	1.64	(0.60)	0.04	0.78
股票股利（元／股）	3.15	1.70	---	1.00	註
固定資產淨額	38,107.5	60,566.2	60,555.1	63,088.9	67,339.9
股東權益淨額	30,057.0	43,669.2	41,946.3	39,430.7	45,122.6
資產總額	77,330.8	108,341.2	106,326.3	104,869.4	114,324.2
員工總數（人）	14,184	18,121	15,681	20,401	24,443
日月光總市值	221,760.0	60,268.8	105,781.0	66,397.9	124,951.8

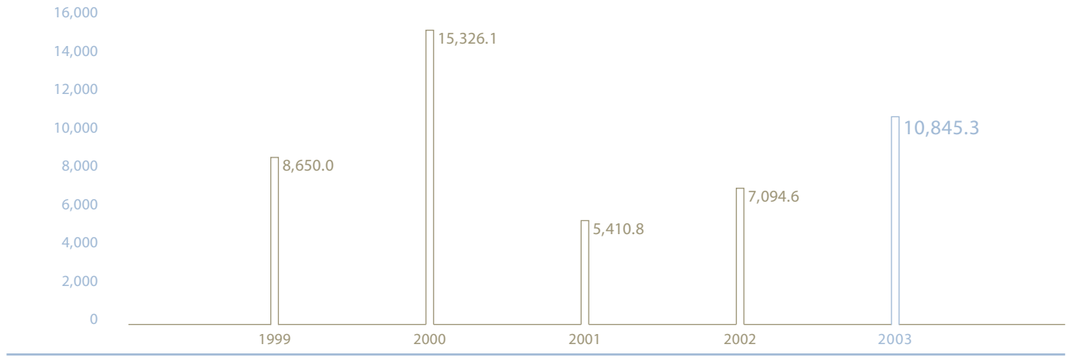
註：俟股東會決議後定案。

單位：新台幣百萬元

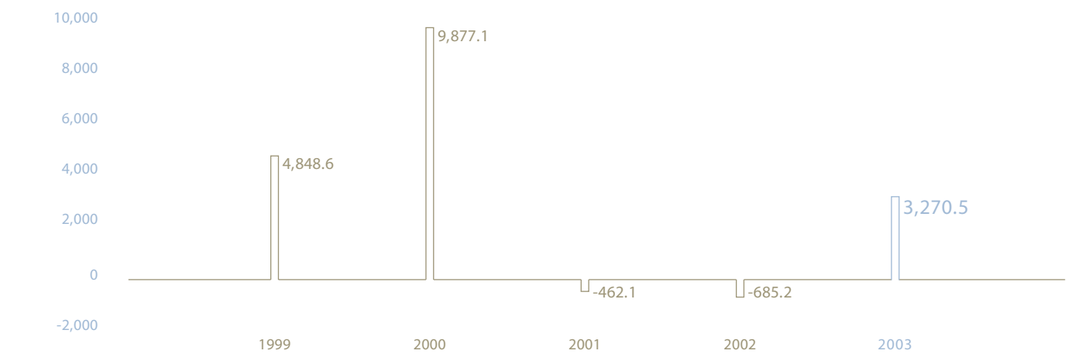
歷年營業淨收入（單位：新台幣百萬元）



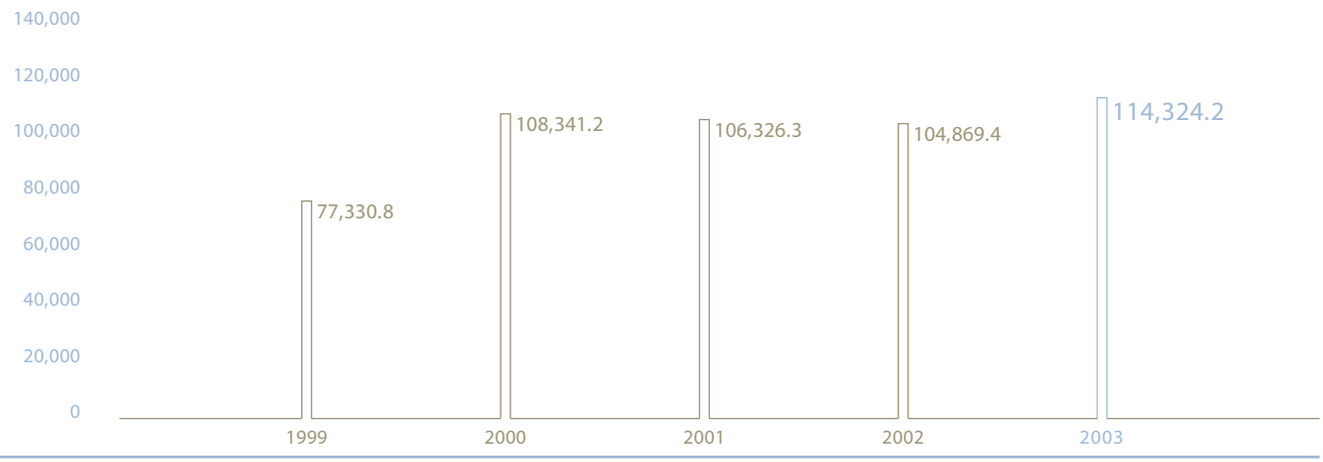
歷年營業毛利（單位：新台幣百萬元）



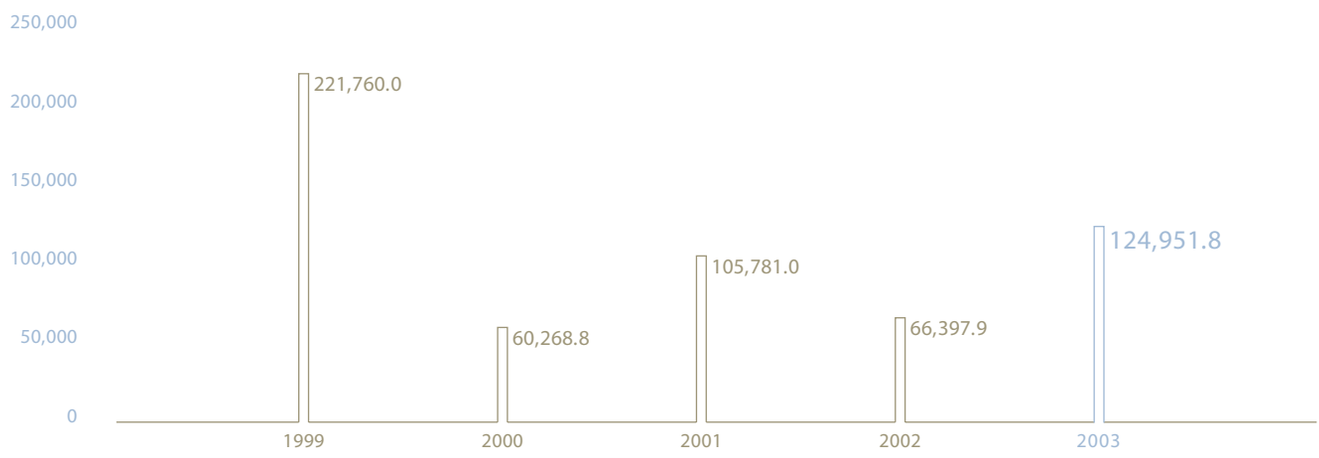
歷年營業利益（單位：新台幣百萬元）



歷年資產總額（單位：新台幣百萬元）



歷年日月光總市值（單位：新台幣百萬元）



九十二年度年報

X **壹. 致股東報告書暨經營摘要**

貳. 公司概況

2 一、公司簡介
4 二、公司組織
10 三、資本及股份
15 四、公司債辦理情形
17 五、特別股辦理情形
17 六、海外存託憑證辦理情形
18 七、員工認股權憑證辦理情形
19 八、併購或受讓他公司股份發行新股理辦理情形

參. 營運概況

20 一、業務內容
23 二、市場及產銷概況
29 三、組織人力現況
29 四、環保支出資訊
31 五、勞資關係
32 六、重要契約
32 七、訴訟或非訟事件
33 八、取得或處分資產

34 **肆. 資金運用計劃執行情形**

伍. 財務資料

35 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表
36 二、財務分析
38 三、監察人審查報告書
39 四、最近年度財務報表，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表
87 五、最近年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表
96 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事
96 七、列示最近二年度財務預測達成情形，說明原預測數〔含歷次更新（正）日期、更新（正）金額及更新（正）原因〕與實際達成數差異原因及經臺灣證券交易所股份有限公司及證期會處罰者，應說明處罰原因

陸. 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

97 一、財務狀況比較分析
97 二、經營結果比較分析
98 三、現金流量分析
98 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
98 五、最近年度轉投資政策
99 六、風險管理之分析評估
100 七、其他重要事項

101 **柒. 上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因**

捌. 特別記載事項

102 一、關係企業相關資料
118 二、內部控制制度執行狀況
118 三、最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見
118 四、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形
119 五、最近年度及截至年報刊印日止子公司取得及處分本公司股票之情形及其設定質權之情形
119 六、最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議
121 七、最近年度及截至年報刊印日止，公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形
121 八、其他必要補充說明事項

122 **玖. 其他事項**

貳. 公司概況

一. 公司簡介

(一) 設立日期：民國七十三年三月二十三日

(二) 公司沿革

本公司之創立係由歸國學人張虔生及張洪本等基於工業報國之精神，並配合政府發展高科技政策，以現金及專門技術作價集資所創建，所營事業為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售等。

本公司記事如下：

73年03月	公司正式成立。
73年07月	工廠開工。
73年08月	塑膠立體型積體電路（PDIP），開始外銷歐美及日本。
74年02月	陶瓷立體型積體電路（CDIP），開始外銷日本及歐美。
74年10月	高品質塑膠晶粒承載器積體電路（PLCC）開始外銷美國。
76年05月	高品質多腳型針格排列積體電路（PGA）及塑膠多腳型針格排列積體電路（PPGA）開始外銷歐美。
78年07月	經台灣證券交易所（78）上字第4461號函核覆股權分散符合標準，並於7月19日正式在台灣證券交易所上市掛牌買賣。
79年03月	收購台灣福雷電子股份有限公司股權百分之九十九點九，計支付價金新台幣105,006,183元，以併購方式進入半導體測試業務市場。
80年03月	轉投資設立日月光電子（馬來西亞）股份有限公司，從事各型積體電路之製造、加工、組合、測試及外銷，另轉投資設立日月光半導體貿易（香港）股份有限公司，以便利轉接海外（馬來西亞）生產基地訂單及服務客戶。
80年06月	轉投資設立日月冠股份有限公司，以研究開發產製筆記型電腦等可攜帶型各種電子器材。
80年08月	新產品平面型塑膠晶粒承載器積體電路（EQFP）開始量產。
80年11月	本公司產品榮獲MOTOROLA公司頒發品質優良獎（Award of Excellence for Quality）。
81年04月	榮獲國際標準組織（ISO 9002）品質認證合格。
84年07月	在亞洲、美國及歐洲等地發行海外存託憑證8,600千單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行43,000千股，每股面額10元，售價每單位美金15.25元溢價發行，募集資金折合新台幣33.9億元。
85年06月	本公司之子公司「ASE TEST LIMITED」在美國NASDAQ證券市場掛牌買賣。
86年09月	本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債（Euro Convertible Bond）。
86年11月	通過SAC（Semiconductor Assembly Council）認證。
87年01月	本公司之子公司新加坡福雷電子公司（ASE Test Limited）以1,500,000股普通股發行120,000,000單位之台灣存託憑證（TDR），並於台灣證券交易所掛牌買賣。
87年03月	榮獲國際標準組織（QS 9000）品質認證合格。
87年09月	榮獲ISO14001環境品質認證合格。

88年03月　本公司之子公司新加坡福雷電子公司（ASE Test Limited）第二次以2,500,000股普通股發行台灣存託憑證（TDR），並於台灣證券交易所掛牌買賣。

88年05月　本公司之子公司新加坡福雷電子公司（ASE TEST LIMITED）收購ISE LAB七成股權。

88年07月　日月光集團收購摩托羅拉台灣中壢及南韓PAJU兩廠，藉此更能與摩托羅拉公司進行長期之策略聯盟，強化日月光集團垂直整合的力量，並可擴大產品涵蓋範圍。

88年02-07月　為提昇日月光集團電子專業代工之領域，進一步增加對客戶之服務項目，進而擴大客戶群，遂於88年度自集中交易市場買入環隆電氣股份有限公司股票，參與經營權，持股比率20.67%。

89年09月　為提昇本公司於全球半導體市場之競爭力，進而強化公司形象及國際知名度，於美國時間9月25日完成美國存託憑證（ADR）發行作業，本次發行數量計20,000,000單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行普通股100,000,000股面額10元，發行價格每單位美金7元，募集資金折合新台幣計43.8億元。

91年09月　榮獲『第十屆經濟部產業科技發展獎』傑出獎。

91年12月　本公司於91年8月經證期會核准發行160,000,000單位之員工認股權憑證，並於91年12月實際發行145,989,000單位，每單位認股權憑證得認購股數為本公司普通股1股。

92年07月　本公司合併持股100%之子公司日月新投資（股）公司及日月興投資（股）公司。

92年09月　本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債（Euro Convertible Bond）。

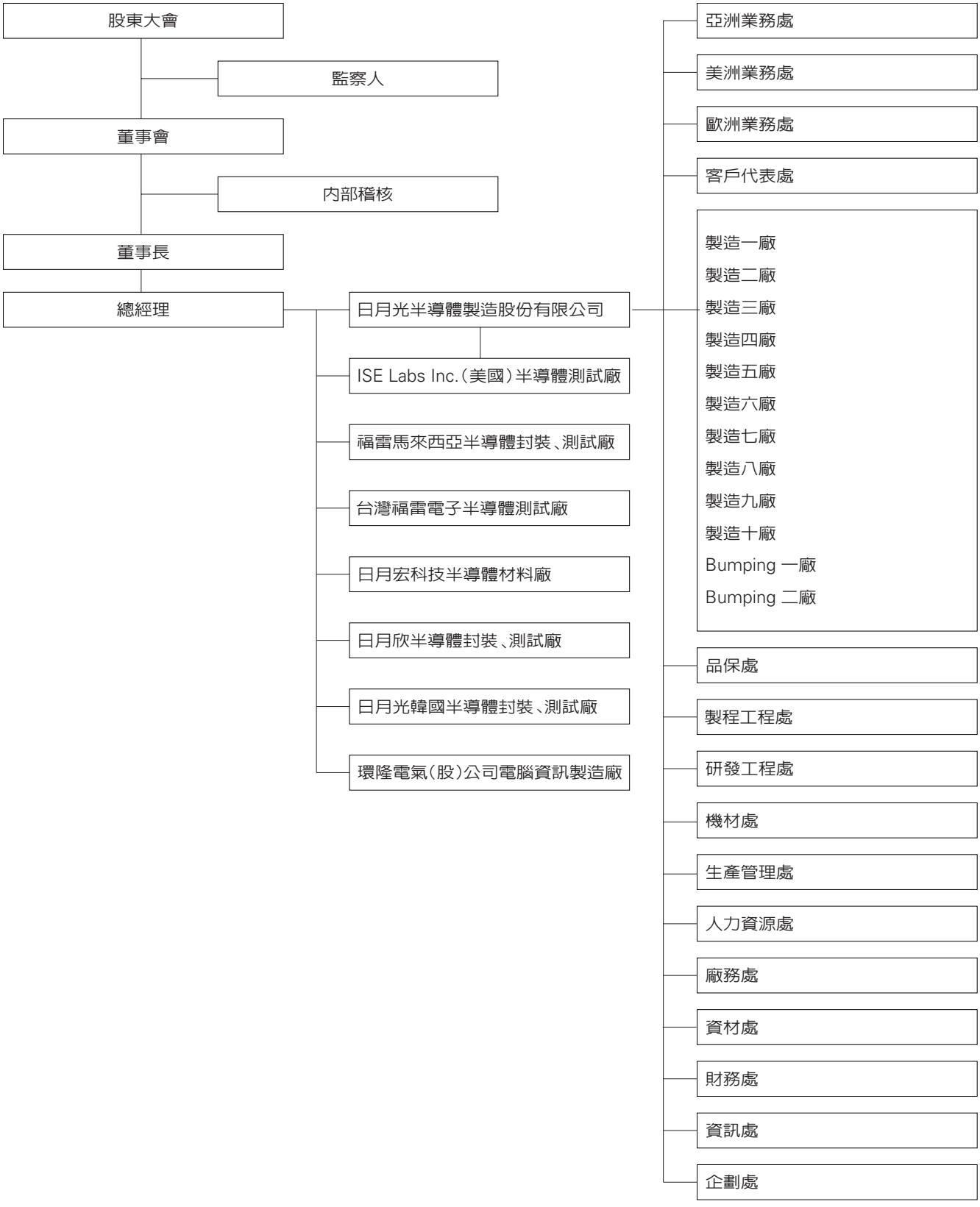
92年10月　本公司董事會決議合併子公司日月欣半導體股份有限公司與日月宏科技股份有限公司，換股比率訂為每1股日月欣半導體股份有限公司股份換發本公司股份0.85股，每1股日月宏科技股份有限公司股份換發本公司股份0.5股，本公司預計將發行282,315,437股以進行合併換股事宜。

93年01月　本公司與華通電腦股份有限公司合資成立日月光華通科技股份有限公司（IC基板公司）。

93年02月　日月光集團與NEC簽立股權買賣合約，將併購該公司位於山形縣之封裝測試廠。

二. 公司組織

（一）組織系統


股東大會
監察人
董事會
內部稽核
董事長
總經理
日月光半導體製造股份有限公司
ISE Labs Inc.（美國）半導體測試廠
福雷馬來西亞半導體封裝、測試廠
台灣福雷電子半導體測試廠
日月宏科技半導體材料廠
日月欣半導體封裝、測試廠
日月光韓國半導體封裝、測試廠
環隆電氣（股）公司電腦資訊製造廠
亞洲業務處
美洲業務處
歐洲業務處
客戶代表處
製造一廠
製造二廠
製造三廠
製造四廠
製造五廠
製造六廠
製造七廠
製造八廠
製造九廠
製造十廠
Bumping 一廠
Bumping 二廠
品保處
製程工程處
研發工程處
機材處
生產管理處
人力資源處
廠務處
資材處
財務處
資訊處
企劃處

主要部門所營業務

亞洲業務處：亞洲地區業務發展
美洲業務處：美洲地區業務發展
歐洲業務處：歐洲地區業務發展
客戶代表處：公司客戶服務及諮詢
製造廠：半導體封裝之代工
品保處：產品品質檢驗及品質確保
製程工程處：半導體封裝製程之管理、改進
研發工程處：先進技術研究發展
機材處：產品投料管理及控制
生產管理處：生產企劃及營運效率管理
人力資源處：人力資源管理及組織發展
廠務處：廠房及行政區環境保護、庶務管理及工安管制
資材處：採購、倉儲、進出口業務
財務處：財務及會計，包括資金管理、資產管理、成本與管理會計、租稅規劃及股務作業
資訊處：公司資訊系統建構、推動e化經營策略及系統服務
企劃處：整體營運規劃、策略管理與年度方針管理及廠房空間、用地規劃
內部稽核：內部政策、流程及標準稽核

（二）董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1. 董事及監察人資料

單位：股/新台幣仟元

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數（註1）		配偶、未成年子女現在持有股份（註1）		利用他人名義持有股份（註1）	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	張虔生	92.06.19	三年	73.03.11	20,254,843	0.62%	22,280,327	0.62%	–	–	–	–
副董事長	張洪本	92.06.19	三年	73.03.11	37,181,794	1.14%	40,899,973	1.14%	63,383,829	1.77%	–	–
董事	香港商微電子國際公司	92.06.19	三年	80.03.30	628,395,834	19.31%	691,235,417	19.31%	–	–	–	–
代表人	秦克儉											
	潘士華											
	董宏思											
	陳昌益											
	吳田玉											
監察人	馮美珍	90.06.01	三年	73.03.11	49,803,131	1.81%	63,383,829	1.77%	40,899,973	1.14%	–	–
監察人	香港商微電子國際公司	90.06.01	三年	84.04.11	545,339,602	19.82%	691,235,417	19.31%	–	–	–	–
代表人	何弘											
	羅瑞榮											
	鄭天正											
	曾元一											

職稱	姓名	主要經（學）歷	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			最近年度之酬勞及其他給付
			職稱	姓名	關係	
董事長	張虔生	台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	副董事長 監察人	張洪本 馮美珍	弟 弟之配偶	酬勞$190、汽車乙部$6,460
副董事長	張洪本	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣（股）公司董事長	董事長 監察人	張虔生 馮美珍	兄 配偶	酬勞$190、汽車乙部$6,652
董事	香港商微電子國際公司					酬勞$950
代表人	秦克儉	國立海洋大學輪機系畢 福華工程公司物料部經理 德記洋行發貨中心經理	–	–	–	汽車乙部$757
	潘士華	美國伊利諾州大學物理系畢 美國加州大學柏克萊分校物理博士	–	–	–	–
	董宏思	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	–	–	–	汽車乙部$1,840
	陳昌益	加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁 ASE Test Limited財務長	–	–	–	汽車乙部$2,476
	吳田玉	美國賓州大學應用機械博士	–	–	–	–
監察人	馮美珍	台灣大學經濟系畢	董事長	張虔生	配偶之兄	酬勞$190、汽車乙部$2,000
監察人	香港商微電子國際公司		副董事長	張洪本	配偶	酬勞$760
代表人	何弘	美國愛荷華大學企管碩士 美商花旗銀行經理	–	–	–	汽車乙部$2,476
	羅瑞榮	交通大學電子物理系畢	–	–	–	–
	鄭天正	中原大學工業工程學系畢	–	–	–	–
	曾元一	台灣大學土木系畢 亞洲理工學院系統工程碩士 泛亞工程公司董事長 長泰國榮泰公司董事長 美國榮工國際公司董事長	–	–	–	–

註1：截至年報刊印日止實際持有股數。

註2：本公司董監事目前擔任其他公司之職務如下表。

張虔生
日月瑞(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
日月榮(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
環信通訊科技(股)公司 - 董事(代表人)
日月冠(股)公司 - 董事長
台灣福雷電子(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
三朋工業股份(香港)有限公司 - 董事
ASE Marketing Services Ltd. - 董事長及董事(代表人)
ASE Test Holdings, Ltd. - 董事(代表人)
ASE(Korea)Inc. - 董事(代表人)
ISE Labs, Inc. - 董事(代表人)
台灣固網(股)公司 - 董事(代表人)
ASE Holding Ltd.(Bermuda) - 董事(代表人)
J&R Holding Ltd.(Bermuda) - 董事(代表人)

秦克儉
日月宏科技(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司 - 董事(代表人)
日月欣半導體(股)公司 - 董事(代表人)
ASE Test Ltd.(Singapore) - 董事

潘士華
日月宏科技(股)公司 - 董事(代表人)
日月欣半導體(股)公司 - 董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司 - 董事(代表人)
ASE Test Ltd.(Singapore) - 董事
ASE Test Holdings Ltd. - 董事(代表人)
ASE (Korea) Ltd. - 董事(代表人)
ASE Electronics(Malaysia)Sdn, Bhd - 董事(代表人)
ISE Labs, Inc. - 董事(代表人)

董宏思
日月瑞(股)公司 - 董事(代表人)
日月欣半導體(股)公司 - 董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司 - 監察人(代表人)
日月榮(股)公司 - 董事(代表人)
日月冠(股)公司 - 董事(代表人)
環隆電氣(股)公司 - 監察人(代表人)
環信通訊科技(股)公司 - 監察人(代表人)
三朋工業股份(香港)有限公司 - 董事
美商集程通訊科技(股)公司 - 董事(代表人)
ASE Marketing Services Ltd. - 董事(代表人)
J&R Holding Ltd.(Bermuda) - 董事(代表人)
ASE Investment(Labuan)Ltd. - 董事(代表人)
ASE Holding Ltd.(Bermuda) - 董事(代表人)
Omniquest Industrial Limited - 董事(代表人)
ASE Test Ltd.(Singapore) - 董事(代表人)
ASE Test Holding, Ltd. - 董事(代表人)
ASE Test Finance, Ltd. - 董事(代表人)
ASE(Korea)Ltd.-董事(代表人)
ASE Electronics(Malaysia)Sdn, Bhd - 董事(代表人)
ISE Labs, Inc. - 董事(代表人)
Grand Innovation Co., Ltd. - 董事(代表人)
集耀通訊科技(股)公司 - 董事(代表人)

陳昌益
台灣福雷電子(股)公司 - 董事(代表人)
日月光半導體(上海)有限公司 - 董事(代表人)
日月宏科技(股)公司 - 監察人(代表人)
ASE Test Ltd.(Singapore)-董事(代表人)
環隆電氣(股)公司 - 董事(代表人)
旭富製藥科技(股)公司 - 獨立監察人
聯合創業投資(股)公司 - 董事
ASE Test Holdings Ltd. - 董事(代表人)
Omniquest Industrial Limited - 董事(代表人)
ISE Labs, Inc. - 董事(代表人)
ASE Investment(Labuan)Ltd. - 董事(代表人)

吳田玉
ISE Labs, Inc. - 總經理
ASE Japan Co.,Ltd. - 董事(代表人)

張洪本
日月瑞(股)公司 - 董事(代表人)
日月榮(股)公司 - 董事(代表人)
日月宏科技(股)公司 - 董事
日月欣半導體(股)公司 - 董事長
日月光半導體(上海)有限公司 - 董事長及董事(代表人)
日月冠(股)公司 - 總經理
台灣福雷電子(股)公司 - 董事(代表人)
環隆電氣(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
RTH公司 - 董事(代表人)
環旭深圳公司 - 董事(代表人)
環旭上海公司 - 董事(代表人)
三朋工業股份(香港)有限公司 - 董事
ASE Marketing Services Ltd. - 董事(代表人)
Omniquest Industrial Limited - 董事(代表人)
ASE Test Ltd.(Singapore) - 董事長
ASE(Korea)Ltd. - 董事(代表人)
ASE Electronics(M)Sdn, Bhd - 董事(代表人)
ASE Holding Ltd.(Bermuda) - 董事(代表人)
J&R Holding Ltd.(Bermuda) - 董事(代表人)

馮美珍
日月瑞(股)公司 - 監察人
日月宏科技(股)公司 - 監察人(代表人)
日月欣半導體(股)公司 - 監察人
宏璟新投資(股)公司 - 監察人
宏錦光(股)公司 - 監察人
宏璟管理顧問(股)公司 - 董事
ASE Electronics(M)Sdn, Bhd - 董事(代表人)

何弘
日月榮(股)公司 - 監察人(代表人)
日月光半導體(上海)有限公司 - 董事(代表人)
美商集程通訊科技(股)公司 - 董事(代表人)
環信通訊科技(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
環隆電氣(股)公司 - 董事(代表人)
展毅公司 - 董事(代表人)
達基公司 - 董事(代表人)
環隆英國公司 - 董事(代表人)
環隆日本公司 - 董事(代表人)
環旭深圳公司 - 董事(代表人)
HHI公司 - 董事(代表人)
RTH公司 - 董事(代表人)
UI公司 - 董事(代表人)
UHI公司 - 董事(代表人)
集耀通訊科技(股)公司 - 董事(代表人)

羅瑞榮
ASE Test Ltd.(Singapore) - 董事
台灣福雷電子(股)公司 - 董事(代表人)及總經理

鄭天正
台灣福雷電子(股)公司 - 董事(代表人)
宏璟建設(股)公司 - 董事
宏璟新投資(股)公司 - 董事(代表人)
福華工程(股)公司 - 董事(代表人)
宏錦光(股)公司 - 董事(代表人)
日月光商務旅館(股)公司 - 董事(代表人)
日月光開發育樂(股)公司 - 董事(代表人)
視元素(股)公司 - 董事(代表人)
三朋工業股份(香港)有限公司 - 董事
三朋友電有限公司 - 董事
ASE Test Ltd.(Singapore) - 董事
ASE(Korea)Ltd. - 董事(代表人)

曾元一
宏璟建設(股)公司 - 董事長
福華工程(股)公司 - 董事長
日月光商務旅館(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
宏錦光(股)公司 - 董事長及董事(代表人)
宏璟新投資(股)公司 - 董事長

2. 法人股東之主要股東

92年12月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
香港商微電子國際公司	Aintree Limited

3. 董事及監察人資料

職稱	姓名	條件							
			符合獨立性情形						
		是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗	1.非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人	2.非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東	3.非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬	4.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人	5.非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東	6.非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶	7.非為公司法第二十七條所訂之法人或代表人
董事長	張虔生	●						●	●
副董事長	張洪本	●						●	●
董事（法人之代表人）	秦克儉	●		●	●	●		●	
	潘士華	●		●	●	●		●	
	董宏思	●		●	●	●		●	
	陳昌益	●		●	●	●		●	
	吳田玉	●		●	●	●	●	●	
監察人	馮美珍	●				●		●	●
監察人（法人之代表人）	何弘	●		●	●	●		●	
	羅瑞榮	●		●	●	●	●	●	
	鄭天正	●		●	●	●		●	
	曾元一	●		●	●	●		●	

4. 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股/新台幣仟元

職稱	姓名	就任日期	持有股份（註1）		配偶、未成年子女持有股份（註1）		利用他人名義持有股份（註1）		主要學（經）歷
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	
執行長	張虔生	92.05	22,280,327	0.62%	–	–	–	–	台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士
總經理	張洪本	92.02	40,899,973	1.14%	63,383,829	1.77%	–	–	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣（股）公司董事長
台灣地區總經理	秦克儉	83.11	587,983	0.02%	–	–	–	–	國立海洋大學輪機系畢 福華工程公司物料部經理 德記洋行發貨中心經理
財務副總	董宏思	83.12	858,433	0.02%	143,185	–	–	–	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁
副總經理	俞旭濬	88.08	139,301	–	–	–	–	–	國立藝專廣播電視科 東森傳播公司副總經理 鑫凱傳播公司總經理
副總經理	陳昌益	91.05	526	–	–	–	–	–	加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁 ASE Test Limited財務長
副總經理	魏端航	85.01	491,452	0.01%	–	–	–	–	中原大學工業管理系畢 飛利浦建元電子公司採購部 全球電子公司物料部經理
副總經理	許慶如	86.07	–	–	–	–	–	–	逢甲大學企業管理系畢
副總經理	唐國安	87.02	62,718	–	–	–	–	–	逢甲大學機械工程系畢 矽品精密工業品保副總
副總經理	李俊哲	90.01	893,031	0.02%	–	–	–	–	淡江大學航空工業系畢
副總經理	李智強	92.07	275,385	–	–	–	–	–	清華大學工業管理系畢 福雷電子製造處副總
副總經理	朱承平	92.07	4,026	–	–	–	–	–	政治大學EMBA碩士 Drake大學心理研究所碩士 華宇電腦集團副總經理 中華電腦中心 總經理 中華航空副總經理
副總經理	陳道有	93.01	76,661	–	18,927	–	–	–	成功大學機械系畢
副總經理	李世文	93.01	183,197	–	–	–	–	–	成功大學物理系畢
副總經理	林顯堂	93.01	30,046	–	31,133	–	–	–	中山大學EMBA碩士

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			最近年度薪資、獎金、特支費及紅利總額	經理人取得員工認股權憑證情形
			職稱	姓名	關係		
執行長	張虔生	請參閱第7頁	總經理	張洪本	弟	7,324	4,800,000
總經理	張洪本	請參閱第7頁	執行長	張虔生	兄	4,719	3,200,000
台灣地區總經理	秦克儉	請參閱第7頁				註2	註2
財務副總	董宏思	請參閱第7頁				註2	註2
副總經理	俞旭濬	視元素（股）公司董事長及董事（代表人） 宏璟建設（股）公司董事（代表人）				註2	註2
副總經理	陳昌益	請參閱第7頁				註2	註2
副總經理	魏端航	–				註2	註2
副總經理	許慶如	台灣福雷電子（股）公司董事（代表人） 環隆電氣（股）公司監察人（代表人）				註2	註2
副總經理	唐國安	–				註2	註2
副總經理	李俊哲	–				註3	註3
副總經理	李智強	–				註2	註2
副總經理	朱承平	–				註2	註2
副總經理	陳道有	–				註2	註2
副總經理	李世文	–				註2	註2
副總經理	林顯堂	–				註2	註2

註1：截至年報刊印日止實際持有股數。

註2：台灣地區總經理及副總經理之酬勞合計為31,885仟元，取得員工認股權憑證合計7,060,000單位。

（三）董事、監察人、經理人及大股東股權變動

1. 持股及設質股數變動情形

職稱	姓名	九十二年度		九十三年度截至二月底止	
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事及監察人	香港商微電子國際公司	62,839,583	—	—	—
董事長	張虔生	2,025,484	—	—	—
總經理	張洪本	3,718,179	—	—	—
監察人	馮美珍	5,762,166	—	—	—
台灣地區總經理	秦克儉	53,453	—	—	—
副總經理	董宏思	78,039	—	—	—
副總經理	俞旭濬	(15,973)	—	(5,000)	—
副總經理	李智強	25,035	—	—	—
副總經理	朱承平	366	—	—	—
副總經理	唐國安	5,701	—	—	—
副總經理	魏端航	(120,323)	—	—	—
副總經理	李俊哲	81,184	—	—	—
副總經理	陳昌益	47	—	—	—
副總經理	林顯堂	註	註	(20,000)	—

註：93年1月就任。

2. 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

3. 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

（四）綜合持股比例

92年12月31日　單位：股/%

轉投資事業（註）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
ASE Marketing Services Ltd.	499,999	100.00%	1	—	500,000	100.00%
J&R Holding Ltd.（Bermuda）	12	100.00%	—	—	12	100.00%
日月榮投資（股）公司	134,999,995	90.00%	5	—	135,000,000	90.00%
ASE Holding Ltd.（Bermuda）	184,290	100.00%	—	—	184,290	100.00%
日月宏科技（股）公司	143,547,583	57.42%	52,203,050	20.88%	195,750,633	78.30%
日月欣半導體（股）公司	365,483,259	57.56%	269,516,741	42.44%	635,000,000	100.00%
環信通訊科技（股）公司	3,750,000	25.00%	1,045,000	6.97%	4,795,000	31.97%
日月冠（股）公司	19,753,830	98.77%	100,904	0.50%	19,854,734	99.27%
美商集程通訊科技（股）公司	4,000,000	23.05%	1,500,000	8.65%	5,500,000	31.70%
集耀通訊科技（股）公司	5,200,000	32.10%	250,000	1.54%	5,450,000	33.64%
環隆電氣（股）公司	144,936,050	21.56%	13,306,305	1.98%	158,242,355	23.54%
ASE Japan Co., Ltd.	1,200	100.00%	—	—	1,200	100.00%
宏璟建設（股）公司	119,408,060	26.43%	119,321,201	26.41%	238,729,261	52.84%
宏錦光（股）公司	39,047,000	27.31%	13,209,000	9.24%	52,256,000	36.55%

註：係公司之長期投資。

三. 資本及股份

（一）股份種類

股份種類	核定股本					轉換公司債可轉換股份總數	保留員工認股權憑證總數
	已發行股份			未發行股份	合計		
	已上市	未上市	合計				
普通股	3,580,280,000股	0股	3,580,280,000股	1,569,720,000股	5,150,000,000股	450,000,000股	300,000,000股

（二）股本來源

單位：股/新台幣元

年月	發行價格	每股面額	核定股本		實收股本		備註		
			股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
73.03	–	10	17,200,000	172,000,000	10,000,000	100,000,000	設立（現金）	無	民國73年3月23日 經加處（73）設字第414號
73.05	–	10	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資100,000,000	無	民國73年5月29日 經加處（73）資字第4585號
73.06	–	10	23,520,000	235,200,000	23,520,000	235,200,000	現金增資35,200,000	（含技術股35,200,000元）	民國73年7月17日 經加處（73）商字第6266號
75.08	–	10	33,121,625	331,216,250	33,121,625	331,216,250	現金增資96,016,250	無	民國75年4月2日 經加處（75）資字第2926號
76.11	–	10	39,495,000	394,950,000	39,495,000	394,950,000	盈餘增資63,733,750	無	民國76年11月25日 經加處（76）資字第11447號
77.06	–	10	50,000,000	500,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘增資105,050,000	無	民國77年6月9日 經加處（77）資字第11447號
78.12	–	10	62,000,000	620,000,000	62,000,000	620,000,000	盈餘增資120,000,000	無	民國78年12月24日 經加處（78）資字第3328號
79.11	–	10	75,024,000	750,240,000	75,024,000	750,240,000	盈餘及員工紅利增資117,840,00 資本公積轉增資12,400,000	無	民國79年11月28日 經加處（79）資字第4696號
80.08	–	10	125,000,000	1,250,000,000	105,607,373	1,056,073,730	盈餘及員工紅利增資80,761,730 資本公積轉增資225,072,000	無	民國80年4月29日 經加處（80）資字第003001號
80.12	38	10	125,000,000	1,250,000,000	125,000,000	1,250,000,000	現金增資193,926,270	無	民國80年12月23日 經加處（80）資字第010557號
81.05	–	10	150,600,000	1,506,000,000	150,600,000	1,506,000,000	盈餘及員工紅利增資68,500,000 資本公積轉增資187,500,000	無	民國81年5月25日 經加處（81）資字第004304號
82.05	–	10	165,660,000	1,656,600,000	165,660,000	1,656,600,000	資本公積轉增資150,600,000	無	民國82年6月4日 經加處（82）資字第004229號
83.03	–	10	260,000,000	2,600,000,000	233,824,000	2,338,240,000	盈餘及員工紅利增資491,131,000 資本公積轉增資190,509,000	無	民國83年3月25日 經加處（83）資字第002514號
84.01	60	10	260,000,000	2,600,000,000	260,000,000	2,600,000,000	現金增資261,760,000	無	民國83年9月24日 經加處（83）資字第008500號
84.05	–	10	500,000,000	5,000,000,000	356,800,000	3,568,000,000	盈餘及員工紅利增資760,000,000 資本公積轉增資208,000,000	無	民國84年3月27日 經加處（84）資字第002471號
84.07	79.7	10	500,000,000	5,000,000,000	399,800,000	3,998,000,000	現金增資430,000,000	無	民國84年7月29日 經加處（84）商字第00671號
85.05	–	10	1,000,000,000	10,000,000,000	729,000,000	7,290,000,000	盈餘及員工紅利增資2,092,600,000 資本公積轉增資1,199,400,000	無	民國85年4月17日 經加處（85）資字第003679號
86.05	–	10	1,400,000,000	14,000,000,000	1,017,000,000	10,170,000,000	盈餘及員工紅利增資1,640,700,000 資本公積轉增資1,239,300,000	無	民國86年5月1日 經加處（86）資字第004063號
87.04	–	10	2,200,000,000	22,000,000,000	1,780,000,000	17,800,000,000	盈餘及員工紅利增資6,409,600,000 資本公積轉增資1,220,400,000	無	民國87年4月4日 經加處（87）資字第003051號
88.07	–	10	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,000,000	19,800,000,000	盈餘及員工紅利增資2,000,000,000	無	民國88年10月29日 經加處（88）三資字第011765號
89.06	–	10	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,355,086	19,803,550,860	海外可轉換公司債轉換 普通股本3,550,860	無	民國89年6月5日 經加處（89）三商字第005552號
89.09	–	10	3,200,000,000	32,000,000,000	2,652,000,000	26,520,000,000	盈餘及員工紅利增資6,716,449,140	無	民國89年9月5日 經加處（89）三資字第009686號
89.10	43.81	10	3,200,000,000	32,000,000,000	2,752,000,000	27,520,000,000	現金增資發行海外 存託憑證1,000,000,000	無	民國89年10月23日 經加處（89）三商字第011577號
90.08	–	10	4,150,000,000	41,500,000,000	3,254,800,000	32,548,000,000	盈餘及員工紅利增資5,028,000,000	無	民國90年6月26日 經加處（90） 三資字第0900005692號
92.09	–	10	5,150,000,000	51,500,000,000	3,580,280,000	35,802,800,000	盈餘轉增資97,644,000 資本公積轉增資3,157,156,000	無	民國92年9月18日 經加處（92） 三商字第09200088290號

（三）股東結構

92年12月31日

股東結構 / 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	1	1	309	220,806	386	221,503
持有股數	3,055	168,073	429,958,970	1,277,869,642	1,872,280,260	3,580,280,000
持股比例	0.000	0.005	12.009	35.692	52.294	100.000

（四）股權分散情形

92年12月31日

持股分級	股東人數	持有股數（每股面額10元）	持股比例
1 至999	69,848	26,432,333	0.738
1,000至5,000	99,680	228,118,453	6.372
5,001至10,000	27,489	186,390,395	5.206
10,001至15,000	10,243	121,307,954	3.388
15,001至20,000	4,526	78,088,523	2.181
20,001至30,000	4,059	97,118,176	2.713
30,001至40,000	1,970	67,767,281	1.893
40,001至50,000	855	37,939,010	1.060
50,001至100,000	1,657	110,543,307	3.088
100,001至200,000	586	79,564,269	2.222
200,001至400,000	253	71,042,131	1.984
400,001至600,000	80	38,875,666	1.086
600,001至800,000	46	31,901,955	0.891
800,001至1,000,000	32	28,873,986	0.806
1,000,001以上	179	2,376,316,561	66.372
合計	221,503	3,580,280,000	100.000

（五）主要股東名單

92年12月31日

股份 / 股東名稱	持有股數	持股比例
香港商微電子國際公司	691,235,417	19.307
摩根大通託管新興市場成長基金投資專戶	227,658,191	6.359
匯豐銀行託管太平洋光輝金融第一公司專戶	137,749,533	3.847
日月光公司海外存託憑證	122,037,863	3.409
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶	98,720,600	2.757
中華郵政股份有限公司	72,311,415	2.020
馮美珍	63,383,829	1.770
公務人員退休撫卹基金管理委員會	61,154,659	1.708
摩根大通託管美資國際新興市場基金投資專戶	54,637,458	1.526
勞工保險局	44,563,162	1.245

（六）每股市價、淨值、盈餘及股利

單位：新台幣元

項目 \ 年度			九十二年度	九十一年度	當年度截至年報刊印日止
每股市價	最高		36.40	38.50	39.80
	最低		16.50	15.90	33.10
	平均		24.25	25.38	36.96
每股淨值	分配前		12.60	12.11	註2
	分配後		註1	12.11	註2
每股盈餘	加權平均股數		3,537,048,918股	3,399,745,800股	3,580,280,000股
	每股盈餘（完全稀釋）	追溯前	0.78	0.04	註2
		追溯後	0.78	0.04	註2
每股股利	現金股利		－	－	註2
	無償配股	盈餘配股	註1	0.03	註2
		資本公積配股	註1	0.97	註2
投資報酬分析	本益比		30.84	608	註2
	本利比		－		－
	現金股利殖利率		－		－

註1：俟股東會決議後定案。

註2：尚未完成盈餘結算。

註3：本益比=當年度平均收盤價 / 每股盈餘

（七）公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策

本公司於民國八十九年七月十一日經股東會通過之股利政策，其內容如下：

本公司正處於企業成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係以分派股票股利為優先，亦得以現金股利分派之，其中現金股利發放之比例以不超過百分之二十為原則，惟每股現金股利若低於0.1元則不予發放，改以股票股利方式發放之。前項所述現金股利發放之比例，本公司得依當年度實際營運狀況，並考量次一年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式，由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

（1）本公司董事會於民國九十三年三月二十四日提議以股東紅利轉增資每1,000股分配62股。惟經加計本公司92年10月28日董事會決議通過合併日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司預計於93年7月1日辦理合併發行之新股282,315,437股，股東紅利轉增資配股率將調降為每1,000股分配57.4股。此外，嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債券持有人於配股權利基準日前行使轉換、或因本公司辦理現金增資發行新股以參與發行海外存託憑證，致本公司配股權利基準日之流通在外股數有所增加者，授權董事會依本次盈餘分派案決議之股東紅利轉增資金額（新台幣2,219,773,600元），按配股權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

（2）本次股東會擬議股利分配之情形俟股東常會通過並報請主管機關核准增資後，授權由董事會另訂除權配股基準日，新股之權利義務與原發行之股份相同，屆時將另行公告。

（八）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

不適用。（依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國九十三年度財務預測資訊。）

（九）員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數

依本公司章程規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

（1）彌補虧損。

（2）提存10％為法定盈餘公積。

（3）依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積。

（4）長期投資依權益法計算投資收益內屬於現金股利以外之未實現部分，得就當年度盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配。

如有盈餘分派如下：

（5）董事、監察人酬勞金係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥2％（含）以下。

（6）員工紅利係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥5％（含）以上，7％（含）以下，其中5％部份係按員工紅利發放辦法分配予全體員工，另其有超過5％部份則授權董事會就特定員工之個別貢獻另行訂定辦法分派之。

（7）其餘由董事會擬定盈餘分派案，按股份總額比例分派之。

上開第六款所稱之員工，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

本公司93年3月24日董事會通過92年度盈餘分派案如下

（1）擬議配發員工現金紅利新台幣18,427,970元，董監事酬勞現金新台幣49,320,000元。

（2）擬議配發員工股票紅利15,427,203股，占盈餘轉增資之比例6.50％。

（3）考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.71元。

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

本公司92年6月19日股東常會通過91年度盈餘分派案及實際配發情形：

（1）實際配發員工現金紅利新台幣8,000,000元，董監事酬勞現金新台幣2,280,000元。

（2）實際配發員工股票紅利0股，占盈餘轉增資之比例0％。

（3）實際配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.038元。

（4）以上實際配發金額與原董事會通過之擬配發情形相同。

（十）公司買回本公司股份情形：無。

四. 公司債辦理情形

（一）公司債發行情形

公司債種類		第二次海外無擔保可轉換公司債	九十二年度第一次有擔保普通公司債
發行日期		民國92年9月25日	民國93年1月9日
面額		美金1,000元	新台幣1,000萬元
發行及交易地點		盧森堡證券交易所	中華民國櫃檯買賣中心
發行價格		依面額100%發行	依票面金額十足發行
總額		美金200,000,000元	新台幣2,750,000,000元
利率		票面利率0%	註1
期限		5年，到期日：民國97年9月25日	5年期到期日：民國98年1月9日
保證機構		無	由中國信託商業銀行股份有限公司主辦之保證銀行團共九家銀行共同保證。
受託人		無	中國國際商業銀行股份有限公司
承銷機構		倍利證券（香港）有限公司及荷銀洛希爾	無
簽證律師		理律法律事務所	現代法律事務所
簽證會計師		勤業眾信會計師事務所	勤業眾信會計師事務所
償還方法		除已經本公司提前贖回、買回並註銷或經債券持有人行使轉換權外，本公司債到期時本公司將按面額將債券贖回。	本金分二期償還，於公司債發行分別屆滿四年及五年之日各償付二分之一
未償還本金		美金200,000,000元	新台幣2,750,000,000元
贖回或提前清償之條款		（一）賣回條件： 1. 除已經本公司提前贖回、買回並註銷或經債券持有人行使轉換權，債券持有人得於本公司債發行屆滿四年時，要求本公司依本公司債券面額116.02%（贖回收益率暫定年利率3.75%，並以半年為計算基礎）將其持有之全部或部分債券贖回。 2. 本公司控制權（如受託契約定義）發生變動時，債券持有人得要求本公司依面額加計贖回收益率贖回其全部持有之債券。 3. 債券持有人亦得於發行公司普通股下市時，要求本公司以面額贖回其所持有全部債券。 （二）買回條件： 1. 本公司債於發行滿四年時，遇有本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美元，連續二十個營業日均達轉換價格（以訂價日議定之固定匯率美金對新台幣1:34.075換算為美元）之130%時，本公司得以提前贖回價格，將債券之全部或一部份贖回。 2. 於超過百分之九十之本公司債已贖回、買回或行使轉換權時，本公司得以提前贖回價格將債券全部贖回。 3. 因中華民國稅務法令變更，致本公司必需支付額外之利息費用時，本公司得依提前贖回價格將債券全部贖回。 4.「提前贖回價格」指債券面額加計按實際經過天數計算之利息補償金之金額。	本公司與保證銀行團所簽訂「聯合保證發行公司債合約」所規定之違約事件發生時，保證銀行有權對公司債債權人（或受託人）提前清償。
限制條款		本公司債不得在中華民國及美國境內募集、銷售或交付。	一般限制條款
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換（交換或認股）辦法	轉換辦法： 1. 除已提前贖回、買回並註銷、法令規定或發行契約約定不得轉換之期間外，本公司債債權人得於發行後第31日起至本公司債到期日前10日止，隨時依有關法令及本公司債發行契約規定向本公司請求轉換為本公司新發行之普通股股票，或經向主管機關申請核准後，轉換為本公司參與發行之海外存託憑證，以代替本公司債期滿之現金還本。 2. 除發行契約另有規定外，前述轉換權於下列期間不得行使： （a）於股東常會前六十日內； （b）股東臨時會前三十日內； （c）發行公司向台灣證券交易所辦理無償配股停止過戶除權公告日、發放現金股息停止過戶除息公告日，或辦理現金增資給予原股東認購新股之停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止； （d）其他依中華民國法令規定不得轉換之期間。	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次發行之海外可轉換公司債全部按發行時轉換價格轉換為普通股，對原股東之最大可能稀釋比率為4.23%。	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

註1：九十二年度第一次有擔保普通公司債各券發行金額及利率：

券別及發行金額	發行利率
A券 新台幣貳億伍仟萬元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
B券 新台幣參億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.001%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
C券 新台幣貳億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.002%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
D券 新台幣參億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.003%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
E券 新台幣貳億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.004%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
F券 新台幣參億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.005%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
G券 新台幣貳億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.006%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
H券 新台幣參億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.007%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
I券 新台幣貳億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.008%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
J券 新台幣參億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.009%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。
K券 新台幣貳億元整	若6M LIBOR<0.95%，則票面利率為6M LIBOR+0.010%； 若0.95%≦6M LIBOR≦2.00%，則票面利率為3.60%； 若6M LIBOR>2.00%，則票面利率為4.00%-6M LIBOR（票面利率下限為0）。

各券首次計息設定日為發行日前二個營業日，各期計息設定日為發行日起，每屆滿半年之計息基準日之前二個營業日按6M LIBOR重新調整並於計息基準日起單利計息一次且票面利率不得低於0%（營業日係指倫敦之銀行營業日，遇假日則為前一營業日）。

6M LIBOR：6個月LIBOR係依據計息設定日倫敦時間上午十一時，香港商德勵財富資訊（Moneyline Telerate）第3750頁畫面之六個月美金倫敦銀行間同業拆款利率（USD 6-Month LIBOR）之平均報價（Fixing Rates）。若計息基準日無法取得前述報價，則由計息機構依誠信原則與合理之市場行情決定。前述計息機構由中國信託商業銀行股份有限公司擔任。

註2：本公司發行第三次海外無擔保可轉換公司債業經證期會93年1月2日台財證一字第0920156844號函核准在案，發行總額上限為美金150,000千元，目前尚在辦理中。

（二）轉換公司債資料

單位：新台幣元

公司債種類		第二次海外無擔保可轉換公司債	
項目 ＼ 年度		92年度	93年截至年報刊印日
轉換公司債市價	最高	－	－
	最低	－	－
	平均	－	－
轉換價格		37.716	
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		發行日期：92年9月25日 發行時轉換價格：37.716	
履行轉換義務方式		公司債持有人行使轉換權者，本公司將於受理轉換請求日後五個營業日內，透過台灣證券集中保管股份有限公司之帳簿劃撥方式交付新股。如請求轉換之本公司債持有人尚未開立海外公司債轉換集保專戶，發行公司將俟持有人完成相關開戶手續後，再以帳簿劃撥方式交付新股。	

（三）交換公司債資料：無

（四）總括申報發行公司債情形：無

（五）附認股權公司債資料：無

五. 特別股辦理情形：無

六. 海外存託憑證辦理情形

93年3月 26日　單位：美金元

項目 ＼ 發行（辦理）日期		89年9月	92年6月
發行（辦理）日期		民國89年9月	民國92年6月
發行及交易地點		美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所
發行總金額		美金140,000千元	美金86,808千元
單位發行價格		每單位美金7元	每單位美金2.65元
發行單位總數		20,000,000單位，每單位表彰本公司普通股5股	32,757,600單位，每單位表彰本公司普通股5股
表彰有價證券之來源		本公司現金增資發行之普通股	本公司股東所持有本公司已發行之普通股
表彰有價證券之數額		本公司普通股100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整	本公司普通股163,788,000股，每股面額新台幣壹拾元整
存託憑證持有人之權利與義務		享有與本公司普通股股東相同之權利義務	享有與本公司普通股股東相同之權利義務
受託人		無	無
存託機構		花旗銀行	花旗銀行
保管機構		花旗銀行台北分行	花旗銀行台北分行
未兌回餘額		迄年報刊印日止，海外存託憑證流通在外餘額為17,481,026單位，表彰本公司普通股87,405,158股。	
發行及存續期間相關費用之分攤方式		無	無
存託契約及保管契約之重要約定事項		無	無
92年	最高	5.51	
	最低	2.45	
	平均	3.50	
93年截至年報刊印日止	最高	6.04	
	最低	5.05	
	平均	5.65	

本公司擬以現有股東香港商微電子國際公司所持有本公司普通股股票不超過45,000,000股，參與發行海外存託憑證不超過9,000,000單位，募集資金約美金46,350千元，業經證期會92.12.31台財證一字第0920156843號函核准在案。另，本公司業經證期會93.01.06台財證一字第0920156842號函核准，以現金增資發行普通股股票240,000,000股至300,000,000股，參與發行海外存託憑證48,000,000單位至60,000,000單位，總額約美金247,200千元至美金309,000千元。上述兩案目前尚在辦理中。

七. 員工認股權憑證辦理情形

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，業經主管機關於九十一年八月核准發行第一次員工認股權憑證計160,000,000單位，每單位得認購本公司普通股一股，並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。第一次員工認股權憑證已分別於九十一年十二月及九十二年八月分次授予員工。

（一）員工認股權憑證辦理情形

93年3 月26日

員工認股權憑證種類	第一次員工認股權憑證	
	第一次發行	第二次發行
主管機關核准日期	91/8/28	91/8/28
發行（辦理）日期	91/12/24	92/08/22
發行單位數	145,989,000單位	13,979,000單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	4.07%	0.39%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。	
履約方式	由本公司發行普通股新股交付。	
限制認股期間及比率（%）	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股。	
	認股權憑證授予期間	累積最高可行使認股比例
	屆滿2年	40%
	屆滿2.5年	50%
	屆滿3年	60%
	屆滿3.5年	70%
	屆滿4年	80%
	屆滿4.5年	90%
	屆滿5年	100%
已執行取得股數	0	
已執行認股金額	0	
未執行認股數量	目前實際發行可認購普通股數159,968,000股，均未執行。	
未執行認股者其每股認購價格	新台幣18.9元	新台幣24.6元
未執行認股數量占已發行股份總數比率（%）	4.07%	0.39%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，分三年執行，對原股東權益逐年稀釋，其稀釋效果尚屬有限。	

（二）取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形

93年3月26日

職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率（%）	已執行				未執行			
				已執行認股數量	已執行認股價格	已執行認股金額	已執行認股數量占已發行股份總數比率	未執行認股數量	未執行認股價格（新台幣元）	未執行認股金額（新台幣仟元）	未執行認股數量占已發行股份總數比率
執行長	張虔生	4,800,000	0.13	–	–	–	–	4,800,000	18.9	90,720	0.13
總經理	張洪本	3,200,000	0.09	–	–	–	–	3,200,000	18.9	60,480	0.09

八. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

（一）最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。

本公司為節省營運成本並發揮管理效益，於91年7月17日經董事會決議吸收合併持股100%之子公司日月新投資股份有限公司及日月興投資股份有限公司，該合併案並無換股比例，本公司亦無發行新股。該合併案業以92年7月1日為基準日完成合併，並奉經濟部管理處92年8月18日經加三商字第09201027160號函核准在案。

（二）最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者

1. 執行情形

本公司為整合集團內部資源，於92年10月28日經董事會決議合併子公司日月欣半導體股份有限公司（以下稱「日月欣公司」）與日月宏科技股份有限公司（以下稱「日月宏公司」），換股比率訂為每1股日月欣公司股份換發本公司股份0.85股，每1股日月宏公司股份換發本公司股份0.5股，本公司預計將發行282,315,437股以進行合併換股事宜，佔合併前實收資本額之7.89%。該合併案並於92年11月13日經日月欣公司及日月宏公司股東臨時會通過，預計合併基準日為93年7月1日，目前尚在辦理中。

2. 對股東權益之影響

日月欣半導體股份有限公司、日月宏科技股份有限公司為本公司轉投資持股達57.56%及57.42%之被投資公司，基於集團資源整合及產業規模經濟之考量，合併後擴大營運規模及產品線，並加強整合三方之人力及資源，有助於降低營運成本及資金取得成本，進而強化公司競爭優勢，對股東權益有正面之影響。

3. 被併購或受讓公司之基本資料

公司名稱		日月欣半導體（股）公司	日月宏科技（股）公司
公司地址		桃園縣中壢市中華路一段550號	高雄市楠梓加工出口區開發路73號
負責人		張洪本	秦克儉
實收資本額		6,350,000仟元	2,500,000仟元
主要營業項目		半導體封裝及測試	半導體材料之製造、加工及買賣
主要產品		BGA.QFP.SOIC.PDIP.QFN. PLCC.IMAGE SENSOR.SMT等.IC測試	1. 矩陣式及高腳數引線架 Matrix & high pin count Lead Frame 2. 矩陣式及高腳數基板PBGA/CSBGA/TFBGA/LFBGA Substrate 3. 堆疊式高密度覆晶基板 build-up Flip Chip Substrate
最近年度財務資料	資產總額	13,466,123仟元	9,303,051仟元
	負債總額	4,609,487仟元	7,455,288仟元
	股東權益總額	8,856,636仟元	1,847,763仟元
	營業收入	6,018,146仟元	5,225,066仟元
	營業毛利	899,445仟元	470,290仟元
	營業損益	217,025仟元	102,942仟元
	本期損益	182,837仟元	168,337仟元
	每股盈餘	0.288元	0.673元

參. 營運概況

一. 業務內容

(一) 業務範圍

從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

1. 主要業務：本公司以提供頂尖先進技術與製程研發為核心競爭能力，以提供全球半導體廠商先進封裝服務。

2. 目前商品種類及其比重

單位：新台幣仟元

主要產品項目	九十二年度	
	營收金額	營業比重
球型陣格承載器積體電路（BGA）	18,915,212	60%
薄型平面型塑膠晶粒承載器積體電路（LQFP）	4,867,861	15%
正方平面型塑膠晶粒承載器積體電路（EQFP）	4,020,133	13%
其他	3,684,585	12%
總計	31,487,791	100%

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

2003年美伊戰事抵定，在美國經濟復甦的帶動下，全球整體經濟也隨之逐漸復甦。企業在資訊設備支出增加，消費者消費意願提升，促使電子產品買氣回溫，半導體景氣復甦態勢更為明顯。根據美國半導體協會公佈數字顯示，在需求明顯增加及供給有效控制的發展情形下，2003年全球半導體產值較2002年成長18.4%，預計2004年仍將延續這股成長力道，成長幅度更可達到19%以上。

而中華民國經濟部技術處ITIS計畫發表的報告顯示，2003年我國在晶圓代工的帶動下，使得IC設計業、IC製造業、IC封裝業及IC測試業均有相當不錯的成長率，分別為27.0%、26.8%、21.9%及28.6%。因此2003年整體IC產業產值為8,243億台幣，較2002年成長26.3%，IC產品產值為3,565億台幣，較2002年成長27.5%。

我國IC產業有全球第二大的IC設計業及全球第一大的晶圓代工業，帶動2004年IC整體產業產值成長31%，產值為10,797億台幣，產品產值成長36.5%，產值為4,865億台幣。在各次產業的部分，IC設計業產值為2,565億台幣、成長36.7%，IC製造業產值為6,303億台幣、成長31.3%，IC封裝業產值為1,419億台幣、成長22.8%，IC測試業產值為510億台幣、成長24.7%。

單位：新台幣億元

	2002年	2003年	2003/2002成長率	2004年	2004/2003成長率
IC產業總產值	6,529	8,243	26.30%	10,797	31.00%
IC設計業	1,478	1,877	27.00%	2,565	36.70%
IC製造業	3,785	4,801	26.80%	6,303	31.30%
IC封裝業	948	1,156	21.90%	1,419	22.80%
IC測試業	318	409	28.60%	510	24.70%

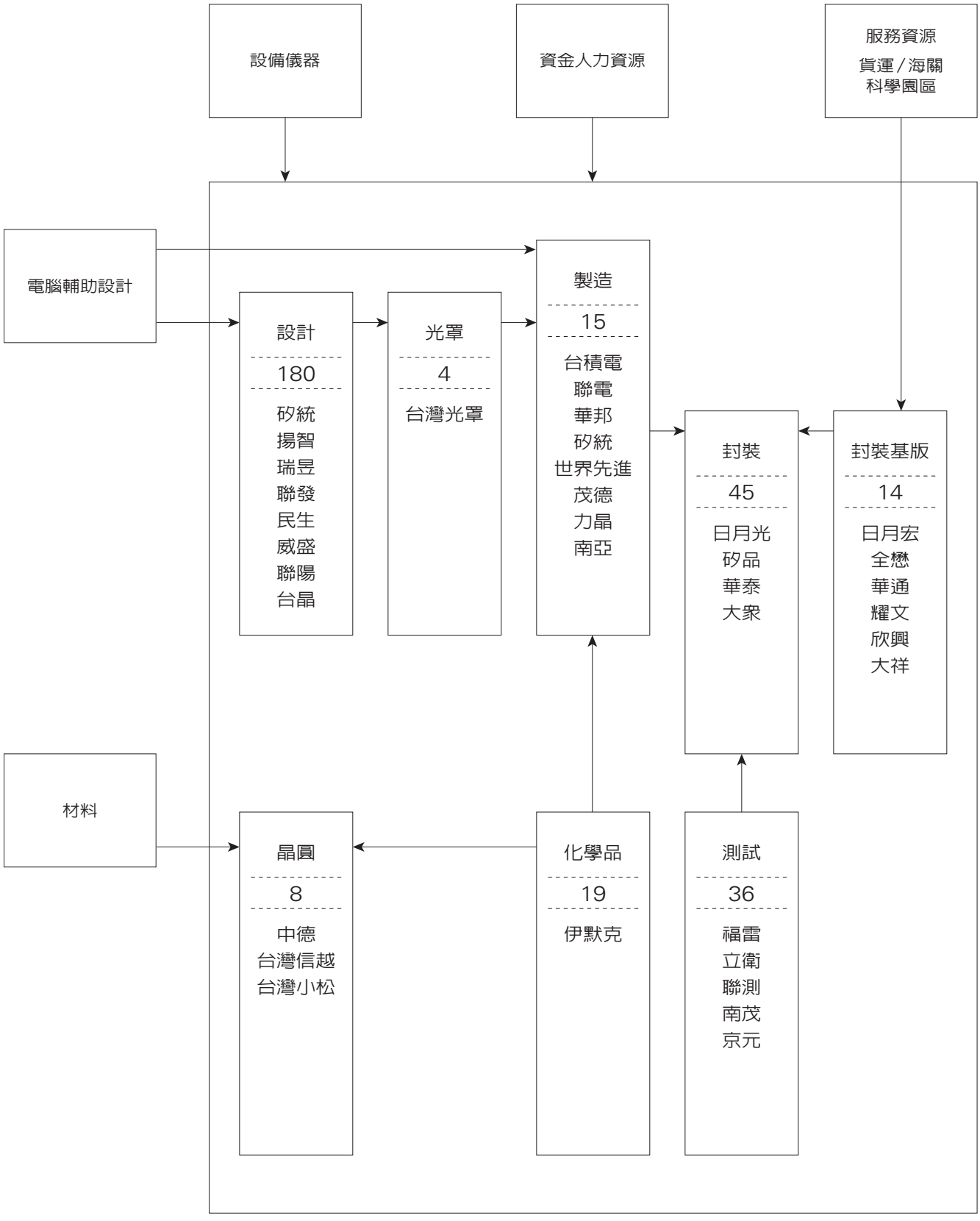
資料來源：中華民國經濟部技術處ITIS計畫

2. 產業上、中、下游之關連性

在整個半導體供應鍊中，本公司之業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。

本公司提供客戶晶片封裝及測試之半導體製造服務，主要晶圓由客戶提供，客戶大都為國際知名半導體公司，長期與本公司保持良好的業務關係。本公司並透過策略聯盟與合作伙伴藉由垂直分工，進而提昇彼此的競爭實力。

我國半導體產業結構圖



資料來源：工研院經資中心ITIS計畫

3. 產品之發展趨勢

目前市場上發展的封裝技術，除應用腳數增加的細間距銲線（Fine Pitch Bonding）技術外，另有覆晶封裝（主要應用於如晶片組、繪圖晶片及網路通訊晶片等高階產品），因應環保需求的無鉛化封裝（如歐盟於2004年全面要求使用無鉛化產品）、堆疊式封裝（目前以攜帶式產品為主要需求，如手機記憶體中Flash及SRAM的共同封裝以縮小體積）、晶圓級構裝（封裝後體積接近原來晶片之大小，達成封裝目標的極致）。另外，就兼備結合多功能及縮小體積而言，多晶片封裝模組（Multi-chip Module, MCM）及系統整合型封裝（Syetem in Package, SiP）技術更是業界積極提昇技術層次之重點。

4. 競爭情形

在半導體封裝測試產業，第一線廠商必須在技術上一決高下，以取得高毛利先進製程訂單的機會，封裝測試產業在近二年來，前四大封測廠紛紛在高階封裝產品積極佈局，二線廠商顯然已經在先進製程上較為落後。2002年中開始，細間距BGA封裝及高階測試的產能利用率逐季攀高，全球前四大封測廠在細間距封裝的產能利用率平均皆達70%以上。隨著半導體技術層次不斷的提昇，投資金額也持續提高，IDM大廠及IC設計公司將以其核心能力為主要競爭力，半導體專業代工的態勢將以更快的速度成長。

鑑此本公司積極的擴充產能以徹底發揮規模經濟，加強產品線廣度與深度的延伸，以擴大市場佔有率；在技術及製程能力方面皆不斷提昇與客戶之合作層次，提供完整的半導體後段製造服務。另藉合併與合資來增強市場競爭力、降低新產品研發風險、並以具備完整產品線，取得市場領導地位。

（三）技術及研發概況

1. 最近年度投入之研發費用

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	91年度	92年度	當年度截至2月底
營業收入	25,631,776	31,487,791	5,702,033
研發支出金額	577,945	756,097	121,390
研發支出佔營業收入之比率	2.25%	2.40%	2.13%

2. 所營業務之技術層次

本公司提供先進的半導體後段製程技術，包括覆晶封裝（Flip Chip）、六吋／八吋／十二吋晶圓凸塊封裝（Wafer Bumping）技術與測試能力、高階晶片級封裝（Chip Scale Package, CSP）技術、光電封裝技術、3D和系統整合型封裝技術。

日月光在晶片級封裝、覆晶封裝、12吋晶圓凸塊等封裝技術與量產能力皆居世界領先地位。此外，我們擁有獨步全球的十二吋晶圓後段整合服務，同時亦積極發展綠色環保封裝解決方案。

3. 所營業務之研究發展

本公司以專業半導體後段製造服務，協助客戶以最精簡的成本獲得最佳商業收益。面對激烈之競爭環境，本公司研發成果及未來研發方向如下：

（1）未來研究發展技術及計劃開發之產品

- 綠色環保封裝（Green Package）
- 綠色環保覆晶封裝（Green Flip Chip Package）
- 覆晶四邊扁平無接腳封裝產品（Flip Chip QFN Package）（QFN: Quad Flat No Lead）
- 細間距中心層基板設計（Fine Pitch Core Layer Substrate Design）
- 開發全世界最薄的1.4 mm 7層堆疊晶粒封裝（thinner package on 1.4mm 7 layer FBGA Package）
- 晶圓級氣密式封裝技術（Wafer level hermetic packaging technology）

(2) 開發成功之技術或產品:

a. 新產品開發

- 0.13 微米銅製程 / 低介電係數晶圓產品之覆晶封裝(Flip Chip with 0.13 um Cu / LowK Wafer)
- 90 奈米銅製程 / 超低介電係數晶圓產品之覆晶封裝(Flip Chip with 90 nm Cu / Ultra LowK Wafer)
- 與無鉛製程相容之共晶錫鉛凸塊覆晶封裝產品(Leadfree Compatible Flip Chip Package with Eutectic Bump)
- 50x50 mm大尺寸覆晶封裝產品通過產品驗證(50x 50 mm Large Flip Chip Package Qualified)
- 開發完成全世界最薄的堆疊晶粒封裝0.5mm UFBGA Package
- 開發完成以微機電技術(MEMS Technology)製成之微顯示器(Micro display)

b. 新技術開發

- 高鉛凸塊覆晶封裝之助銲劑水洗製程改善冷銲問題(Flux Cleaning Process for Highlead Bumped Flip Chip Package to improve cold joint)
- 高效能多重半導體元件附加於覆晶封裝產品整合不同積體電路於一顆產品增加效能並減少空間(High Performance Multi-Package Flip Chip Product to gather different IC into a unit to improve performance and save space)
- 率先開發成功以區塊鑄模封裝技術,提供透明膠IC產品,達到低成本、小尺寸、高效能之封裝需求。

(四) 長短期業務發展計劃

1. 短期計畫

- 深耕現有客戶,積極爭取IDM大廠訂單
- 強化目前高階機種的比重,提昇產品平均單價
- 爭取流動客戶之轉向,建立長期合作關係

2. 長期計畫

- 擴大液晶監視器產品晶片的銷售比重
- 爭取尚未納入客戶名單的世界級PC大廠訂單
- 主要元件的上、下游整合,增加產品的附加價值
- 擴大整體生產規模,追求成本優勢,讓價格更具競爭力
- 用新Chassis更新現有機種,以期達到更具成本效益及生產性,加強產品競爭力

二. 市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 九十二年度本公司主要商品之銷售地區

單位:新台幣千元

銷售地區	銷售金額	%
美洲	15,697,036	49.8
台灣	11,559,207	36.7
歐洲	2,985,177	9.5
亞洲及其他	1,246,371	4.0
合計	31,487,791	100.0

2. 市場佔有率

主要封測廠營收比率統計表						
Year	日月光	Amkor	矽品	ChipPac	STATS	ASAT
2000	30%	37%	11%	9%	6%	7%
2001	32%	38%	13%	9%	4%	4%
2002	33%	35%	16%	9%	5%	2%
2003	34%	31%	16%	8%	7%	4%

資料來源：美國證券管理委員會、台灣公開資訊觀測站，並由本公司彙總整理

日月光在2003年正式超越最大競爭對手Amkor，成為全球最一大專業封測大廠。從需求面觀之，由於封裝上承晶圓製造廠與各項IC應用上的需求，其中3C之需求比重鼎足而立。而日月光集團來自3C領域之營收分佈大致均衡，有別於其他競爭對手營收偏重於3C其中一領域之IC需求。鑑於產業對高階封測產能的需求不斷成長，我們過去在技術與產能的投資已為這成長趨勢作好準備。

展望2004年，我們將持續積極投資高階封裝測試技術與產能，同時致力提昇獲利率。今年正逢日月光成立第20年，我們對日月光在這20年的成績感到驕傲，而對未來的展望更是充滿信心。

3. 市場現況

地區	單位：百萬美元			年成長率（%）		
	2002（a）	2003（a）	2004（e）	2002	2003	2004
美洲	31,275.40	32,325.60	38,047.23	-1.26	3.3	17.7
歐洲	27,788.50	32,360.90	37,117.95	-8.00	16.5	14.7
日本	30,493.60	38,954.20	45,927.00	-8.00	27.7	17.9
亞洲	51,155.70	62,827.20	77,528.76	28.00	22.8	23.4
合計	140,713.30	166,467.92	198,620.94	1.26	18.3	19.4

資料來源：美國半導體產業協會，2004年2月

根據美國半導體產業協會（SIA）指出，全球半導體產業在2003年成長18.3%後，估計2004年成長率更可擴張19.4%以上。SIA預估，北美、日本市場將可望成長17%，至於亞洲則將勁揚 23%，其中以台灣和南韓成長幅度最為傑出。價格持續上揚，將可望貢獻今年成長幅度的一半；需求走強將使晶片廠產能緊縮，高階製程產能利用率更可逼近滿載，將超越現階段平均90%的利用率。

另外，美國市場調查公司iSuppli公佈數據顯示，2003年底時，電子產業供應鏈後端庫存特別低；電子產品製造商全年皆維持最低的供應水準，其庫存水平也是三年以來最低。除了PC相關晶片商外，其他半導體次部門如可編程邏輯元件、類比／電源和通訊晶片目前庫存皆處於三年來新低。2004年第一季半導體之強勁需求已使前置時間（lead time）開始拉長，隨著產能緊縮，晶片客戶可能必須開始採取雙重下單的策略，以確保所需元件供應無虞，進而促使前端供應鏈增加庫存，使庫存水平超越安全水準。

從設備的角度來看，根據美國市場調查公司VLSI Research在2004年公佈的預測數字，預計全球IC設備市場（不包含晶圓製造）在2004年將有40.1%的成長，達到435億美元的市場規模；而全球IC測試相關設備市場，其2004年市場規模將較2003年成長42.1%，達到107億美元；IC相關封裝市場將於2004年成長40.3%達32億美元。

另外美國市場調查公司IC Insight指出，2000年半導體廠商在資本方面支出佔總產值的30%，而2003年資本支出雖然在下半年已逐漸提升，全年度仍只佔總產值的18%，已低於1990年代初期的19%，由於2002及2003年度在設備方面投資比率偏低，將導致2004年特別是在高階產能方面會出現產能不足，需求持續發燒的現象。

4. 市場未來之供需狀況與成長性

根據Electronic Trend Publications最新公佈的數據顯示，IC封裝市場以每年約7.9%的成長率，由2002年134億美元的市場規模，成長至2004年的167.5億美元，預計2007年的市場規模會高達200億美元。

以封裝型態而言，2003年BGA封裝的總產值為36.7億美元，首度超過SO封裝35.6億美元的產值，成為主流封裝型態，並預計2002年至2007年五年間的成長率為13.39%。

CSP封裝型態是市場中成長最快的領域，並在2002年2007年間預計每年以17.58%成長。CSP封裝總產值在2003年約13.9億美元；QFP封裝是第三大封裝市場，年成長率約4.77%，其2003年總產值約28.8億美元；PGA年成長率約6%，其2003年總產值約27.5億美元。

在委外代工封裝測試市場方面，由於國際IDM大廠面臨產品世代快速交替的競爭壓力，轉而專注於產品設計、研發、行銷等核心優勢。同時，國際IDM大廠受產業不景氣的影響，獲利能力大減，因此大幅削減半導體產能的資本支出，對於後段封裝之產能擴建趨於保守。與此同時，居於領先地位的封裝代工廠不斷地投入研發新技術，因應各項新型態IC產品所帶來的高階封裝需求。因此，國際IDM大廠逐漸仰賴封裝測試代工廠在先進封測型態的製程能力。依據市場調查公司迪訊（Dataquest）預估，IC封裝委外代工市場之規模在2006年將成長至183億美元；而2002年至2006年間之複合年成長率達22%，其中國際IDM大廠加速委外代工是一重要因素。

2001~2007年半導體封裝及測試市場成長情形

（單位：百萬美元）	封裝及測試市場整體規模						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
封裝測試整體市場規模	24,893	26,751	29,560	35,005	41,770	40,953	44,617
封裝整體市場規模	19,954	21,476	23,605	27,968	33,194	32,610	35,344
測試整體市場規模	4,939	5,275	5,955	7,037	8,576	8,343	9,273

（單位：百萬美元）	IDM半導體封裝及測試市場整體規模						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
IDM內部封裝測試整體市場規模	17,750	18,383	19,355	20,855	23,625	22,654	23,982
IDM內部封裝整體市場規模	14,200	14,691	15,550	16,735	18,969	18,166	19,187
IDM內部測試整體市場規模	3,550	3,692	3,805	4,120	4,656	4,488	4,795

（單位：百萬美元）	專業代工封裝及測試市場整體規模（SATS）						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
專業代工封裝測試整體市場規模	7,143	8,368	10,205	14,150	18,145	18,299	20,635
專業代工封裝整體市場規模	5,754	6,785	8,055	11,233	14,225	14,444	16,157
專業代工測試整體市場規模	1,389	1,583	2,150	2,917	3,920	3,855	4,478

	封裝及測試委外代工比例						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
委外代工比例（封裝測試）	28.7%	31.3%	34.5%	40.4%	43.4%	44.7%	46.2%
委外代工比例封裝	28.8%	31.6%	34.1%	40.2%	42.9%	44.3%	45.7%
委外代工比例測試	28.1%	30.0%	36.1%	41.5%	45.7%	46.2%	48.3%

資料來源：Dataquest

5. 競爭利基

日月光集團之所以成為全球第一大專業半導體封裝測試大廠，並能長期保持業界之領導地位，其依賴之各項競爭優勢分析如下：

（1）高階產品技術及品質居領導地位

由於半導體產品推陳出新及生產週期不斷縮減，因此半導體產品價格的變動相當劇烈。就整個半導體的成本而言，封裝的費用佔整顆半導體的售價5%~25%不等，然而隨著技術之演進，封裝成本所佔比例隨之提高。因此，對大多數國際半導體大廠的客戶而言，封裝之品質、良率以及交貨期的掌控愈形重要，同時也是封裝業者之競爭關鍵因素。日月光集團為全球第一大半導體封裝業者，技術水準已與國際大廠並駕齊驅，尤其如PBGA封裝、覆晶封裝、CSP封裝等高階產品之技術更大幅超越同業。

再者，日月光集團為保持產業之領先地位及競爭優勢，長期以來每年提撥3%-5%營業收入作為研發支出，甚至在半導體產業不景氣的2000年、2001年及2002年，仍相繼投入研發費用分別為4,100萬美元、4,500萬美元及5,939萬美元，均較同業之Amkor、矽品等為高。

（2）積極擴充產能，適時掌握IDM大廠委外代工之商機

依據美國IC設計公司協會（FSA）以及市場調查公司迪訊（Dataquest）2003年之資料顯示，過去三年由於半導體產業之不景氣，IDM大廠之產能擴充動作均呈現停滯狀態，然而封裝製程需求卻又加速由導線架式封裝（Leadframe）轉入下一代之植球式封裝（Ball Grid Array），在IDM大廠內部產能出現技術斷層之情況下，將擴大委外代工比重，預估2003年全球封裝需求成長率高達69%，測試需求則成長44%。而日月光已從今年初陸續接獲如IC設計公司Altera、LSI Logic，IDM大廠Intel、以及首度委外代工的德州儀器（TI）之訂單。

日月光集團為迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢，多年來的營運策略為積極佈局，擴充高階產能，以爭取潛在商機。以過去三年之資本支出金額來看，日月光皆大幅領先同業，更較其最大競爭對手Amkor高出數倍。而日月光在未來半導體景氣回溫、IDM大廠高階封裝訂單陸續釋出的態勢下，更可持續維持全球最大封裝測試場之龍頭寶座。

6. 發展願景之有利／不利因素與因應對策

（1）有利因素

- 2003年至2005年市場景氣預測呈現成長趨勢、全球PC更新週期來臨、新電子產品之衍生（如3G手機等），以及未來IDM大廠產能之釋出，預計將可帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 市場對新產品、新技術的需求逐漸增加，對一向在研發創新具備優勢的日月光而言是一大利多機會。
- 部份日本、韓國IC基板業者因成本過高且因虧損情況未見改善，已開始慢慢退出PBGA市場；且於韓國LG宣布退出BGA基板市場後，市場預估未來BGA基板價格應會逐步走穩；隨著封裝趨勢的需求，BGA封裝、覆晶封裝及CSP封裝所需之基板在市場需求之帶動下將持續成長。由於日月光擁有高階基板穩健的自供能力，不但可掌握高階封裝材料之關鍵，更可有效降低IC的整體製造成本，提高獲利能力。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外，更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品等相關晶片，以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發；日月光三年三倍的成長契機即由此端萌芽。
- 2003年至2005年間中國大陸對積體電路的需求將會有大幅成長，而中國大陸電子產業的發展潛力對國際半導體廠商仍蘊含龐大商機；基於群聚效應、供應鏈原則，以及大陸內部的高額加值稅，日月光已在地理位置及資源運用方面之佈局作好準備，迎接這波成長及搶先商機。

（2）不利因素

- 本土同業競爭者對爭取日月光的客戶相當積極；另外，競爭者的聯盟機制亦有可能對日月光產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降，競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短，對一向以技術取得優勢的日月光是一項外在威脅；由於新技術的研發需投入大量的資金與人力，因此在後續價格上，日月光在價格上的變動彈性相對較弱，在微利時代下，實為一項挑戰。
- IC封裝、測試產業目前仍為買方市場，產品價格下降的壓力不斷衝擊晶圓代工與封測業者，日月光生產成本的改善速度需大於降價幅度才得以抵銷市場的降價壓力以擴增獲利空間；客戶端對於IC後段封、測之要求水準日益嚴苛，日月光業務成長如要有顯著的表現必須超越IDM的期待。
- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業，因而受到半導體市場景氣影響甚巨，營運的優劣多受景氣所引導；IC封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單以及不景氣時訂單減少的衝擊。

(3) 因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益，強化競爭優勢以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由日月光特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線，提供與滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失，建立最佳化製程，提升製程穩定性，強化日月光在成本和品質方面的競爭力，爭取最大的市場契機。
- 憑藉日月光先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源，擴大業務版圖，加速達成三年成長三倍之目標。
- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能，加速完成使命與目標。
- 日月光在材料、封裝、測試方面的垂直整合及橫向鏈結合作，除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外，更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢，依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求，提升服務品質的競爭力，同時建立專利防護網，削減其他業者的模仿速度。
- 提升客戶對日月光一元化服務的訂單比例，加快整合速度，以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服務。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
●塑膠立體型積體電路(PDIP)	●主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航設備等零件的更換或製造。
●塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC) ●平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) ●凸塊晶片承載器積體電路(BCC) ●覆晶(Flip Chip)封裝技術 ●超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路(LQFP, TQFP) ●球型陣格承載器積體電路(BGA、TFBGA, LBGA) ●覆晶式球型陣格承載器積體電路(FC BGA, HFC BGA) ●散熱增益球型陣格承載器積體電路(TE BGA) ●超薄球型陣格承載器積體電路(VF BGA) ●無引腳型陣格承載器積體電路(LGA) ●外露晶片四邊平面形積體電路(Exposed Pad QFP) ●散熱增益球型閘陣列承載器積體電路(HSBGA) ●扁平式無引腳型陣格承載器積體電路(QFN)	●主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、大哥大等。 ●無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。 ●個人電腦與筆記型電腦等。 ●電視遊樂器、DVD、機上盒等· ●個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。
●小型晶粒承載器積體電路(SOP, SOJ) ●超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP) ●晶片堆疊式球型陣格承載器積體電路(SCSP)	●主要用途在於記憶體積體電路之封裝。 ●個人電腦與週邊裝備等。
●立體式晶片模組承載器積體電路(3D Package) ●晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路(Stacked BGA) ●多晶片模組球狀陣格承載器積體電路(MCM BGA)	●主要用途在於各種可移動式的資訊產品，例如：手機、PDA、數位相機等。筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
●晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer Lever CSP) ●覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP)	●主要應用在可移動式的資訊產品，例如：手機、PDA、數位相機等。
●透明膠模鑄封裝型積體電路(Clear compound molded IC package) ●晶圓級CMOS影像感測器封裝技術(Wafer level CMOS image sensor) ●微機電型微顯示器(MEMS-based Micro display)	●主要應用在影像相關之資訊產品，例如：具相機功能的手機、影像感測器等。

2. 產製過程

具釘架類產品　　晶圓切割 → 晶粒置放 → 打線 → 封模 → 正印 → 外腳成型 → 外觀檢驗 → 包裝

球陣列類產品　　晶圓切割 → 晶粒置放 → 打線 → 封模 → 正印 → 植錫球 → 切割成型 → 外觀檢驗 → 包裝

覆晶類產品　　錫突塊 → 晶圓切割 → 覆晶式晶粒粘著 → 底膠充填 → 正印 → 植錫球 → 外觀檢驗 → 包裝

（三）主要原料之供應狀況

日月光公司係從事半導體代客封裝，主要晶圓由客戶提供。客戶均為國際知名半導體公司，長期與本公司保持良好關係。

主要封裝材料如：導線架、基板、銀膠、金線、錫球等，供應商皆為本公司品管審查合格之績優廠商，尤其導線架、基板的主要供應商日月宏科技（股）公司，為本公司持有超過50％管控之子公司，且將於93年與本公司合併，加上本公司與台灣最大基板製造商華通電腦股份有限公司合資設立IC基板公司，將使材料的取得可完全掌握。

（四）最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進銷貨金額與比例

1. 占銷貨百分之十以上之客戶名稱

單位：新台幣千元

排名	92年度			91年度		
	客戶名稱	金額	%	客戶名稱	金額	%
1	A公司	4,702,705	14.9	B公司	3,220,023	12.6
2	B公司	3,638,735	11.5	A公司	2,234,723	8.7
	全年度銷貨淨額	31,487,791	100.0	全年度銷貨淨額	25,631,776	100.0

2. 占進貨百分之十以上之進貨廠商

單位：新台幣千元

排名	92年度			91年度		
	廠商名稱	金額	%	廠商名稱	金額	%
1	日月宏公司	4,416,271	26.8	日月宏公司	2,885,588	23.5
2	甲公司	2,061,104	12.5	甲公司	1,519,142	12.4
3	乙公司	1,596,976	9.7	乙公司	1,297,409	10.6
	全年度進貨淨額	16,472,362	100.0	全年度進貨淨額	12,271,377	100.0

本公司與主要進貨廠商已建立穩定之長期合作關係，本年度與上年度進貨廠商並無太大變動。

（五）最近二年度生產量值表

單位：千個 / 新台幣千元

年度 / 主要商品 / 生產量值	92年度			91年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
PDIP	141,120	44,042	175,828	139,868	61,987	236,460
PLCC	60,480	39,336	231,143	60,270	46,012	265,852
EQFP	330,288	259,800	3,385,009	286,112	234,176	3,042,089
LQFP	422,352	384,559	4,085,738	396,030	315,856	3,361,362
SOP/SOJ/SSOP/TSOP	292,320	200,229	884,433	247,024	206,896	938,475
BGA	537,600	405,633	15,016,008	456,811	335,460	11,678,756
BCC	252,000	211,686	1,047,731	230,479	169,226	821,428
其他			921,876			309,291
合計	2,036,160	1,545,285	25,747,765	1,816,664	1,369,613	20,653,713

（六）最近二年度銷售量值表

單位：千個 / 新台幣千元

年度 / 銷售量值 / 主要商品	92年度				91年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
PDIP	16,168	47,854	27,874	82,503	22,935	69,171	39,052	117,777
PLCC	14,440	93,459	24,896	161,127	17,024	113,844	28,987	193,842
EQFP	95,373	1,475,796	164,427	2,544,337	86,645	1,371,753	147,531	2,335,687
LQFP	141,172	1,786,998	243,387	3,080,863	116,867	1,535,639	198,989	2,614,736
SOP/SOJ/SSOP/TSOP	73,504	350,619	126,725	604,483	76,552	380,445	130,344	647,785
BGA	148,908	6,943,798	256,724	11,971,415	119,043	5,266,652	216,417	9,063,321
BCC	77,710	477,102	133,976	822,545	67,691	472,507	101,536	708,761
其他		383,581		661,311		366,497		373,359
合計	567,276	11,559,207	978,010	19,928,584	506,757	9,576,508	862,856	16,055,268

三. 組織人力現況

（一）組織

本公司基於能維持有利的競爭市場，培育優秀的工程人力資源，健全公司組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等是刻不容緩的首要策略。

（二）最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		92年度	91年度	93年2月29日
員工人數	技術職人員	2,212	1,851	2,235
	管理職人員	217	175	233
	事務職人員	882	684	922
	作業員	6,647	5,822	6,558
	合計	9,958	8,532	9,948
平均年齡		28.8	28.7	29.1
平均服務年資		3.39	3.58	3.48
學歷分布比率	博士	0.1	0.1	0.1
	碩士	2.2	2.0	2.3
	大專	47.9	49.4	49.6
	高中	49.8	48.5	47.7
	高中以下	－	－	－

四. 環保支出資訊

1. 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）。

- 93年度：除93年1月29日高雄市環保局稽查k3廢水排放口，該單位所測得的銅含量為3.65mg/l超過排放標準3mg/l，遭高雄市政府環境保護局罰款六萬元，本公司並於同日完成改善外，截至年報刊印日止無再發現其他重大環境污染事件。
- 92年度：全年度均符合環保法規要求，無重大環境污染事件發生。
- 91年度：除91年11月因廢棄物處理商將一般事業廢棄物露天貯放，遭高雄市政府環境保護局罰款六仟元，並於同年11月完成改善外，尚無重大環境污染事件。

2. 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出。

項目	九十三年度	九十四年度	九十五年度
擬採行改善措施部分 (1) 改善計劃	1. 增設廢水處理廠 2. 增設廢氣防制設備(VOC處理設備) 3. 廢水防治設備改善 4. 增設廢氣防制設備管線翻修 5. 蓄熱式焚化爐異常改善 6. 能源節約 7. 廢棄物減廢 / 減量計劃 8. 廢水回收 9. 增設空污酸洗管線 10. 含銅污泥減重、減量 11. 酸鹼廢液再利用 12. 噪音防制	1. 廢氣防治設備填充料更換 2. 廢水防治設備改善 3. 能源節約 4. VOC減量 5. 廢水回收 6. 能源節約 7. 廢棄物減廢 / 減量 8. 增設空污酸洗管線	1. 廢氣防制設備填充料更換 2. 廢水防治設備改善 3. 能源節約 4. VOC減量 5. 廢水回收 6. 能源節約 7. 廢棄物減廢 / 減量 8. 增設空污酸洗管線 9. 污泥減重、減量 10. 酸鹼廢液再利用
(2) 未來二年預計環保資本支出擬購置之污染設備或支出內容	1. 環保設備改善 2. 污染防治 3. 能源節約設備 4. 污泥烘乾設備 5. 增設噪音防制設施 6. 增設VOC處理設備 7. 增設酸鹼廢液再利用設施	1. 廢水廢氣防治設備改善 2. 增設資源回收處理設備 3. 增設VOC處理	1. 廢水廢氣防治設備改善 2. 增設VOC處理設備 3. 降低污泥含水率 4. 增設酸鹼廢液再利用設施
預計改善情形	1. 提升設備處理效率 2. 減廢 / 減量 / 資源回收 3. 減少能源耗用 4. 減少噪音	1. 延長設備壽命 2. 減廢 / 減量 / 資源回收 3. 減少能源耗用 4. 降低VOC排放量	1. 延長設備使用壽命 2. 減廢 / 減量 / 資源回收 3. 減少能源耗用 4. 降低VOC排放量
金額	72,000仟元	20,000仟元	31,000仟元
(3) 改善後之影響			
對淨利之影響	費用增加約4,586仟元	費用增加約1,800仟元	費用增加約1,986仟元
對競爭地位之影響	無重大影響	無重大影響	無重大影響
未採取因應對策部分	不適用	不適用	不適用

3. 環境政策

環境保護是我們責無旁貸的重要責任，日月光集團承諾做好污染預防及持續改善之工作，以響應全球環保運動，本公司之環境政策如下：

- 符合政府環保法規及相關法規規定。
- 教育員工，提昇全體員工環境保護意識。
- 加強廢水、廢氣、廢棄物、噪音、毒化物等對環境的衝擊污染控制、改善，並注重污染預防工作。
- 節約能源及資源，進行資源回收。
- 在環境保護的相關議題上與大眾及相關團體做密切的溝通與合作。
- 承諾持續改善，確保永續經營。
- 傳達本政策，使大眾和相關團體了解日月光集團於環境保護上管理的企圖心。

4. 安全衛生政策

日月光集團高雄廠承諾將提供並保持一個符合安全衛生法令規範及促進員工安全健康的作業場所，並營造一個安全舒適的工作環境。

本公司的承諾：

- 致力符合安全衛生法令及相關要求。
- 持續改善並降低損傷事故發生，確信災害的損失可經由完善管理系統達到控制。
- 提供相關教育訓練資源，提昇員工的安全認知。
- 對供應商、承攬商及客戶宣導我們致力於工作環境改善的決心。

五. 勞資關係

1. 員工福利措施

本公司體認勞資一體的關係，於民國八十五年董事會中決議，除自每年所得盈餘中提撥5%~7%作為員工紅利外，全面改善福利文康設施，舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等，使得全廠員工均有調劑身心的機會，並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下：

- 免費提供員工及眷屬團體醫療保險
- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議。
- 成立勞工安全衛生督導委員會。
- 成立福利委員會辦理各項員工福利。
- 自助餐廳及福利社。
- 結婚禮金、喪葬津貼、住院慰問金、及獎助學金。
- 完善的退休制度。
- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險1000萬元。
- 假日安親措施。
- 假日免費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 員工認股權憑證

2. 員工進修及其實施情形

- 員工在職進修取得相關科系學歷者，可參加學歷升級考試，並予以實質調薪鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道，辦理『職訓局』台德菁英計劃。

3. 員工訓練及其實施情形

- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練（OJT）。
- 培育公司內部專業講師與訓練師。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。

4. 退休制度及實施情形

本公司自民國七十五年十一月起即遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法，並設立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥勞工退休準備金存入中央信託局專戶，勞工退休時可請領退休金。

九十二年度並增訂優惠退休條件：工作滿十五年以上，年齡與工作年資合計滿七十以上者，得自請退休。

5. 勞資協議情形

本公司設有書面及電子化員工溝通管道且各廠均定期召開員工座談會，溝通良好，無勞資糾紛之情事。

6. 各項員工權益維護措施

- 依勞動基準法保障員工權益。
- 依兩性工作平等法提供一兩性平權及無性騷擾的工作環境。

7. 最近二年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括目前及未來可能發生之估計金額及因應措施）：無

六. 重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期 或訂約日期	主要內容	限制條款
業務契約	ASE(U.S.) INC.	2003.08-2004.07	業務代理	－
業務契約	Gardex International Ltd.	2003.08-2004.07	業務代理	－
土地租約	經濟部加工出口區管理處	1994.04-2012.12	土地租賃	於租約有效期間內,不得轉作與業務不相關之用，且依約執行付款
聯合保證公司債合約	中信銀及香港上海匯豐銀行等9家銀行	2004.01-2009.01	發行國內無擔保 普通公司債保證	財務比率限制等
聯貸契約	中信銀及香港上海匯豐 銀行等7家銀行	2004.03-2009.03	商業本票保證	財務比率限制等
聯貸契約	花旗銀行等21家銀行	2003.09-2008.09	銀行承兌匯票及台幣長借契約	財務比率限制等
聯貸契約	花旗銀行等26家銀行	2002.12-2005.12	台幣長期借款契約	財務比率限制等
專利契約	MOTOROLA INC.	2003.01-2010.12	專利授權	保密條款
專利契約	FUJITSU LIMITED	1998.04-2003.04	專利授權	保密條款
專利契約	FLIP CHIP TECHNOLOGIES LLC.	1999-2009	專利授權	保密條款
專利契約	TESSERA U.S.A.	1998.01-2016.10	專利授權	保密條款
專利契約	某跨國公司	2000.07-2005.12	專利授權	保密條款
合併契約	日月欣半導體股份有限公司及 日月宏科技股份有限公司	2003.10.28	本公司為存續公司，日月欣公 司及日月宏公司為消滅公司	無
股權買賣合約	J&R Holding Ltd. ,NEC Electronics Corporation及NEC Yamagata, Ltd.	2004.02.03	由NEC Yamagata, Ltd.成立子公司並將其所有山形縣IC封裝測試廠之營業及資產移轉予該子公司後，由本公司子公司 J&R Holding Ltd.購買該子公司之股份	保密條款
封裝測試服務合約	NEC Electronics Corporation	2004.02.03	議定於J&R Holding Ltd.取得 NEC Yamagata, Ltd.成立之子公司股權後由該子公司提供封裝測試服務予 NEC Electronics Corporation	保密條款

註：係為截至年報刊印日止之資料。

七. 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、持股比例超過10%以上之大股東及從屬公司，最近二年度及至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

本公司董事長張虔生及副董事長張洪本，因涉背信及偽造文書罪嫌經台北地方法院檢察署檢察官於八十七年十二月七日提起公訴，除張洪本部份經台北地方法院於八十九年十二月二十六日以八十七年度易字第四三三五號判處無罪確定外，張虔生經台灣高等法院以九十年度上訴字第六六五號判決連續行使偽造私文書，處有期徒刑四年。張虔生對前揭判決提起上訴，並經最高法院九十二年一月二十三日以九十二年度台上字第三三四號判決撤銷原審關於張虔生部分之判決，並發回台灣高等法院。台灣高等法院嗣於九十三年一月七日以九十二年度上更（一）字第一〇五號判決張虔生無罪確定在案。

八. 取得或處分資產

（一）最近一年度截至年報刊印日止取得重大資產資料

單位：新台幣千元（除另予註明外）

取得之公司	資產名稱	取得年月	購價	賣方	與公司之關係	使用情形
日月光半導體製造（股）公司	日月欣半導體公司股票	92.01	500,000	—	被投資公司	長期股權投資
	ASE Holding (Bermuda) Ltd. 股票	92.07	478,753	—	被投資公司	長期投資
	供營業用之機器設備	92.03	300,177	INTERCON TOOLS, INC	無	自用
	供營業用之機器設備	92.08	573,981	KULICKE & SOFFA Industrial Inc.	無	自用
	供營業用之機器設備	93.03	1,086,804	KULICKE & SOFFA Industrial Inc.	無	自用
日月宏科技（股）公司	新光吉利債券基金	91.01-92.01	351,000	新光證券投資信託（股）公司	無	短期投資
日月欣半導體（股）公司	保誠威寶債券基金	92.01-92.12	462,000	保誠證券投資信託（股）公司	無	短期投資
	建弘全家福基金	92.01-92.12	410,000	建弘證券投資信託（股）公司	無	短期投資
	保誠威鋒二號債券基金	92.01-92.12	390,000	保誠證券投資信託（股）公司	無	短期投資
日月瑞（股）公司	日盛債券基金	92.01-92.12	3,819,060	日盛證券投資信託（股）公司	無	短期投資
	金鼎債券基金	92.01-92.12	1,140,124	金鼎證券投資信託（股）公司	無	短期投資
	盛華1699債券基金	92.01-92.12	878,694	盛華證券投資信託（股）公司	無	短期投資
	聯邦債券基金	92.01-92.12	641,718	聯邦證券投資信託（股）公司	無	短期投資
	建弘台灣債券基金	92.01-92.12	604,454	建弘證券投資信託（股）公司	無	短期投資
台灣福雷電子（股）公司	供營業用之機器設備	92.01-92.12	890,390	AGILENT TECHNOLOGIES SING	無	自用
	供營業用之機器設備	92.01-92.12	527,485	TERADYNE INC.	無	自用
	供營業用之機器設備	92.01-92.12	428,270	NPTEST TECHNOLOGIES PTE LTD	無	自用
	供營業用之機器設備	92.01-92.12	322,639	KANEMATSU CORPORATION	無	自用
	供營業用之機器設備	92.01-92.12	351,197	SPIROX CORPORATION	無	自用
ASE Holding (Bermuda) Ltd.	ASE Investment (Labuan) Inc.	92.07	美金13,913仟元	—	被投資公司	長期股權投資

註：取得基金者得彙總揭露。

（二）最近一年度截至年報刊印日止處分重大資產資料

單位：新台幣千元（除另予註明外）

處分之公司	資產名稱	處分年月	未折減餘額	處分價格	處分損益	買方	與公司之關係
日月興投資（股）公司	日月光半導體製造公司普通股股票	92.06	1,001,166	374,668	(626,498)	於集中市場處分	被投資公司
日月瑞（股）公司	日盛債券基金	92.01-92.12	2,900,188	2,915,560	15,372	日盛證券投資信託（股）公司	無
	金鼎債券基金	92.01-92.12	1,430,209	1,436,447	6,238	金鼎證券投資信託（股）公司	無
	盛華1699債券基金	92.01-92.12	706,007	710,694	4,686	盛華證券投資信託（股）公司	無
	建弘台灣債券基金	92.01-92.12	675,830	679,454	3,625	建弘證券投資信託（股）公司	無
	聯邦債券基金	92.01-92.12	509,092	511,718	2,626	聯邦證券投資信託（股）公司	無
日月新投資（股）公司	日月光半導體製造公司普通股股票	92.06	1,983,409	2,475,856	492,447	於集中市場處分	被投資公司
日月欣半導體（股）公司	建弘全家福基金	92.01-92.12	410,000	413,372	3,372	建弘證券投資信託（股）公司	無
	保誠威寶債券基金	92.01-92.12	462,000	466,255	4,255	保誠證券投資信託（股）公司	無
	保誠威鋒二號債券基金	92.01-92.12	390,000	392,448	2,448	保誠證券投資信託（股）公司	無
J&R Holding Ltd.	ASE Test Finance 1% Guaranted Convertible Notes	92.07	美金50,000千元	美金 65,291千元	美金15,291千元	ASE Test Finance	被投資公司

註：處分基金者得彙總揭露。

肆. 資金運用計劃執行情形

截至年報刊印日之前一季止已募集完成但尚未執行完畢之計劃：

發行計劃	第二次海外可轉換公司債				
發行金額	美金20,000仟元（折合新台幣6,880,000仟元）				
資金用途	償還銀行借款				
截至年報刊印日止之執行進度			執行狀況		
			92年第四季	93年第一季	合計
	支用金額	預定	5,400,800	1,479,200	6,880,000
		實際	5,400,800	1,479,200	6,880,000
	執行進度	預定	78.5%	21.5%	100%
		實際	78.5%	21.5%	100%
	註：本計劃已於93.01.30執行完畢。				
輸入公開資訊觀測站日期	92.09.25				
效益及財務結構分析	本公司發行公司債以償還即將到期之銀行短期借款，除可提高公司流動、速動比率及長期資金／固定資產比率外，更可免除因景氣回升利率上揚，造成本公司財務利息之負擔，並提高財務操作靈活度及強化財務結構，且可掌握長期資金來源，有助於未來業務競爭力之提昇及並降低營運風險。				

伍. 財務資料

一. 最近五年度簡明資產負債表及損益表

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度		最近五年度財務資料（註1）				
		九十二年底	九十一年底	九十年底	八十九年底	八十八年底
流動資產		15,724,356	11,907,514	14,541,740	14,290,982	7,936,386
基金及長期投資		35,231,946	34,344,162	38,219,384	38,020,597	29,424,048
固定資產		22,866,828	20,888,848	18,058,451	17,714,958	12,552,594
無形資產		－	－	－	－	－
其他資產		2,760,994	1,440,314	837,011	699,608	542,691
資產總額		76,584,124	68,580,838	71,656,586	70,726,145	50,455,719
流動負債	分配前	10,287,608	11,704,753	12,727,781	11,906,614	6,257,380
	分配後	10,287,608（註2）	11,715,033	12,727,781	12,020,214	6,409,249
長期負債		20,715,922	17,121,519	16,726,610	14,033,688	13,729,681
其他負債		457,992	323,900	255,874	1,116,629	411,622
負債總額	分配前	31,461,522	29,150,172	29,710,265	27,056,931	20,398,683
	分配後	31,461,522（註2）	29,160,452	29,710,265	27,170,531	20,550,552
股本		35,802,800	32,548,000	32,548,000	27,520,000	19,800,000
資本公積		4,046,774	6,925,527	6,851,514	7,270,825	683,674
保留盈餘	分配前	3,808,436	1,173,564	1,015,654	8,200,947	9,243,346
	分配後	3,808,436（註2）	1,065,640	1,015,654	3,059,347	2,375,028
長期投資未實現跌價損失		(68,833)	(423,620)	(442,246)	(546,829)	－
累積換算調整數		1,559,599	1,847,021	1,973,399	1,224,271	330,016
未認列為退休金成本之淨損失		(16,137)	－	－	－	－
股東權益總額	分配前	45,122,602	39,430,666	41,946,321	43,669,214	30,057,036
	分配後	45,122,602（註2）	39,420,386	41,946,321	43,555,614	29,905,167

註1：（一）最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。
（二）最近五年度均未曾辦理資產重估。

註2：截至年報刊印日止，本公司九十三年股東常會尚未召開，是以分配後金額暫以分配前金額列示。

2. 簡明損益表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近五年度財務資料（註1）				
	九十二度	九十一度	九十年度	八十九年度	八十八年度
營業收入	31,487,791	25,631,776	20,508,233	25,524,296	17,498,901
營業毛利	5,740,026	4,978,063	3,368,819	6,994,693	4,590,097
營業利益	3,431,967	3,186,243	1,721,473	5,261,046	3,223,056
營業外收入及利益	159,405	489,506	400,887	2,496,625	5,903,810
營業外費用及損失	1,497,740	4,312,563	4,649,916	1,098,808	1,089,164
稅前利益（損失）	2,093,632	(636,814)	(2,527,556)	6,658,863	8,037,702
非常（損）益	－	(34,613)	(144,565)	－	－
純益（損）	2,742,796	129,035	(2,142,219)	5,837,149	7,794,666
每股盈餘（純損）（元 / 股）（追溯調整後）					
基本每股盈餘（純損）	0.78	0.04	(0.60)	1.67	2.26
稀釋每股盈餘（純損）	0.78	0.04	(0.60)	1.64	2.23

註1：（一）最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。
（二）最近五年度均未曾辦理資產重估。
（三）各年度利息資本化金額如下：

九十二年度	96,795千元	九十一年度	114,707千元
九十年度	5,858千元	八十九年度	106,184千元
八十八年度	81,773千元		

3. 最近五年度會計師查核意見

年度	會計師姓名	會計師姓名	查核意見
88	陳政弘	龔俊吉	無保留意見
89	陳政弘	龔俊吉	無保留意見
90	陳政弘	龔俊吉	無保留意見
91	陳政弘	龔俊吉	無保留意見
92	曾光敏	陳政弘	無保留意見

二. 財務分析

分析項目 \ 年度			最近五年度財務分析				
			92年度	91年度	90年度	89年度	88年度
財務結構（%）	負債佔資產比率		41.08	42.50	41.46	38.26	40.43
	長期資金佔固定資產比率		287.92	270.73	324.91	325.73	348.83
償債能力（%）	流動比率（%）		152.85	101.73	114.25	120.03	126.83
	速動比率（%）		121.55	80.51	86.26	98.16	100.95
	利息保障倍數（次）		4.22	0.35	(1.05)	7.25	12.66
經營能力	應收款項週轉率（次）		4.84	5.05	4.31	5.78	5.22
	平均收現天數（日）		75	72	85	63	70
	存貨週轉率（次）		12.02	12.97	10.36	12.40	12.15
	應付帳款週轉率（次）		6.73	7.47	7.07	8.55	7.80
	平均銷貨日數（日）		30	28	35	29	30
	固定資產週轉率（次）		1.38	1.23	1.14	1.44	1.39
	總資產週轉率（次）		0.41	0.37	0.29	0.36	0.35
獲利能力	資產報酬率（%）		4.45	1.23	(1.71)	10.95	19.26
	股東權益報酬率（%）		6.49	0.32	(5.00)	15.83	30.02
	佔實收資本比率（%）	營業利益	9.59	9.79	5.29	19.12	16.28
		稅前純益	5.85	(1.96)	(7.77)	24.20	40.59
	純益率（%）		8.71	0.50	(10.45)	22.87	44.54
	每股盈餘（純損）元 / 股（追溯調整後）	基本	0.78	0.04	(0.60)	1.67	2.26
		稀釋	0.78	0.04	(0.60)	1.64	2.23
現金流量（%）	現金流量比率（%）		53.93	52.80	39.45	67.06	61.62
	現金流量允當比率（%）		69.12	71.64	63.43	104.16	92.21
	現金再投資比率（%）		6.63	8.72	7.20	12.24	7.94
槓桿度	營運槓桿度		3.32	3.23	4.79	2.17	2.59
	財務槓桿度		1.23	1.44	3.52	1.25	1.27

註1：最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

註2：財務分析項目之計算公式如下：

計算公式：

1. 財務結構
   （1）負債占資產比率＝負債總額 / 資產總額
   （2）長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）/ 固定資產淨額
2. 償債能力
   （1）流動比率＝流動資產 / 流動負債
   （2）速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）/ 流動負債
   （3）利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出
3. 經營能力
   （1）應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝銷貨淨額 / 各期平均應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額
   （2）平均收現日數＝365 / 應收款項週轉率
   （3）存貨週轉率＝銷貨成本 / 平均存貨額
   （4）應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝銷貨成本 / 各期平均應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額
   （5）平均銷貨日數＝365 / 存貨週轉率
   （6）固定資產週轉率＝銷貨淨額 / 固定資產淨額
   （7）總資產週轉率＝銷貨淨額 / 資產總額

4. 獲利能力
   （1）資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額
   （2）股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額
   （3）純益率＝稅後損益／銷貨淨額
   （4）每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數（註3）

5. 現金流量
   （1）現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
   （2）淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）
   （3）現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）（註4）

6. 槓桿度：
   （1）營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益（註5）
   （2）財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）

註3：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。

註5：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

三．監察人審查報告書

董事會造送本公司九十二年度經勤業眾信會計師事務所曾光敏會計師及陳政弘會計師查核簽證之財務報表，暨營業報告書、盈餘分派議案等表冊，移由本監察人審查完竣，尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，

敬請　鑒察為荷。

此致

本公司民國九十三年股東常會

日月光半導體製造股份有限公司

監察人：　馮美珍　何弘　羅瑞榮　鄭天正　曾元一







中華民國九十三年三月二十五日

四. 最近年度財務報表，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達日月光半導體製造股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二及九十一年度之經營成果與現金流量。

日月光半導體製造股份有限公司已編製其與子公司民國九十二及九十一年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告，備供參考。

日月光半導體製造股份有限公司民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述之財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所

會計師 曾光敏



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 陳政弘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中華民國九十三年二月六日

日月光半導體製造股份有限公司
資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元
（惟每股面額為元）

代碼	資產	九十二年底 金額	%	九十一年底 金額	%
	流動資產				
1100	現金	$ 4,839,182	6	$ 3,841,802	6
1110	短期投資（附註二及三）	154,229	–	67,893	–
1120	應收票據	102,717	–	94,634	–
1140	應收帳款（附註四）	7,172,909	9	5,327,472	8
1150	應收關係人款項（附註十九）	235,530	–	91,531	–
1160	其他應收款	31,650	–	64,008	–
120X	存貨（附註二及五）	2,649,513	4	1,634,127	2
1286	遞延所得稅資產（附註二及十六）	481,632	1	722,000	1
1260	預付款項及其他	56,994	–	64,047	–
11XX	流動資產合計	15,724,356	20	11,907,514	17
	長期投資				
142101	採權益法之長期投資（附註二及六）	35,166,806	46	34,344,162	50
1425	預付長期投資款(附註六)	12,000	–	–	–
1428	其他長期投資	50,000	–	–	–
1440	其他金融資產－非流動	3,140	–	–	–
14XX	長期投資合計	35,231,946	46	34,344,162	50
	固定資產（附註二、七、十二、二十及二十一）				
1501	土地	61,984	–	61,984	–
1521	建築物及附屬設備	7,809,214	10	6,464,887	9
1531	機器設備	29,001,866	38	21,046,752	31
1551	運輸設備	48,102	–	44,352	–
1561	生財器具	347,285	1	315,638	1
1611	租賃資產	246,714	–	3,487,780	5
15X1	成本合計	37,515,165	49	31,421,393	46
15X9	減：累積折舊	17,429,780	23	13,955,262	20
		20,085,385	26	17,466,131	26
1671	在建工程	796,502	1	951,111	1
1672	在途機器及預付設備款	1,984,941	3	2,471,606	4
15XX	固定資產合計	22,866,828	30	20,888,848	31
	其他資產				
1820	存出保證金（附註二十）	287,157	1	105,980	–
1830	遞延費用（附註二及二十一）	1,012,603	1	778,057	1
1860	遞延所得稅資產（附註二及十六）	1,384,955	2	472,000	1
1880	其他（附註八）	76,279	–	84,277	–
18XX	其他資產合計	2,760,994	4	1,440,314	2
1XXX	資產總計	$ 76,584,124	100	$ 68,580,838	100

代碼	負債及股東權益	九十二年底 金額	%	九十一年底 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註九）	$ 682,166	1	$ –	–
2110	應付短期票券（附註十）	49,987	–	–	–
2120	應付票據	1,170	–	1,322	–
2140	應付帳款	3,128,963	4	2,330,199	3
2150	應付帳款－關係人（附註十九）	1,446,569	2	738,790	1
2160	應付所得稅（附註十六）	41,368	–	–	–
2170	應付費用（附註十三）	678,584	1	744,373	1
2224	應付設備款	1,362,793	2	2,721,735	4
2272	長期附息負債一年內到期部分（附註十二及二十）	2,841,034	3	3,907,325	6
2280	其他（附註六及十三）	54,974	–	1,261,009	2
21XX	流動負債合計	10,287,608	13	11,704,753	17
	長期附息負債				
2410	應付公司債（附註二及十一）	6,861,232	9	–	–
2420	長期負債（附註十二及二十）	13,854,690	18	17,121,519	25
24XX	長期附息負債合計	20,715,922	27	17,121,519	25
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及十三）	398,459	1	319,827	–
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二）	3,950	–	4,073	–
2888	長期股權投資貸項（附註二及六）	55,583	–	–	–
28XX	其他負債合計	457,992	1	323,900	–
2XXX	負債合計	31,461,522	41	29,150,172	42
	股東權益（附註二及十四）				
3110	普通股股本－每股面額10元，九十二及九十一年底額定分別為5,150,000千股及4,550,000千股：發行分別為3,580,280千股及3,254,800千股	35,802,800	47	32,548,000	48
	資本公積				
3211	股票溢價	14,777	–	3,171,933	5
3220	庫藏股票交易	220,735	–	–	–
3260	長期投資	3,811,262	5	3,753,594	5
32XX	資本公積合計	4,046,774	5	6,925,527	10
33XX	保留盈餘	3,808,436	5	1,173,564	2
	其他調整項目				
3410	長期股權投資未實現跌價損失	(68,833)	–	(423,620)	(1)
3420	累積換算調整數	1,559,599	2	1,847,021	3
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(16,137)	–	–	–
34XX	其他調整項目合計	1,474,629	2	1,423,401	2
3510	庫藏股票－九十二及九十一年底分別為718千股及164,442千股	(10,037)	–	(2,639,826)	(4)
3XXX	股東權益合計	45,122,602	59	39,430,666	58
	負債及股東權益總計	$ 76,584,124	100	$ 68,580,838	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：張洪本　　主辦會計：董憲

日月光半導體製造股份有限公司

損益表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
（惟每股盈餘（純損）為元）

代碼		九十二年度 金額	%	九十一年度 金額	%
	營業收入（附註二）				
4110	營業收入	$ 31,818,730	101	$ 25,929,168	101
4190	減：銷貨折讓	330,939	1	297,392	1
4000	營業收入淨額	31,487,791	100	25,631,776	100
5000	營業成本（附註十七及十九）	25,747,765	82	20,653,713	81
5910	營業毛利	5,740,026	18	4,978,063	19
	營業費用（附註十七、十九及二十一）				
6100	推銷費用	697,095	2	529,001	2
6200	管理及總務費用	854,867	3	684,874	3
6300	研究發展支出	756,097	2	577,945	2
6000	合計	2,308,059	7	1,791,820	7
6900	營業利益	3,431,967	11	3,186,243	12
	營業外收入及利益				
7110	利息收入（附註二十三）	47,670	–	268,148	1
7480	其他	111,735	1	221,358	1
7100	合計	159,405	1	489,506	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用（附註二、七及二十三）	650,447	2	977,629	4
7521	採權益法認列之投資損失（附註二及六）	473,436	1	3,143,060	12
7560	兌換損失－淨額(附註二及二十三)	197,415	1	97,351	1
7880	其他	176,442	1	94,523	–
7500	合計	1,497,740	5	4,312,563	17
7900	稅前利益（損失）	2,093,632	7	(636,814)	(3)
8110	所得稅利益（附註二及十六）	649,164	2	800,462	3
8900	列記非常損失前淨利	2,742,796	9	163,648	–
9200	非常損失－				
	係扣除所得稅利益11,538千元後之淨額（附註十一）	–	–	(34,613)	–
9600	純益	$ 2,742,796	9	$ 129,035	–

代碼		九十二年度		九十一年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘（純損）（附註十八）				
	列計非常損失前淨利（損）	$ 0.60	$ 0.78	($ 0.19)	$ 0.05
	非常損失	–	–	(0.01)	(0.01)
	純益（損）	$ 0.60	$ 0.78	($ 0.20)	$ 0.04
9850	稀釋每股盈餘（純損）（附註十八）				
	列計非常損失前淨利（損）	$ 0.59	$ 0.78	($ 0.19)	$ 0.05
	非常損失	–	–	(0.01)	(0.01)
	純益（損）	$ 0.59	$ 0.78	($ 0.20)	$ 0.04

假設子公司買賣及持有本公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：

	九十二年度	九十一年度
純益	$ 2,963,531	$ 129,035
普通股加權平均股數（千股）	3,504,700	3,399,746
加：子公司持有本公司加權平均股數（千股）	75,580	180,534
擬制性加權平均股數（千股）	3,580,280	3,580,280
基本每股盈餘		
列計非常損失前淨利	$ 0.83	$ 0.05
非常損失	–	(0.01)
純益	$ 0.83	$ 0.04
稀釋每股盈餘		
列計非常損失前淨利	$ 0.83	$ 0.05
非常損失	–	(0.01)
純益	$ 0.83	$ 0.04

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

日月光半導體製造股份有限公司
股東權益變動表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

		資本公積				
	普通股股本	股票溢價	庫藏股票交易	處分資產增益	長期投資	合計
九十一年一月一日餘額	$ 32,548,000	$ 3,171,933	$ –	$ 23,109	$ 3,656,472	$ 6,851,514
法定公積彌補虧損	–	–	–	–	–	–
處分資產增益之資本公積轉回保留盈餘	–	–	–	(23,109)	–	(23,109)
認列被投資公司處分資產增益之資本公積轉回保留盈餘	–	–	–	–	(7,352)	(7,352)
子公司持有本公司股票轉列為庫藏股票	–	–	–	–	–	–
認列長期投資股權變動調整數	–	–	–	–	104,474	104,474
認列被投資公司長期投資回升利益	–	–	–	–	–	–
九十一年度純益	–	–	–	–	–	–
累積換算調整數	–	–	–	–	–	–
九十一年十二月三十一日餘額	32,548,000	3,171,933	–	–	3,753,594	6,925,527
九十一年度盈餘分配						
法定公積	–	–	–	–	–	–
董監事酬勞	–	–	–	–	–	–
員工紅利－現金	–	–	–	–	–	–
股票股利－0.3%	97,644	–	–	–	–	–
資本公積轉作股本－9.7%	3,157,156	(3,157,156)	–	–	–	(3,157,156)
子公司出售本公司股票	–	–	220,735	–	–	220,735
認列長期投資股權變動調整數	–	–	–	–	57,668	57,668
認列子公司未認列為退休金成本之淨損失調整數	–	–	–	–	–	–
九十二年度純益	–	–	–	–	–	–
累積換算調整數	–	–	–	–	–	–
九十二年十二月三十一日餘額	$ 35,802,800	$ 14,777	$ 220,735	$ –	$ 3,811,262	$ 4,046,774

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

單位：新台幣千元

保留盈餘								
未分配盈餘		長期股權投資		未認列為退休金				
法定公積	（待彌補虧損）	合計	未實現跌價損失	累積換算調整數	成本之淨損失	庫藏股票	股東權益合計
$ 2,912,716	($ 1,897,062)	$ 1,015,654	($ 442,246)	$ 1,973,399	$ –	$ –	$ 41,946,321
(1,876,264)	1,876,264	–	–	–	–	–	–
2,310	20,799	23,109	–	–	–	–	–
–	7,352	7,352	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	(2,639,826)	(2,639,826)
–	(1,586)	(1,586)	–	–	–	–	102,888
–	–	–	18,626	–	–	–	18,626
–	129,035	129,035	–	–	–	–	129,035
–	–	–	–	(126,378)	–	–	(126,378)
1,038,762	134,802	1,173,564	(423,620)	1,847,021	–	(2,639,826)	39,430,666
12,903	(12,903)	–	–	–	–	–	–
–	(2,280)	(2,280)	–	–	–	–	(2,280)
–	(8,000)	(8,000)	–	–	–	–	(8,000)
–	(97,644)	(97,644)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	354,787	–	–	2,629,789	3,205,311
–	–	–	–	–	–	–	57,668
–	–	–	–	–	(16,137)	–	(16,137)
–	2,742,796	2,742,796	–	–	–	–	2,742,796
–	–	–	–	(287,422)	–	–	(287,422)
$ 1,051,665	$ 2,756,771	$ 3,808,436	($ 68,833)	$ 1,559,599	($ 16,137)	($ 10,037)	$ 45,122,602

日月光半導體製造股份有限公司
現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

	九十二年度	九十一年度
營業活動之現金流量		
純益	$ 2,742,796	$ 129,035
折舊	3,976,295	3,485,033
攤銷	299,101	233,021
採權益法認列之投資損失	473,436	3,143,060
海外可轉換公司債之利息補償金	67,105	138,533
海外可轉換公司債及其應付利息補償金之未實現兌換利益	(23,873)	(32,919)
海外可轉換公司債買回註銷損失	–	46,151
遞延所得稅	(672,587)	(812,000)
權益法評價長期投資配發之現金股利	17,155	43,655
衍生性金融商品（應收收益）應付價款－淨額	126,021	(120,142)
提列壞帳及銷貨折讓	146,218	63,256
匯率影響數	84,147	32,587
其他	(3,506)	(3,693)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	4,626	(8,284)
應收帳款（含關係人）	(2,108,856)	(1,024,914)
其他應收款	(6,833)	(11,555)
存貨	(1,015,599)	(84,264)
預付款項及其他流動資產	(32,867)	77,313
應付票據及帳款	1,506,391	607,705
應付所得稅	21,160	–
應付費用	(59,974)	193,400
其他流動負債	(70,597)	16,876
應計退休金負債	78,632	68,148
營業活動之淨現金流入	5,548,391	6,180,002
投資活動之現金流量		
長期投資增加	(1,135,330)	(708,145)
購置固定資產	(7,891,231)	(4,236,818)
短期投資淨（增加）減少	(97,337)	667,641
其他資產增加	(453,351)	(474,378)
存出保證金增加	(181,177)	–
合併子公司承受之現金餘額	1,596,717	–
出售固定資產價款	239,125	129,770
投資活動之淨現金流出	(7,922,584)	(4,621,930)
融資活動之現金流量		
短期借款增加（減少）	5,409,723	(454,922)
應付短期票券增加（減少）	49,987	(1,012,193)
買回及註銷海外可轉換公司債	–	(1,674,053)
長期借款增加	17,477,727	4,889,787
償還長期負債	(26,156,319)	(5,047,205)
發行海外可轉換公司債	6,684,882	–
支付員工紅利及董監事酬勞	(10,280)	–
融資活動之淨現金流入（出）	3,455,720	(3,298,586)
匯率影響數	(84,147)	(32,587)
現金淨增加（減少）數	997,380	(1,773,101)
年初現金餘額	3,841,802	5,614,903
年底現金餘額	$ 4,839,182	$ 3,841,802

單位：新台幣千元

	九十二年度	九十一年度
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	$ 727,835	$ 973,391
減：資本化利息	96,795	114,707
支付不含資本化利息	$ 631,040	$ 858,684
支付所得稅	$ 1,934	$ 1,983
僅有部分現金流量之投資及融資活動		
購置固定資產支付現金		
購置固定資產	$ 6,150,205	$ 6,362,390
應付租賃款減少	382,084	–
應付設備款（增加）減少	1,358,942	(2,125,572)
支付現金	$ 7,891,231	$ 4,236,818
出售固定資產收取現金		
出售固定資產價款	$ 265,923	$ 38,862
應收關係人款項減少（增加）	(26,798)	90,908
收取現金	$ 239,125	$ 129,770
發行海外可轉換公司債收取現金		
發行價款	$ 6,818,000	$ –
減：發行費用	119,315	–
應付費用增加	13,803	–
收取現金	$ 6,684,882	$ –
買回註銷海外可轉換公司債支付現金		
買回註銷海外可轉換公司債價款	$ –	$ 3,242,110
以償債基金抵付	–	(1,568,057)
支付現金	$ –	$ 1,674,053
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期附息負債	$ 2,841,035	$ 3,907,325
子公司出售本公司股票迴轉庫藏股票及其他流動負債至長期投資	$ 1,405,632	$ –
子公司持有本公司股票自長期投資重分類至庫藏股票及其他流動負債	$ –	$ 2,639,826

本公司於九十二年七月一日（合併基準日）吸收合併日月新投資公司及日月興投資公司（附註一），該二公司截至合併基準日止相關資產負債如下：

	日月新	日月興	合計
吸收合併長期投資減少數	$ 1,316,832	$ 230,969	$ 1,547,801
其他流動資產	(9)	(181)	(190)
遞延所得稅資產－非流動	(37)	(171)	(208)
應付帳款	20,176	3,023	23,199
應付所得稅	20,208	–	20,208
其他流動負債	5,737	170	5,907
合併子公司承受之現金餘額	$ 1,362,907	$ 233,810	$ 1,596,717

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 

經理人： 

主辦會計： 

日月光半導體製造股份有限公司
財務報表附註

民國九十二年及九十一年度　　（金額除另為註明外，以新台幣千元為單位）

1. 公司沿革及營業

本公司於七十三年三月設立於楠梓加工出口區內，並於同年七月開始營業，所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票已於台灣證券交易所掛牌上市買賣（編號2311）。本公司嗣於八十九年九月以增資發行新股方式經中華民國相關主管機關及美國證管會核准在美國首次公開發行美國存託憑證（ADR），該美國存託憑證並在紐約證券交易所掛牌上市，代號為ASX。

本公司董事會於九十一年七月十七日決議吸收合併子公司日月新投資公司及日月興投資公司（主要經營轉投資業務），經以九十二年七月一日為基準日進行集團組織重整完成合併。

本公司九十二及九十一年度平均員工人數分別約為9,500人及7,600人。

2. 重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製。依照前述準則及原則編製財務報表時，本公司對於呆帳、銷貨折讓、存貨損失、固定資產折舊、退休金及遞延所得稅資產之備抵評價等之提列，必須使用合理之估計金額，因估計通常係在不確定情況下作成之判斷，因此可能與將來實際結果有所差異。

重要會計政策彙總說明如下：

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金及預期於一年內變現或耗用之資產，資產不屬於流動資產者為非流動資產。流動負債為將於一年內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

短期投資

此係投資於國內可轉換公司債及開放型基金，以成本與市價孰低評價，跌價損失列入當年度損益。成本與市價比較時，按總成本與總市價比較，並設置備抵短期投資跌價損失之評價科目處理之；市價回升時，在已提列備抵損失餘額內沖回。成本之計算則採用加權平均法。其市價基礎：可轉換公司債為資產負債表日當月之平均收盤價，開放型基金則為資產負債表日之淨資產價值。

備抵呆帳

備抵呆帳係按應收款項帳齡及收回可能性評估提列。

存貨

存貨包括原料（不包括受託加工之晶片）、物料及零配件、製成品、在製品及在途存貨，以加權平均成本與市價孰低評價。比較成本與市價孰低時，係以分類項目為比較基礎。

存貨平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。其市價基礎：原料、物料及零配件為重置成本，製成品、在製品（即其加工成本）為淨變現價值。

長期股權投資及其貸項

本公司目前持有被投資公司有表決權股份均達百分之二十以上且具有重大影響力，是以採用權益法評價，以被投資公司同期間之純益或純損依本公司持股比例認列投資損益。因認列被投資公司之虧損而致對該被投資公司之長期股權投資帳面餘額為負數時，若本公司擔保被投資公司之債務，或有其他財務上之承諾，或被投資公司之虧損係屬短期性質，有充分之證據顯示將於未來短期內回復獲利之營運時，則按持股比例繼續認列投資損失，因而產生之長期股權投資帳面貸方餘額，則列於其他負債項下；發放現金股利時則作為投資減項。取得股權或首次採用權益法時，投資成本與所取得股權淨值間之差額，按十年平均攤銷。

被投資公司發行新股時，若未按持股比例認購，致使投資比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積及長期投資；此項調整如應調減記資本公積，而長期投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額將調減保留盈餘。

本公司與採權益法評價之被投資公司間之順、逆流交易，及採權益法評價之被投資公司間發生之側流交易，其未實現損益均已銷除。

當被投資公司之股票市價發生持久性之大幅下跌，且回復希望甚微時，則認列跌價損失。

如財務報表附註一所述，本公司吸收合併子公司日月新投資公司及日月興投資公司，係集團內組織之重整，本公司對該兩子公司長期投資餘額與子公司之淨資產相等。

固定資產

固定資產以成本或成本減累積折舊計價。固定資產購建期間為該項資產所支出款項而負擔之利息，予以資本化列為固定資產之成本。重大之更新及改良作為資本支出；修理及維護支出則作為當年度費用。

折舊按直線法依下列耐用年數計提：建築物及附屬設備，五年至五十五年；機器設備，三年至六年；運輸設備，三年至八年；生財器具，五年至十五年；租賃資產，三年至五年。耐用年限屆滿仍繼續使用之固定資產，則就其殘值按重行估計可使用年數繼續提列折舊。

固定資產出售或報廢時，其相關成本及累積折舊均自帳上減除。處分固定資產之利益及損失，依其性質列為當年度之營業外收入及利益或營業外費用及損失。八十九年度以前所產生之出售利益於扣除相關所得稅後之淨額已於當年底轉列資本公積。

資本租賃

資本租賃之租賃資產及相關之應付租賃款於租賃開始日，按下列二者較低者計價：（1）租賃開始日該資產之公平市價；（2）各期租金給付額及優惠承購價之現值。每期所支付租賃款中所隱含之利息列為當年度之利息費用。

遞延費用

遞延費用包括電話、電腦線路裝置費、電腦系統工程費、執照特許費、聯貸銀行規劃主辦費及可轉換公司債發行費用等，按二至五年平均攤銷。

退休金

退休金成本按精算結果認列，其與提撥退休準備金（附註十三）之差額列入應計退休金負債。支付退休金時由退休準備金撥付或沖抵與應計退休金負債後，倘有不足，則作為支付年度費用。

可轉換公司債

海外可轉換公司債之轉換依帳面價值法處理，即將公司債於轉換日之發行成本未攤銷餘額、應付利息補償金及公司債面額一併轉銷，並以該轉銷淨額作為債券換股權利證書之入帳基礎，此項轉銷淨額超過債券換股權利證書面額部分則列為資本公積。

庫藏股票

自九十一年度起，本公司適用新公布之財務會計準則，將子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，以九十一年初之帳面價值（子公司列為長期投資）並按持股比例計算。自長期投資調整為庫藏股票。

收入認列

半導體封裝收入於完成封裝並交運時認列，其獲利過程大部分已完成，且已實現或可實現。備抵銷貨折讓係銷貨時按估計可能發生之折讓提列。

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數量折扣後）之公平價值衡量；惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收款時，其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁，則不按設算利率計算公平價值。

所得稅

所得稅作跨期間及同期間之分攤，即將可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性認列備抵評價；應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期迴轉期間之長短劃分為流動或非流動項目。

購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減，採當期認列法處理。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度之所得稅。

每年度盈餘於次年度經股東會決議分配後，其依稅法核算之未分配餘額按百分之十課徵所得稅，於該次股東會決議後列為當年度費用。

外幣財務報表換算及以外幣為準之交易事項

非遠期外匯買賣合約之外幣交易，按交易發生時之匯率所折算之新台幣金額入帳。外幣資產及負債於實際兌換或結清時，因適用不同匯率所發生之損失或盈益，列為兌換或結清當年度之損益。外幣資產及負債之資產負債表日餘額，再按該日匯率予以折算，若有兌換損益，亦列為當年度損益。惟國外營運機構淨投資之匯率變動部分列入「累積換算調整數」，作為股東權益之調整項目。

衍生性金融商品交易

（1）遠期外匯買賣合約

避險性質之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率所折算之新台幣金額入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間攤銷認列為當年度損益。應收或應付遠期外匯之資產負債表日餘額，再以該日之即期匯率調整，所產生之差額列為當年度損益；合約結清日所產生之兌換損益列為當年度損益。

遠期外匯買賣合約所產生之應收與應付款項餘額互為抵減，其差額列為流動資產或負債。

(2) 選擇權合約

非以交易為目的之賣出選擇權收取之權利金作為收入；買入選擇權付出之權利金則作為費用。因履約而產生之損失或利益，列為當年度損失或利益。年底尚未結清之選擇權合約，則於年底按選擇權合約之市價予以評估並認列損益。

(3) 利率交換合約

為規避部分長期負債利率波動之風險所承作之利率交換合約，於簽約時僅作備忘記錄。約定結算日與資產負債表日就結算應收取或給付之差額，列為當年度利息收入或利息費用。

(4) 換匯換利合約

非以交易為目的之換匯換利合約，其本金部分以訂約日即期匯率入帳；利息部分則按約定計息期間計算收付差額，列為被避險項目收入或費用之調整。應收或應付換匯換利合約款於資產負債表日之餘額，則以該日之即期匯率調整，所產生之差額列為當年度損益；合約結清日所產生之兌換損益列為當年度損益。

換匯換利合約所產生之應收及應付換匯換利合約款於年底時餘額互為沖抵，其差額列為資產或負債（依合約到期日劃分流動或非流動資產／負債）。

科目重分類

九十一年度財務報表若干項目經予重分類，以配合九十二年度財務報表之表達。

3. 短期投資

	九十二年底	九十一年底
開放型基金	$ 155,000	$ 60,000
可轉換公司債	–	10,000
	155,000	70,000
減：備抵跌價損失	771	2,107
	$ 154,229	$ 67,893

4. 應收帳款

	九十二年底	九十一年底
應收帳款	$ 7,363,983	$ 5,483,041
減：備抵壞帳（附註二）	175,885	127,822
備抵銷貨折讓（附註二）	15,189	27,747
	$ 7,172,909	$ 5,327,472

5. 存貨

	九十二年底	九十一年底
原料	$ 2,176,231	$ 1,267,703
間接物料及零配件	166,975	160,346
在製品	230,256	166,535
製成品	167,675	84,179
在途存貨	738	47,513
	2,741,875	1,726,276
減：備抵存貨損失	92,362	92,149
	$ 2,649,513	$ 1,634,127

6. 長期股權投資及其貸項

	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
	帳面金額	股權%	帳面金額	股權%
權益法評價				
國外子公司				
J & R Holding Limited	$ 17,193,422	100.0	$ 16,968,585	100.0
ASE Holding (Bermuda) Ltd.	6,205,747	100.0	6,054,848	100.0
ASE Marketing Services Ltd.	958	100.0	1,766	100.0
ASE Japan Co.	18,462	100.0	–	–
國內被投資公司				
日月欣半導體公司（日月欣）	5,097,879	57.6	4,431,373	53.9
環隆電氣公司（環電）	3,123,672	21.6	3,207,887	21.6
日月榮投資公司（日月榮）	1,388,822	90.0	1,377,987	90.0
宏璟建設公司（宏璟）	1,012,399	26.4	1,140,426	26.4
日月宏科技公司（日月宏）	981,341	57.4	950,219	56.6
日月新投資公司（日月新）	–	–	878,547	100.0
日月興投資公司（日月興）	–	–	527,085	100.0
宏錦光公司（宏錦光）	406,131	27.3	404,513	27.3
日月冠公司（日月冠）	–	98.8	50,657	98.8
環信通訊科技公司（環信）	–	25.0	–	25.0
集耀通訊科技公司（集耀）	7,678	32.1	–	–
美商集程通訊科技公司（美商集程）－可轉換特別股	40,481	23.1	66,087	23.1
	35,476,992		36,059,980	
減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益	300,149		300,149	
轉列庫藏股票	10,037		2,639,826	
加：轉列其他流動負債	–		1,224,157	
	$ 35,166,806		$ 34,344,162	
預付長期投資款				
日月光華通公司	$ 12,000		$ –	
長期股權投資貸項				
日月冠	$ 55,583	98.8	$ –	–

（1）本公司經主管機關核准之主要對外投資包括：

1. J&R Holding Limited（J&R）

本公司經主管機關核准，於八十五年五月在百慕達投資設立。

J&R控股公司，投資金額為美金44,577千元，取得100％股權。

截至九十二年十二月三十一日止，J&R轉投資持有新加坡商ASE Test Limited股權39.1％（另ASE Holding亦持有ASE Test Limited股權11.2％）。ASE Test Limited另持有台灣福雷與ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100％之股權，同時ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.亦持有馬來西亞商ASE Electronics (M) Sdn. Bhd. 100％股權，其累積投資金額為美金60,000千元。又ASE Test Limited股票於八十五年六月在美國NASDAQ National Market上市買賣（代號：ASTSF）；J&R嗣又於八十六年十二月提撥ASE Test Limited股票經核准在台灣證券交易所首次參與發行台灣存託憑證並掛牌上市（代號：9101）。

ASE Test Limited於八十八年四月投資設立ASE Test Holding Ltd.，持股100％，主要從事專業性投資業務；又ASE Test Limited於八十八年五月購併美國ISE Labs, Inc.（ISE），取得70％股權，且陸續參與ISE現金增資及向ISE其他股東購買股份，目前已持有其100％股權，總投資金額為美金221,145千元。ISE主要經營各型積體電路之測試業務。另ASE Test Limited於八十八年六月投資設立ASE Test Finance Ltd.，持股100％，主要業務為從事專業性理財活動。為購併ISE及Motorola SPS Businesses，ASE Test Limited於八十八年六月經由其子公司ASE Test Finance Limited（發行人）發行美金1億6千萬元之附轉換條件有擔保可轉換公司債，以面額發行，債券票面利率為1％，發行期限五年至九十三年七月到期。

J&R嗣於八十八年四月在台灣楠梓加工區內投資設立日月瑞公司（日月瑞），投資金額4,653,000千元，取得100％股權。該公司目前主要業務係從事引線架及封裝測試用機器設備之租賃業務。

九十一年五月J&R購入Grand Innovation Co., Ltd. 100％股權，購買價款為41,869千元（美金1,218千元）。該公司係從事專業性投資活動，截至九十二年十二月三十一日止，主要係投資美商集程可轉換特別股6.9％之股權。

2. ASE Holding (Bermuda) Ltd.（ASE Holding）

本公司經主管機關核准於百慕達投資設立ASE Holding作為控股公司，取得100％股權。截至九十二年十二月三十一日止，累積投資金額為美金238,203千元。

本公司經由ASE Holding轉投資設立下列孫公司：

a. 菲商ASEP Realty Corporation（持有100％股權），截至九十二年十二月三十一日止，累積投資額為美金234千元。

b. ASE Holding Electronics（Philippines）, Incorporated（持有100％股權），截至九十二年十二月三十一日止累積投資額為美金57,141千元，所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售，惟已於九十二年十二月經董事會決議清算，目前尚在辦理清算解散中。

c. ASE Investment (Labuan), Inc.
為購併目的，ASE Holding於八十八年七月投資設立馬來西亞商ASE Investment (Labuan), Inc.，截至九十二年十二月三十一日止，累積投資額為美金80,880千元，持有70％股權（另ASE Test Limited持有該公司30％股權）。ASE Investment (Labuan), Inc.同時以美金174,050千元購併位於韓國之美商Motorola Korea Ltd. 100％股權，並將公司名稱改為ASE（Korea）Inc.。ASE（Korea）Inc.主要係經營半導體之封裝測試業務。

上述a.及b.投資，因菲國法律規定之限制，部份股份暫以菲籍人士名義持有之金額為美金142千元，本公司已取得該外籍股東之股份轉讓同意書以保全此等投資。

另ASE Holding於八十五年三月投資InveStar Burgeon Venture Capital, Inc.（設立於開曼群島），取得13%股權。截至九十二年十二月三十一日止，累積投資金額為美金2,450千元。

3. ASE Japan Co.

本公司九十二年十二月於日本橫濱投資設立ASE Japan Co.，取得100%股權，截至九十二年十二月三十一日止已投資18,462千元（日幣60,000千圓），該公司主要係從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務。

4. 美商集程（可轉換特別股）

本公司於八十九年十二月參與美商集程公司之現金增資認股（可轉換特別股），截至九十二年十二月三十一日止，累積投資額為美金4,000千元，取得23.1%股權。本公司並與孫公司Grand Innovation Co., Ltd.及環電公司共同持有美商集程公司46.1%股權。美商集程公司主要生產及買賣無線通訊相關產品及各種通訊系統產品。

（2）本公司主要國內投資包括：

1. 宏錦光

本公司於八十一年以土地作價390,470千元發起設立宏錦光，其以土地作價之投資額與土地成本及土地增值稅之差額300,149千元，視為未實現利益，列為長期股權投資之減項，將遞延至處分長期投資時認列利益。

2. 環電

本公司於八十八年及八十九年間陸續自公開市場購入環電之股份，截至九十二年十二月三十一日止，累積投資額為3,623,526千元，持股21.6%。環電主要業務為各種電腦資訊之週邊設備、厚膜混合積體電路、電子零件配件及個人電腦暨其零件之製造、加工及銷售。

3. 日月欣

本公司與二子公司（J&R及ASE Test Limited）於八十八年四月在台灣中壢共同投資設立日月欣，原始投資總金額為3,800,000千元，日月欣並於同年七月以購買主要資產方式，併購美商Motorola Electronics Taiwan Ltd.之中壢廠半導體事業部，購買價款為美金176,060千元。截至九十二年十二月三十一日止，累積投資額為5,735,000千元。日月欣主要經營半導體之封裝及測試業務。

日月欣於九十年六月經主管機關核准在英屬維京群島投資設立Omniquest Industrial Limited，並以其名義在大陸地區投資設立日月光半導體（上海）有限公司，截至九十二年十二月三十一日止，累積投資金額為美金17,800千元。日月光半導體（上海）有限公司目前仍屬創業期間。

4. 日月榮

本公司於八十九年一月投資1,800,000千元設立日月榮，並取得90%之股權。惟日月榮於九十年八月辦理減資並退回本公司原投資股款450,000千元，是以截至九十二年十二月三十一日止之投資金額為1,350,000千元。日月榮主要從事專業性投資，截至九十二年十二月三十一日止，其主要投資為台灣固網公司股份共1,500,000千元，持有1.63%之股權。

5. 集耀

本公司為拓展通訊產業市場，於九十二年五月參與集耀之現金增資52,000千元，並取得32.1%之股權。集耀主要係從事新創無線通訊晶片設計業務。

(3) 預付長期投資款

本公司董事會於九十二年十月二十七日決議與華通電腦股份有限公司共同投資設立日月光華通，預計之主要業務將以設計、製造與銷售半導體封裝測試用基板，本公司將持有60%之股權。截至九十二年十二月三十一日止已投資12,000千元，列入預付長期投資款項下，該公司目前尚屬籌設階段。

(4) 認列投資損益

九十二及九十一年度採權益法認列之投資(損)益內容如下：

	九十二年度	九十一年度
J&R	$ 400,195	($ 1,282,797)
ASE Holding	(219,366)	(1,068,230)
環電	(46,033)	(153,904)
宏璟	(126,307)	(136,477)
日月冠	(106,240)	(13,622)
日月欣	92,486	195,422
日月宏	10,146	(465,239)
其他	(123,530)	(218,213)
加：已實現長期投資跌價損失－庫藏股票交易(附註十四)	(354,787)	–
	($ 473,436)	($ 3,143,060)

上述長期投資採權益法認列之投資損益，係根據被投資公司同期經會計師查核之財務報表依持股比例計算。

本公司業已編製本公司及所有綜合持股超過50%子公司之九十二及九十一年度合併財務報表。

7. 固定資產

	九十二年底	九十一年底
累積折舊		
建築物及附屬設備	$ 1,393,601	$ 1,054,485
機器設備	15,637,113	11,230,899
運輸設備	31,182	31,654
生財器具	173,938	144,435
租賃資產	193,946	1,493,789
	$ 17,429,780	$ 13,955,262

本公司以融資借款購置固定資產，其利息資本化資訊如下：

	九十二年度	九十一年度
利息總額	$ 747,242	$ 1,092,336
利息資本化金額(列入固定資產項下)	96,795	114,707
利息資本化利率	2.1%～4.1%	5%

8. 其他資產－其他

主係出租廠房之帳面價值。依簽訂廠房租賃合約，租期將於九十三年八月到期，每年租金收入約為5,172千元，並收取保證金1,500千元。

9. 短期借款

此項包括購料信用狀借款及週轉性借款，年利率0.86%～2.895%。

截至九十二年十二月三十一日止，未使用短期借款及短期票券額度約為3,800,000千元。

10. 應付短期票券

九十二年十二月三十一日餘額係應付商業本票50,000千元減除未攤銷折價13千元後之淨額，年利率1.63%。保證機構為澳紐銀行。

11. 應付公司債－九十二年十二月三十一日

海外可轉換公司債	
記名式附轉換條件無擔保公司債	$ 6,794,000
加：利息補償金	67,232
	$ 6,861,232

本公司於九十二年九月發行歐式附轉換條件之無擔保可轉換公司債200,000單位，每單位面額1,000美元，總計2億美元，以面額發行，債券票面利率為0%，發行期限五年，至九十七年九月到期。該可轉換公司債之應付利息補償金係按年利率3.75%以利息法計算，並列入應付公司債項下。

依發行辦法規定，債券持有人得於發行後第三十一日起至到期日前十日止，隨時向本公司請求依約定之轉換程序及轉換價格轉換為本公司之普通股或本公司發行之海外存託憑證。

債券持有人得於公司債到期時，憑債券請求本公司按面額100%一次贖回，但下列情形不在此限：

（一）本公司債於發行滿四年時遇有本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格，連續二十個營業日均達轉換價格（目前為37.716元）之130%，本公司得以約定提前贖回價格，將流通在外之債券全部或一部份贖回。

（二）於超過百分之九十之可轉換公司債已贖回、買回或行使轉換權時，本公司得以提前贖回價格將債券全部贖回。

（三）因中華民國稅務法令變更，致本公司必須支付額外之利息費用時，本公司得依提前贖回價格將債券全部贖回。

本公司原於八十六年十一月所發行歐式附轉換條件之無擔保可轉換公司債2億美元，除其中100萬美元係由債券持有人依轉換規定轉換成普通股355,086股外，其餘199,000千美元本公司已在九十及九十一年間自公開市場陸續買回是項公司債後予以註銷。本公司九十一年度自公開市場買回是項公司債合計68單位（美金68,000千元），支付價款3,242,110千元，並產生損失46,151千元，於扣除所得稅利益11,538千元後之淨額34,613千元列入非常損失。

12. 長期負債

	九十二年底	九十一年底
(1)購置機器設備之長期借款	$ 2,222,378	$ 2,505,870
(2)應付I票券	874,798	5,219,347
(3)應付租賃款	372,636	754,720
(4)週轉性借款	11,563,760	4,895,030
(5)進口融資及信用狀借款	1,662,152	1,653,877
(6)指定用途專案借款	–	6,000,000
	16,695,724	21,028,844
減:一年內到期部分	2,841,034	3,907,325
	$ 13,854,690	$ 17,121,519

(1) 購置機器設備之長期借款

	九十二年底	九十一年底
自九十年十二月起按季分十七期平均償還至九十四年十二月,		
每期償還約23,530千元,年利率九十二年3.775%,九十一年5.865%	$ 188,230	$ 282,350
自九十二年六月起按季分十二期償還至九十五年三月,		
每期償還約41,700千元,年利率九十二年4.5%,九十一年5.75%	$ 374,900	$ 500,000
自九十二年三月起按九期平均償還至九十四年三月,		
每期償還約55,556千元,年利率九十二年4.375%,九十一年5.845%	277,778	500,000
自九十二年七月起按季分八期平均償還至九十四年四月,		
每期償還約62,500千元,年利率九十二年4.68%,九十一年5.565%	375,000	500,000
自九十二年十二月起按季分十七期平均償還至九十六年十二月,		
每期償還約23,530千元,年利率九十二年3.775%,九十一年4.5%	376,470	200,000
將於九十四年九月到期一次償還,年利率3.7%	350,000	–
自九十三年六月起按季分八期平均償還至九十五年三月,		
每期償還約35,000千元,年利率3.20%	280,000	–
已於九十二年底前償還,年利率5.865%	–	23,520
已於九十二年底提前償還,年利率4.2%	–	500,000
	$ 2,222,378	$ 2,505,870

(2) 應付票券

	九十二年底	九十一年底
1. 循環發行商業本票額度,原將於九十三年一月到期,惟本公司已於九十三年一月發行普通公司債並取得資金27.5億元用於支應該項借款到期之還款。年利率九十二年1.03%～1.10%,九十一年2.18%	$ 875,000	$ 500,000
2. 此係銀行團提供票券發行額度所發行之銀行承兌匯票或商業本票,已提前於九十二年一月償還,九十一年年利率2.14%～2.16%	$ –	$ 2,900,000
3. 循環發行商業本票額度,已於九十二年底前償還,年利率1.85%～2.14%	–	1,825,000
	875,000	5,225,000
減：應付票券折價	202	5,653
	$ 874,798	$ 5,219,347

(3) 應付租賃款

	九十二年底	九十一年底
1. 機器設備(向日月瑞承租)－租期三至四年,按月支付租金,隱含利率6.5%	$ 370,200	$ 740,177
2. 電腦及其他設備－租期三年至五年,按月支付租金,隱含利率10%～11%	2,436	14,543
	$ 372,636	$ 754,720

截至九十二年十二月三十一日之未來各年度應付租金列示如下:

	應付租金		
年度	日月瑞	其他公司	合計
九十三	$ 373,840	$ 669	$ 374,509
九十四	3,796	669	4,465
九十五	–	669	669
九十六	–	669	669
九十七	–	448	448
	377,636	3,124	380,760
減:隱含利息	7,436	688	8,124
應付租賃款	$ 370,200	$ 2,436	$ 372,636

上述向日月瑞承租機器設備所支付之租金係參考其借款利率訂定之。

(4) 週轉性借款

	九十二年底	九十一年底
新台幣70億元之聯貸(花旗銀行為主辦銀行),		
自九十三年十二月起每半年為一期,分三期償還至九十四年十二月,		
惟已於九十二年十月提前償還33.5億元,年利率2.529%	$ 3,650,000	$ –
新台幣70億元之聯貸,已動用44億元(花旗銀行為主辦銀行),		
自九十四年九月起每半年為一期,分七期償還至九十七年九月,		
年利率2.149%～2.154%	4,400,000	–
將於九十四年九月到期一次清償,年利率3.23%	200,000	–
將於九十五年三月到期一次清償,年利率2.02%	1,460,710	–
將於九十七年六月到期一次清償,年利率1.77%	500,000	–
自九十五年十一月起每半年為一期,分三期償還至九十六年十一月,年利率2.5088%	300,000	–
將於九十三年一月到期一次清償,惟本公司已於九十三年一月發行普通公司債		
並取得資金27.5億元用於支應該項借款到期之還款。年利率1.45%	113,050	–
將於九十三年一月到期一次清償,惟本公司已於九十三年一月發行普通公司債		
並取得資金27.5億元用於支應該項借款到期之還款。年利率1.46%	100,000	–
將於九十三年四月到期一次清償,年利率九十二年3.25%,九十一年4.62%	290,000	290,000
將於九十五年二月到期一次清償,年利率九十二年2.925%,九十一年4.075%	350,000	350,000
將於九十五年一月到期一次清償,年利率九十二年3.7%,九十一年4.875%	$ 200,000	$ 200,000
此係銀行團聯貸,原將於九十三年六月前到期,		
已於九十二年一月提前償還,年利率九十一年5.903%	–	2,300,000
已於九十二年二月提前清償,年利率4.25%	–	500,000
已於九十二年一月提前清償,年利率2.95%	–	101,000
已於九十二年一月提前清償,年利率3.001%	–	354,030

	九十二年底	九十一年底
已於九十二年一月提前清償，年利率2.06%	–	150,000
已於九十二年一月提前清償，年利率2.25%	–	150,000
已於九十二年一月提前清償，年利率2.2%	–	100,000
已於九十二年一月提前清償，年利率2.2%	–	200,000
已於九十二年一月提前清償，年利率2.15%～2.225%	–	200,000
	$ 11,563,760	$ 4,895,030

前述第（2）之2項由銀行團提供予本公司之票券發行額度計29億元之銀行承兌匯票或商業本票（原將自九十二年六月起，以每半年為一期，分三期償還至九十三年六月）及上述週轉性借款額度23億元銀行團聯貸之合約（原將於九十三年六月到期），本公司已於九十二年一月以取得新長期借款（額度70億元）之資金，提前清償上述借款。

該銀行團所提供之聯合融資合約額度70億元，原將於九十三年十二月起以每半年為一期，分三期償還至九十四年十二月，惟本公司已於九十二年十月提前清償33.5億元，餘36.5億元將依上述償還期程於第一期償還本金12.52億元，第二及三期各還本金11.99億元。該等合約除其他有關規定外，包括下列限制條款：

1. 本公司未經多數授信銀行事前以書面同意，不得出售、轉讓、出借、出租、質押、信託或以其他方式處分其財產或營業，惟屬關係企業間為正常營運所產生之資產正常移轉不在此限。

2. 本公司倘（1）擬與他人合併或分割；（2）轉投資其他公司累積金額超過25億元（自本合約簽訂日起計算）；（3）取得其他公司主要部份之資產時，均應事先取得多數授信銀行書面同意。

3. 本公司有形淨值不得低於380億元。

4. 維持若干財務比率。

（5）進口融資及信用狀借款

此借款合約九十二年十二月三十一日餘額原將於九十三年三月至七月間到期，惟本公司已於九十三年一月發行普通公司債並取得資金27.5億元用以支應各該借款到期之還款。九十一年十二月三十一日餘額則分別於九十二年一月至六月到期償還。年利率九十二及九十一年分別為0.83%～1.61%及0.86%～4.3%。

（6）指定用途專案借款

此係銀行團之聯貸供作本公司買回海外可轉換公司債之用，原自九十二年六月起以每半年為一期分四期償還至九十三年十二月，惟本公司已於九十二年十月提前清償。年利率5.785%。

截至九十二年十二月三十一日止，未使用長期借款額度約為2,762,000千元。

13. 退休金

本公司訂有員工退休辦法適用於正式聘用員工，係屬確定給付退休辦法。依該辦法退休金之支付係按員工服務年資及其退休前六個月之平均月薪計算。

本公司遵照政府法令規定按月依薪資總額之2%提撥員工退休準備金交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以其名義存入中央信託局專戶儲存。退休準備金之變動如下：

	九十二年度	九十一年度
年初餘額	$ 291,547	$ 252,433
本年度提存	36,689	33,197
本年度支付	(8,457)	(145)
利息收入	4,332	6,062
年底餘額	$ 324,111	$ 291,547

茲依精算結果，將退休金相關資訊揭露如下：

	九十二年度	九十一年度
（一）退休金成本		
服務成本	$ 98,115	$ 91,379
利息成本	26,766	22,941
退休基金資產預期報酬	(10,787)	(13,422)
攤銷數	5,643	1,518
	$ 119,737	$ 102,416

（二）退休基金提撥狀況與應計退休金負債之調節

	九十二年底	九十一年底
給付義務		
既得給付義務	$ 29,375	$ 20,753
非既得給付義務	590,400	458,708
累積給付義務	619,775	479,461
未來薪資增加之影響數	351,775	285,278
預計給付義務	971,550	764,739
退休基金資產公平價值	(324,111)	(291,547)
提撥狀況	647,439	473,192
未認列過渡性淨給付義務	(73,360)	(79,003)
前期服務成本未攤銷餘額	(15,247)	–
退休金損失未攤銷餘額	(152,331)	(70,737)
減：列入應付費用	(8,042)	(3,625)
應計退休金負債	$ 398,459	$ 319,827
（三）既得給付	$ 35,743	$ 23,199
（四）退休金給付義務及計算淨退休金成本之精算假設		
折現率	3.25%	3.5%
未來薪資水準增加率	3%	3%
退休準備金資產預期投資報酬率	3.25%	3.5%

14. 股東權益

（1）發行海外存託憑證

本公司於八十四年七月在亞洲、美國及歐洲等地發行全球存託憑證（GDS）8,600千單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行股數43,000千股。該GDS之持有人已配合後述ADS之發行而轉換持有ADS。

本公司於八十九年九月以現金增資方式參與發行美國存託憑證（ADS）計20,000千單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行普通股100,000千股，每單位溢價美金5.4元（折合新台幣每股溢價約34元）發行，計產生資本公積3,137,910千元。本項現金增資案已於八十九年九月二十八日完成募集，並以八十九年九月二十九日為增資基準日完成股本變更登記。

本公司復於九十二年十一月經董事會決議以現金增資方式參與發行美國存託憑證（ADS）不超過60,000千單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行普通股不超過300,000千股。本項現金增資案已經相關主管機關核准，本公司將伺機發行此項ADS。依政府法令規定，本存託憑證持有人得於發行後第五個營業日起要求兌回本公司普通股，其股票即在國內證券交易市場流通。

上述海外存託憑證持有人享有與本公司普通股股東相同之權利義務，但其權利義務之行使，應依本國相關法令及存託契約約定事項辦理，其主要事項係海外存託憑證持有人應經由存託機構：

1. 行使其股份之表決權。
2. 出售該存託憑證表彰之原有價證券。
3. 受配股利及認購新股。

截至九十二年十二月三十一日止，因部分海外存託憑證持有人已兌回普通股股數計約340,440千股，佔本公司發行股數（含庫藏股）約9.51％；而流通在外之存託憑證計17,893千單位，折合普通股股數計約89,463千股，佔本公司發行股數（含庫藏股）約2.50％。

（2）資本公債

依相關法令之規定，股票溢價發行所產生之資本公積，得用以撥充股本，撥充股本時，每年以一定比例為限。

長期投資按權益法評價而認列之資本公積，不得作為任何用途。

（3）盈餘分派

依本公司章程規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

1. 彌補虧損。
2. 提存百分之十為法定盈餘公積。
3. 依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積。
4. 長期投資依權益法計算之投資收益內屬於現金股利以外未實現部分，得就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配。

如尚有盈餘分派如下：

5. 董事、監察人酬勞金係依1至4款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之二（含）以下。
6. 員工紅利係依1至4款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之五（含）以上，百分之七（含）以下，其中百分之五部份係按員工紅利發放辦法分配予全體員工，另其有超過百分之五部份則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。
7. 其餘由董事會擬定盈餘分派案，按股份總數比例分派之。

上述法定盈餘公積，依公司法規定，得用於彌補虧損；當該項公積已達股本總額之50％時，得以其半數撥充股本。

本公司九十一年度盈餘分派經九十二年六月十九日股東常會決議如下：

法定公積	$	12,903
董監事酬勞		2,280
員工現金紅利		8,000
普通股股票股利－每股0.03元		97,644
	$	120,827

本公司九十二年度盈餘分配議案，截至會計師查核報告書出具日止，尚未經董事會擬議，有關董事會擬議及股東會決議盈餘分派情形，請至臺灣證券交易所之「公開資訊觀測站」查詢。

(4) 股利政策

本公司正處於企業成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係以分派股票股利為優先，亦得以現金股利分派之，其中現金股利發放之比例以不超過百分之二十為原則，惟現金股利每股若低於0.1元則不予發放，改以股票股利方式發放之。前項所列現金股利發放之比例，本公司得依當年度實際營運狀況，並考量次一年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式，由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

(5) 發放員工紅利及董監事酬勞之影響

倘前述(3)所配發之員工紅利及董監事酬勞於九十一年度以費用列帳，按追溯調整九十二年度盈餘及資本公積轉增資後股數計算，將使九十一年度稅後之基本及稀釋每股盈餘由0.04元減少為0.03元。

(6) 兩稅合一

依所得稅法規定，本公司分配屬於八十七年度（含）以後之盈餘時，本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東可扣抵稅額（營利事業所得稅）。

截至九十二年十二月三十一日止本公司股東可扣抵稅額餘額為89,586千元。九十二年度預計及九十一年度實際盈餘分配之稅額扣抵比率分別為4.40%及20.35%。

(7) 庫藏股票

本公司自九十一年度起，將子公司持有本公司股票164,442千股（列入長期投資）之帳面價值依持股比例計算之庫藏股票計2,639,826千元。

嗣子公司於九十二年六月間將原持有本公司股票計163,789千股出售，出售價款為2,850,524千元，超過本公司庫藏股帳面價值2,629,789千元之金額計220,735千元，列入資本公積（子公司列為投資利益）。截至九十二年十二月三十一日止，此項庫藏股票之股數718千股，其帳面價值（依持股比例計算）10,037千元，相關市價為21,278千元。上項庫藏股之出售使本公司九十二年十二月三十一日之長期投資增加1,184,897千元、流動負債減少1,224,157千元、資本公積增加220,735千元及庫藏股票之帳面價值減少2,629,789千元；九十二年度投資損失增加354,787千元（列入採權益法認列之投資損失項下）。

子公司持有本公司股票雖視同庫藏股票處理，但享有本公司之股東權利，惟不得參與本公司之現金增資。

15. 員工認股權憑證

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，業經主管機關於九十一年八月核准發行第一次員工認股權憑證計160,000,000單位，每單位得認購本公司普通股一股，並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。該認股權之存續期間為十年，不得轉讓，持有認股權憑證之員工自被授予後屆滿二年才可行使認股。上述員工認股權憑證已分別於九十一年十二月二十四日及九十二年八月二十二日發行並授予本公司及子公司員工，每股認股價格分別為18.9元（調整後）及24.6元（係按發行日本公司普通股收盤價格發行），而該次員工認股權辦法總計註銷32,000單位（其中含1,000單位未發行而到期註銷部分）。該認股權憑證之認股價格如因本公司之普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資及資本公積轉增資等），將依比例重新計算並調整認股價格。

本公司發行之認股權憑證辦法係酬勞性質，依據內含價值法之會計處理，因其認股價格與認股權衡量日之股票市價相同，是以不必認列認股權之酬勞成本。

16. 所得稅

（一）所得稅利益計算如下：

	九十二年度	九十一年度
稅前利益（損失）按法定稅率（25%）估列之所得稅費用（利益）	$ 523,408	($ 159,204)
調整項目之稅額影響數		
採權益法認列之投資損失	118,359	785,765
免稅所得額	(300,000)	(41,387)
未實現兌換損失（利益）	27,847	(34,160)
已實現減資損失	(150,000)	(157,416)
發行海外可轉換公司債之利息補償金	16,776	(163,289)
未提撥基金之退休金成本	20,762	17,305
其　他	(8,080)	13,924
按課稅所得估列之稅額	249,072	261,538
未分配盈餘課徵10%稅額	100,000	–
投資抵減稅額	(325,649)	(250,000)
遞延所得稅	(672,587)	(812,000)
	($ 649,164)	($ 800,462)

（二）淨遞延所得稅資產（負債）列示如下：

	九十二年底	九十一年底
流　動		
未使用投資抵減	$ 400,000	$ 676,000
備抵存貨損失	23,090	23,037
未實現兌換損失	38,709	23,674
備抵呆帳	24,786	14,173
其　他	(4,953)	7,116
	481,632	744,000
減：備抵評價	–	22,000
	$ 481,632	$ 722,000
非流動		
未使用投資抵減	$ 1,839,329	$ 878,000
應計退休金負債	99,615	80,225

	九十二年底	九十一年底
海外可轉換公司債利息補償金	16,776	–
權益法認列國外被投資公司之投資利益	($ 144,000)	($ 206,500)
其　他	3,235	3,275
	1,814,955	755,000
減：備抵評價	430,000	283,000
	$ 1,384,955	$ 472,000

本公司八十八及八十九年度增資擴展產銷之積體電路之投資計畫，經核准分別自九十及九十二年度起就其新增所得免徵營利事業所得稅五年分別至九十四及九十六年底止。

截至九十二年十二月三十一日止，本公司依據促進產業升級條例辦理之所得稅抵減相關資訊如下：

		尚未抵減餘額及最後抵減年度				
抵減項目	可抵減總額	九十三年	九十四年	九十五年	九十六年	合計
機器設備	$ 1,910,719	$ 296,870	$ 483,061	$ 396,788	$ 634,500	$ 1,811,219
研究發展	569,832	–	139,066	126,866	160,000	425,932
人才培訓	2,178	–	2,178	–	–	2,178
	$ 2,482,729	$ 296,870	$ 624,305	$ 523,654	$ 794,500	$ 2,239,329

資產負債表上之應付所得稅係扣除預付所得稅後之淨額。

本公司截至八十九年度止之所得稅結算申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

17. 用人費用、折舊及攤銷之歸屬

	九十二年度			九十一年度		
	營業成本	營業費用	合計	營業成本	營業費用	合計
用人費用						
薪　資	$ 3,017,693	$ 584,213	$ 3,601,906	$ 2,269,252	$ 436,097	$ 2,705,349
退休金	96,638	23,099	119,737	82,996	19,420	102,416
伙食費	228,783	35,584	264,367	196,162	29,758	225,920
福利金	25,300	7,061	32,361	13,738	3,561	17,299
員工保險費	244,796	45,902	290,698	172,588	33,472	206,060
其　他	46,680	13,667	60,347	40,189	10,197	50,386
	$ 3,659,890	$ 709,526	$ 4,369,416	$ 2,774,925	$ 532,505	$ 3,307,430
折　舊	$ 3,807,821	$ 168,474	$ 3,976,295	$ 3,324,523	$ 160,510	$ 3,485,033
攤　銷	170,889	128,212	299,101	131,689	101,332	233,021

18. 每股盈餘（純損）

九十二年度本公司所發行之員工認股權憑證及可轉換公司債均屬潛在普通股，惟可轉換公司債列入計算稀釋每股盈餘時產生反稀釋作用，子公司ASE Test Limited發行員工認股權憑證不具稀釋作用，是以不列入計算稀釋每股盈餘。九十一年度本公司及子公司ASE Test Limited發行員工認股權憑證均不具稀釋作用，是以基本及稀釋每股盈餘（純損）相同。計算每股盈餘（純損）之分子及分母揭露如下：

(1) 分子－純益(損)

	九十二年度		九十一年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
列計非常損失前利益(損失)	$ 2,093,632	$ 2,742,796	($ 636,814)	$ 163,648
非常損失	–	–	(46,151)	(34,613)
基本及稀釋每股盈餘				
屬於普通股股東之純益(損)	$ 2,093,632	$ 2,742,796	($ 682,965)	$ 129,035

(2) 分母－股數(千股)

	九十二年度	九十一年度
普通股已發行加權平均股數	3,580,280	3,254,800
加：盈餘及資本公積轉增資股數追溯調整	–	325,480
減：庫藏股(子公司持有本公司股票)加權平均股數	75,580	180,534
計算基本每股盈餘(純損)之股數	3,504,700	3,399,746
加：員工認股權憑證潛在普通股股數	32,349	–
計算稀釋每股盈餘(純損)之股數	3,537,049	3,399,746

九十二年度盈餘及資本公積轉增資對九十一年度基本及稀釋每股盈餘(純損)之影響追溯調整如下：

	追溯調整前		追溯調整後	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本及稀釋每股盈餘(純損)	($ 0.22)	$ 0.04	($ 0.20)	$ 0.04
假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票之				
擬制基本及稀釋每股盈餘(純損)		0.04		0.04

19. 關係人交易

(1) 關係人之名稱及其關係－參閱附註六及附表三。

(2) 與關係人間之重大交易事項

1. 除附註十二及二十一所述外，本公司與關係人間之重大交易如下：

當年度

	九十二年度		九十一年度	
	金額	佔各該科目%	金額	佔各該科目%
購置材料款				
日月宏	$ 4,416,271	27	$ 2,885,588	24
測試費				
台灣福雷	$ 5,057	25	$ 232,532	94
購置固定資產				
ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	$ 196,171	4	$ 3,847	–
日月欣	20,446	–	1,855	–
	$ 216,617	4	$ 5,702	–

測試費係按台灣福雷之一般交易價格訂定之，另向日月宏購置之材料價款，則與一般廠商相當。付款期限對日月宏為月結30至60天付款，對台灣福電為月結90天付款，與一般廠商相當。本公司與關係人購置固定資產交易（不動產除外），係依帳面價值為交易價款，付款期限為驗收後30天付款。

年底餘額

	九十二年底		九十一年底	
	金額	佔各該科目%	金額	佔各該科目%
應收關係人款項				
台灣福雷	$ 178,606	2	$ 31,119	1
日月欣	33,001	1	14,916	–
ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	23,571	–	33,318	1
其　他	352	–	12,178	–
	$ 235,530	3	$ 91,531	2

	九十二年底		九十一年底	
	金額	佔各該科目%	金額	佔各該科目%
應付帳款－關係人				
日月宏	$ 1,060,113	23	$ 584,088	19
ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	185,557	4	1,046	–
台灣福雷	177,061	4	138,719	4
其　他	23,838	1	14,937	1
	$ 1,446,569	32	$ 738,790	24

2. 截至九十二及九十一年十二月三十一日止，本公司開立票據為各被投資公司背書及保證之餘額折合新台幣金額明細如下：

	九十二年底	九十一年底
ASE Test Finance Ltd.	$ 5,095,500	$ –
日月宏	2,440,860	1,638,790
ASE Investment (Labuan) Inc.	2,038,200	2,777,289
宏　璟	960,000	–
ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	764,325	399,855
Omniquest Industrial Limited	339,700	–
日月欣	475,580	758,450
日月新	–	597,000
日月興	–	160,000
日月冠	–	10,000
	$ 12,114,165	$ 6,341,384

20. 質抵押之資產

本公司提供下列資產作為長期借款、進口原物料之關稅擔保及雇用外籍勞工等之保證金：

	帳面金額	
	九十二年底	九十一年底
存出保證金－定期存單	$ 87,385	$ 99,029
機器設備	2,507,895	3,231,602
	$ 2,595,280	$ 3,330,631

21. 截至九十二年十二月三十一日止重大承諾事項及或有事項

(1) 本公司廠房用地係向政府租用，其租期將陸續於九十九年九月底屆滿。租期屆滿時本公司得予續約，但政府得於該土地公告現值增加時調整租金，並得於在若干條件下終止租約。目前年租金及公共設施建設費共約11,743千元。

(2) 本公司委託二家代理商代理銷售業務，其中一家原按外銷收入淨額0.8%計付銷貨佣金，惟自九十二年八月起改按外銷收入淨額0.7%計付。另一家之服務費則按該代理商發生之所有費用加成2.7375%計算（訂有費用上限），九十二及九十一年度佣金及服務費支出分別約為566,063千元及409,750千元，列入營業費用－推銷費用。

(3) 本公司為購買原料及機器設備而開立未使用之信用狀金額約為416,000千元。

(4) 本公司已承諾訂購之機器設備金額約為1,472,000千元，其中已支付2,700千元。

(5) 本公司已承諾廠房建造及訂購工程設備金額約為565,000千元，其中已支付400,848千元。

(6) 本公司銷售部分產品依約應按銷售數量之一定比例支付權利金，並依約支付執照特許費予外國公司，該等合約分別將陸續於九十九年前到期，九十二及九十一年度權利金支出約200,132千元及176,711千元。另截至九十二年十二月三十一日止已累積支付執照特許費美金6,150千元，列入其他資產-遞延費用項下。

(7) 本公司董事會於九十二年十月二十八日決議吸收合併日月欣及日月宏二子公司，預計發行新股282,315千股（佔本公司流通在外普通股約7.9%）予該二子公司之其他股東（換股比率分別為日月欣公司1股換發本公司0.85股及日月宏公司1股換發本公司0.50股），合併基準日預計為九十三年七月一日，而該二子公司原有之權利及義務，將全部由本公司概括承受。本項合併案尚待向主管機關申請核准。

(8) 本公司於九十二年四月與宏璟簽訂合建契約書，由本公司提供契約書約定之土地並由宏璟出資興建宏萊廠廠辦大樓。依合約於該大樓興建完成後，本公司得分配樓面面積（含公有面積）21,810平方公尺，宏璟公司得分配86,214平方公尺。

22. 重大之期後事項

本公司及子公司J&R於九十三年二月三日與NEC Electronics Corporation及NEC Yamagata, Ltd.共同簽署股權買賣合約書，將由NEC Yamagata, Ltd.以成立子公司方式將其所有位於日本山形縣之半導體封裝測試廠之營業及資產移轉予該新成立之公司後，再由本公司之子公司J&R以購買股權方式購入該公司100%股權。同時本公司與NEC Electronics Corporation共同簽署一封裝測試服務合約，預計於J&R取得該新公司之股權後，NEC Electronics Corporation將委由該新公司提供封裝及測試服務。

23. 金融商品交易

本公司從事外幣選擇權合約、遠期外匯買賣合約、換匯換利合約及利率交換合約之目的，主要為規避以外幣計價之淨資產或淨負債及預期交易匯率及利率變動之風險，因是均屬非以交易為目的之交易活動。

茲將有關資訊揭露如下：

(1) 歐式外幣選擇權合約

本公司因自外銷取得美金收入及部分應付款及銀行借款到期時須以日幣及新台幣支應，因而與金融機構簽訂外幣選擇權合約，以規避外幣匯率波動所可能造成之影響，截至九十二年十二月三十一日止尚未結清之外幣選擇權合約如下：

合約內容	合約金額	約定匯率	到期日
Sell USD Call / JPY Put	US$ 3,000,000	US$1:JPY$111.6	93年01月14日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 3,000,000	US$1:JPY$111.6	93年01月15日
Buy NTD Call / USD Put	US$ 157,000,000	US$1:NTD$33.95	93年04月16日
Sell NTD Call / USD Put	US$ 157,000,000	US$1:NTD$33.46	93年10月18日
Sell USD Call / JPY Put	US$ 10,000,000	註一	93年01月13日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註二	93年01月13日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註三	93年01月13日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註四	93年01月13日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註五	93年01月13日
Sell USD Call / JPY Put	US$ 10,000,000	註一	93年02月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註二	93年02月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註三	93年02月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註四	93年02月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註五	93年02月12日
Sell USD Call / JPY Put	US$ 10,000,000	註一	93年03月10日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註二	93年03月10日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註三	93年03月10日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註四	93年03月10日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註五	93年03月10日
Sell USD Call / JPY Put	US$ 10,000,000	註一	93年04月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註二	93年04月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註三	93年04月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註四	93年04月12日
Buy USD Put / JPY Call	US$ 5,000,000	註五	93年04月12日

註一：若USD/JPY>111.6，則約定匯率為111.6。
註二：若109<USD/JPY≦111.6，則約定匯率為111.6。
註三：若108<USD/JPY≦109，則約定匯率為112.6。
註四：若107<USD/JPY≦108，則約定匯率為113.6。
註五：若105<USD/JPY≦107，則約定匯率以到期日之即期匯率+200bp計算。

合約到期日USD/JPY≦105，則雙方沒有任何權利義務發生。

上述外幣選擇權合約按九十二年十二月三十一日市價評估計產生24,501千元之兌換損失。

截至九十一年十二月三十一日止，尚未結清之外幣選擇權合約於期後實際結清產生39,230千元之兌換利益。

本公司九十二及九十一年度承作歐式外幣選擇權合約分別產生兌換利益60,606千元及兌換損失13,065千元。

(2) 遠期外匯買賣合約

本公司因自外銷取得美金收入及部分長期負債及應付款項到期時須以新台幣或歐元支應，為規避外幣匯率波動可能造成之影響，而與銀行承作遠期外匯合約。截至九十二年十二月三十一日止尚無未結清之遠期外匯合約。本公司九十二及九十一年度承作遠期外匯買賣合約並未產生重大兌換損益。

(3) 換匯換利合約

本公司為規避應付公司債利率及匯率之波動風險，於九十二年十月與銀行簽訂二項換匯換利合約。該二合約將分別於九十六年四月及九十七年九月到期。依據上述合約，本公司每半年將分別按名目本金美金200,000千元及約定固定美金利率計算應付利息。另該銀行亦應按相同名目美金與另一約定之固定美金利率計算應付本公司利息。每期利息結算係按淨額收支。九十二年度本公司因該等合約產生之利息收入為11,056千元，列入公司債利息費用減項。

本公司並以九十二年十二月三十一日之即期匯率調整應收、應付換匯換利合約款之餘額，產生兌換損失68,110千元。

(4) 利率交換合約

本公司為規避部分長期負債利率波動之風險，於九十一年六月與銀行簽訂二項美金補貼換利合約。該合約原將於九十三年十二月到期，惟本公司已提前於九十一年九月底前結清，並產生利息收入107,910千元（美金3,120千元）。

(5) 交易風險

1. 信用風險

本公司交易對象皆為信用良好之金融機構，預期不致產生重大信用風險。

2. 市場價格風險

本公司從事衍生性金融商品交易即在規避外幣淨資產或淨負債因匯率及利率波動所產生之風險，因匯率及利率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷，故市場價格風險並不重大。

3. 流動性風險及現金流量風險

本公司從事衍生性金融商品交易之目的即在規避淨資產或淨負債之匯率及利率變動風險，因到期時有相對之現金流入或流出，本公司之營運資金足以支應，故無籌資風險。

(6) 金融商品之公平價值

	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
非衍生性金融商品				
資產				
現金	$ 4,839,182	$ 4,839,182	$ 3,841,802	$ 3,841,802
短期投資	154,229	154,229	67,893	67,893
應收票據	102,717	102,717	94,634	94,634
應收帳款(含關係人)	7,408,439	7,408,439	5,419,003	5,419,003
其他應收款	31,650	31,650	64,008	64,008
長期投資及長期股權投資貸項	35,173,223	33,655,461	34,344,162	33,391,390
存出保證金	287,157	287,157	105,980	105,980
負債				
短期借款	682,166	682,166	–	–
應付短期票券	49,987	49,987	–	–
應付帳款(含關係人)	4,575,532	4,575,532	3,068,989	3,068,989
應付票據	1,170	1,170	1,322	1,322
應付費用	678,584	678,584	744,373	744,373
應付設備款	1,362,793	1,362,793	2,721,735	2,721,735
長期附息負債(含一年內到期部分)	23,556,956	24,207,340	21,028,844	21,028,844
衍生性金融商品				
歐式外幣選擇權合約	(24,501)	(24,501)	39,141	39,141
遠期外匯買賣合約	–	–	(5,781)	(5,681)
換匯換利合約	(68,110)	(68,110)	–	–

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下:

1. 短期金融商品(短期投資除外)以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值,因為此類商品到期日甚近,其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。

2. 短期投資及長期投資係以市價或股權淨值估算公平價值。

3. 長期附息負債以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以本公司所能獲得類似條件之長期附息負債利率為準。本公司之長期附息負債利率除公司債外,均屬浮動利率,其帳面價值即為公平市價;應付公司債則以其市價估算公平價值。

4. 衍生性金融商品以市價估算其公平價值。

24. 附註揭露事項

九十二年度應揭露事項如下：

(1) 重大交易事項及轉投資事業相關資訊

1. 資金貸與他人：詳附表一。
2. 為他人背書保證者：詳附表二。
3. 年底持有有價證券情形：詳附表三。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表四。
5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表五。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：詳附表六。
9. 具重大影響力或控制能力之被投資公司相關資訊：詳附表七。
10. 從事衍生性金融商品交易：詳附註二十三及附表八。

(2) 大陸投資資訊：詳附表九。

25. 部門別財務資訊

(1) 外銷資訊

	九十二年度		九十一年度	
地區	外銷收入金額	佔銷貨%	外銷收入金額	佔銷貨%
美　洲	$ 15,697,036	50	$ 9,994,582	39
歐　洲	2,985,177	9	2,019,434	8
亞洲及其他	1,246,371	4	4,041,252	16
	$ 19,928,584	63	$ 16,055,268	63

(2) 重要客戶－銷貨收入佔營業收入10%以上之客戶

	九十二年度		九十一年度	
客戶	金額	佔銷貨%	金額	佔銷貨%
甲公司	$ 3,638,735	11	$ 3,220,023	13
乙公司	4,702,705	15	2,234,723	8
	$ 8,341,440	26	$ 5,454,746	21

(3) 產業別資訊

本公司係屬各型積體電路之製造、組合、加工及測試之單一產業。

(4) 地區別資訊

本公司之營運部門皆屬國內營運部門。

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
資金貸與他人

民國九十二年度

附表一

單位：新台幣千元

編號	資金貸與他人者公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象資金貸與限額	本年度最高餘額	年底餘額	利率區間（%）	資金貸與原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		業務往來金額	資金貸與最高限額
										名稱	價值		
0	J & R Holding Ltd.	ASE Test Finance Ltd.	應收關係人款項	美金101,230千元（註1）	$ 2,050,200	$ 2,038,200	2.27	償還借款	$ –	–	$ –	$ –	美金253,076千元（註2）

註1：對個別對象資金貸與限額為不超過該公司淨值之百分之二十。

註2：資金貸與總限額為該公司淨值之百分之五十。

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
為他人背書保證

民國九十二年度

附表二

單位：新台幣千元（除另予註明者外）

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額（註1）	本年度最高背書保證餘額	年底背書保證餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率%	背書保證最高限額（註2）
		公司名稱	關係						
0	本公司	ASE Test Finance Ltd.	透過子公司間接持有普通股股權超過50%之曾孫公司	$ 13,536,781	$ 5,205,000（美金150,000千元）	$ 5,095,500（美金150,000千元）（註3）	$ –	11.3	$ 45,122,602
		日月宏公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	13,536,781	2,449,600（美金38,000千元，台幣1,150,000千元）	2,440,860（美金38,000千元，台幣1,150,000千元）	–	5.4	45,122,602
		ASE Investment（Labuan）Inc.	透過子公司間接持有普通股股權超過50%之孫公司	13,536,781	2,784,477（美金79,876千元）	2,038,200（美金60,000千元）（註4）	–	4.5	45,122,602
		宏璟公司	有業務往來之聯屬公司	13,536,781	960,000	960,000	–	2.1	45,122,602
		ASE Holding Electronics（Philippines）Incorporated	透過子公司間接持有普通股股權超過50%之孫公司	13,536,781	784,350（美金22,500千元）	764,325（美金22,500千元）	–	1.7	45,122,602
		Omniquest Industrial Limited	透過子公司間接持有普通股股權超過50%之孫公司	13,536,781	348,600（美金10,000千元）	339,700（美金10,000千元）	–	0.8	45,122,602
		日月欣公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	13,536,781	760,413（美金21,813千元）	475,580（美金14,000千元）（註5）	–	1.1	45,122,602
		日月冠公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	3,536,781	10,000	–	–	–	45,122,602
		日月新公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	13,536,781	700,000	–	–	–	45,122,602
		日月興公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	13,536,781	200,000	–	–	–	45,122,602
1	ASE Test Ltd.	台灣福雷電子公司	透過子公司間接持有普通股股權超過50%之孫公司	12,983,019	1,500,000	–	–	–	18,547,170（美金545,987千元）
2	Omniquest Industrial Limited	日月光半導體（上海）公司	直接持有普通股股權超過50%之子公司	383,072	173,800（美金5,000千元）	169,850（美金5,000千元）	–	31	547,245（美金16,110千元）

註1：依日月光及各該公司「背書保證作業程序」，對單一企業或轉投資公司之背書保證額度分別以不超過股東權益總額之百分之三十及百分之七十為限。

註2：依各該公司「背書保證作業程序」，背書保證責任總額訂為各該公司之股東權益總額為限。

註3：係本公司為子公司ASE Test Finance Ltd.申請美金150,000千元聯貸案與子公司ASE Test Ltd.共同出具保證，並由台灣福雷電子公司對其母公司ASE Test Ltd.之保證義務出具保證。

註4：係本公司為協助ASE Investment（ Labuan ）Inc.購買摩托羅拉韓國廠股權所出具之履約保證函。

註5：其中271,760千元係本公司為協助日月欣購買摩托羅拉中壢廠房設備及智慧財產權等資產所出具之履約保證函。

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
年底持有有價證券情形明細表

民國九十二年十二月三十一日
附表三

單位：新台幣千元
（除另予註明者外）

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	年底				備註
				股數	帳面金額	持股比例（%）	市價（股權淨額）	
本公司	股票							
	ASE Holding (Bermuda) Ltd.	被投資公司	長期投資	184,290	$ 6,205,747	100.0	$ 6,205,903	
	J & R Holding Ltd.	被投資公司	長期投資	12	17,193,422	100.0	17,193,968	
	ASE Marketing Services Ltd.	被投資公司	長期投資	500,000	958	100.0	958	
	ASE Japan Co.	被投資公司	長期投資	1,200	18,462	100.0	18,462	
	宏錦光公司	被投資公司	長期投資	39,047,000	406,131	27.3	406,131	
	宏璟公司	被投資公司	長期投資	119,408,060	1,012,399	26.4	534,948	
	日月宏公司	被投資公司	長期投資	143,547,583	981,341	57.4	1,060,985	
	日月欣公司	被投資公司	長期投資	365,483,259	5,097,879	57.6	5,097,879	
	環電公司	被投資公司	長期投資	144,936,050	3,123,672	21.6	2,003,015	
	日月榮公司	被投資公司	長期投資	134,999,995	1,388,822	90.0	1,388,822	
	環信公司	被投資公司	長期投資	3,750,000	–	25.0	–	
	集耀公司	被投資公司	長期投資	5,200,000	7,678	32.1	7,678	
	特別股（可轉換特別股）							
	美商集程公司	被投資公司	長期投資	4,000,000	40,481	23.1	40,481	
					35,476,992		33,959,230	
	減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益				300,149		300,149	
	轉列庫藏股票				10,037		10,037	
					35,166,806		33,649,044	
	預付投資款							
	日月光華通公司	被投資公司	長期投資	–	12,000	60.0	12,000	
	企業貸款債權證券化受益憑證	-	長期投資	–	50,000	–	50,000	
	日月冠公司	被投資公司	長期投資貸項	19,753,830	（ 55,583）	98.8	（ 55,583）	
					$ 35,173,223		$ 33,655,461	
	基金							
	保誠掌櫃基金	–	短期投資	500,595	$10,000	–	$4,816	
	遠東大聯台灣旗艦基金	–	短期投資	3,000,000	30,000	–	33,750	
	遠東大聯台灣債券基金	–	短期投資	1,498,142	15,000	–	15,621	
	富邦如意基金	–	短期投資	6,562,670	100,000	–	100,042	
					155,000		$ 1 54,229	
	減：備抵跌價損失				771			
					$ 154,229			
日月宏公司	基金							
	台灣吉利債券基金	–	短期投資	1,918,760	$ 30,000	–	$ 30,589	
	保誠威鋒二號	–	短期投資	4,095,983	60,000	–	61,163	
日月瑞公司	基金							
	統一全壘打基金	–	短期投資	2,254,373	30,003	–	30,350	
	金鼎債券基金	–	短期投資	11,243,862	152,703	–	152,703	
	金鼎鼎益基金	–	短期投資	8,223,522	$ 96,947	–	$ 96,947	
	復華有利基金	–	短期投資	4,964,356	58,221	–	58,567	
	群益安信基金	–	短期投資	1,804,175	20,204	–	20,206	
	群益安穩基金	–	短期投資	7,329,051	102,789	–	103,719	
	聯邦債券基金	–	短期投資	20,891,458	243,803	–	243,814	
	盛華1699債券基金	–	短期投資	23,625,702	280,966	–	280,997	
	大衆債券基金	–	短期投資	5,133,230	64,000	–	64,102	
	日盛債券基金	–	短期投資	83,546,314	1,093,579	–	1,093,638	
	日盛全球基金	–	短期投資	500,000	5,000	–	4,996	
	建弘台灣債券基金	–	短期投資	7,116,942	95,698	–	96,105	
	凱基凱旋債券基金	–	短期投資	1,938,999	20,000	–	20,039	
	富邦如意債券基金	–	短期投資	13,125,340	200,000	–	200,085	
	交銀高科技債券基金	–	短期投資	169,818	3,000	–	1,669	
	全球保本型創投票券	–	短期投資	–	15,341	–	15,341	
日月榮投資公司	股票							
	台灣固網公司	–	長期投資	150,000,000	1,500,000	1.6	1,536,000	
	基金							
	荷銀精選債券基金	–	短期投資	3,837,216	40,231	–	41,770	

持有之公司	有價證券種類及名稱		與有價證券發行人之關係	帳列科目	年底				備註
					股數	帳面金額	持股比例(%)	市價(股權淨額)	
日月冠公司	基金								
		大眾債券基金	–	短期投資	3,311,705	40,957	–	41,355	
台灣福雷電子公司	股票								
		日月光半導體製造公司	本公司之母公司	長期股權投資	717,984	21,278	0.0	21,278	
		日月宏科技公司	被投資公司	長期股權投資	10,000,000	73,936	4.0	73,936	
ASE Holding (Bermuda) Ltd.	股票								
		ASEP Realty Corporation	被投資公司	長期股權投資	20,000	美金139千元	100.0	美金139千元	
		ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	被投資公司	長期股權投資	2,423,733	美金6,312千元	100.0	美金6,312千元	
		ASE Test Ltd.	被投資公司	長期股權投資	11,148,000	美金95,271千元	11.2	美金166,886千元	
		InveStar Burgeon Venture Capital, Inc.	–	長期股權投資	3,492,424	美金2,450千元	13.0	美金2,450千元	
		Global Strategic Investment, Inc.	–	長期股權投資	2,000,000	美金2,000千元	2.5	美金2,000千元	
		ASE Investment (Labuan) Inc.	被投資公司	長期股權投資	80,879,714	美金65,695千元	70.0	美金65,695千元	
		環電公司	被投資公司	長期股權投資	13,076,181	美金6,440千元	2.0	美金5,319千元	
J & R Holding Ltd.	股票								
		Zoran Corp.	–	短期投資	9,803	美金177千元	–	美金174千元	
	債券								
		Crimson @Velocity Fund, L.P.	–	長期投資	–	美金625千元	–	美金625千元	
	股票								
		ASE Test Ltd.	被投資公司	長期股權投資	38,902,740	美金244,372千元	39.1	美金582,374千元	
		日月瑞公司	被投資公司	長期股權投資	465,300,000	美金150,393千元	100.0	美金150,393千元	
		日月欣公司	被投資公司	長期股權投資	94,016,736	美金38,586千元	14.8	美金38,586千元	
		Grand Innovation Co., Ltd.	被投資公司	長期股權投資	1,200,001	美金347千元	100.0	美金347千元	
		DIGITAL Communication International Inc.	被投資公司	長期股權投資	1,476,792	美金1,477千元	15.0	美金1,477千元	
Grand Innovation Co., Ltd.	股票								
		美商集程公司	被投資公司	長期股權投資	1,200,001	美金357千元	6.9	美金357千元	
ASE Investment (Labuan) Inc.	股票								
		ASE (Korea) Inc.	被投資公司	長期股權投資	7,613,363	美金158,862千元	100.0	美金153,839千元	
ASE Test Ltd.	股票								
		台灣福雷電子公司	被投資公司	長期股權投資	300,955,033	美金318,268千元	100.0	美金318,268千元	
		日月欣公司	被投資公司	長期股權投資	175,500,000	美金72,063千元	27.6	美金72,063千元	
		ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	被投資公司	長期股權投資	71,428,902	美金156,160千元	100.0	美金156,160千元	
		ASE Test Holding, Ltd.	被投資公司	長期股權投資	5	美金110,147千元	100.0	美金110,147千元	
		ASE Test Finance, Ltd.	被投資公司	長期股權投資貸項	2	(美金61,042千元)	100.0	(美金61,042千元)	
		ASE Investment (Labuan) Inc.	被投資公司	長期股權投資	34,690,785	美金28,155千元	30.0	美金28,155千元	
	基金								
		CFS US Dollar Short Term Income Fund	–	短期投資	149,600	美金1,500千元	–	美金1,503千元	
		NITC-NAM Multi Series	–	短期投資	155,839	美金2,000千元	–	美金2,016千元	
		ABN AMRO Capital Protector	–	短期投資	2,500,000	美金2,500千元	–	美金2,496千元	
		UC Fund II	–	長期債券投資	1,000,000	美金1,000千元	–	美金909千元	
ASE Test Holding, Ltd.	股票								
		ISE Labs, Inc.	被投資公司	長期股權投資	26,250,000	美金110,139千元	100.0	美金46,391千元	
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd	股票								
		ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	被投資公司	長期股權投資	159,715,000	美金156,160千元	100.0	美金156,160千元	
日月欣公司	股票								
		Omniquest Industrial Ltd. (BVI)	被投資公司	長期股權投資	17,800,000	547,245	100.0	547,245	
Omniquest Industrial Ltd. (BVI)	股權憑證								
		日月光半導體(上海)有限公司	被投資公司	長期股權投資	–	美金15,972千元	100.0	美金15,972千元	

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國九十二年度
附表四

單位：新台幣千元
（除另予註明者外）

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初	
					股數	金額
本公司	股票					
	日月欣公司	長期投資	–	本公司之子公司	315,483,259	$ 4,431,373
	ASE Holding (Bermuda) Ltd.	長期投資	–	本公司之子公司	184,290	6,054,848
日月瑞公司	基金					
	金鼎債券基金	短期投資	–		33,269,200	442,788
	金鼎鼎益基金	短期投資	–		8,223,522	94,700
	盛華1699債券基金	短期投資	–		9,358,770	108,280
	永昌鳳翔基金	短期投資	–		5,158,443	73,000
	群益安信基金	短期投資	–		7,495,554	82,173,758
	群益安穩基金	短期投資	–		5,055,174	70,000
	寶來富利基金	短期投資	–		5,500,000	55,000
	建弘台灣債券基金	短期投資	–		12,628,048	167,073
	聯邦債券基金	短期投資	–		9,715,072	111,177
	日盛債券基金	短期投資	–		13,618,052	174,707
	富邦如意基金	短期投資	–		–	–
日月宏公司	基金					
	台灣吉利債券基金	短期投資	–		14,276,300	220,000
	保誠威鋒二號債券基金	短期投資	–		–	–
日月欣公司	基金					
	建弘全家福基金	短期投資	–		–	–
	保誠威寶債券基金	短期投資	–		–	–
	新光吉星基金	短期投資	–		–	–
	保誠威鋒二號債券基金	短期投資	–		–	–
	德信萬年基金	短期投資	–		–	–
日月新公司	股票					
	日月光半導體製造公司	長期股權投資	–	本公司之母公司	142,368,827	1,983,409
日月冠公司	基金					
	大衆債券基金	短期投資	–		–	–
日月興公司	股票					
	日月光半導體製造公司	長期股權投資	–	本公司之母公司	21,420,317	462,893
J&R Holding Ltd.	公司債					
	ASE Test Finance 1% Guaranted Convertible Notes	長期債券投資	–	本公司之子公司	50,000,000	美金50,000千元
ASE Holding (Bermuda) Ltd.	股票					
	ASE Investment (Labuan) Inc.	長期股權投資	–	本公司之子公司	66,966,514	美金45,376
ASE Test Ltd.	股票					
	ASE Investment (Labuan) Inc.	長期股權投資	–	本公司之被投資公司	28,727,985	美金19,467千元
Omniquest Industrial Ltd.	股權憑證					
	日月光半導體（上海）有限公司	長期股權投資	–	本公司之子公司	–	美金14,800千元（註2）

註1：長期股權投資年底金額係包括按權益法認列之投資損益、未實現長期股權投資跌價損失、未認列為退休金成本之淨損失及累積換算調整數。
註2：九十一年度累積自台灣匯出美金17,800千元，其中美金14,800千元係於同年匯至大陸地區，其餘美金3,000千元則保留於第三地區並於九十二年度自第三地區匯至大陸地區。
註3：係辦理減資彌補虧損

買入		賣出				年底	
股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分（損）益	股數	金額（註1）
50,000,000	$ 500,000	–	$ –	$ –	$ –	365,483,259	$ 5,097,879
20,000	478,753	20,000（註3）	–	–	–	184,290	6,205,747
84,673,418	1,140,124	106,698,755	1,346,446	1,430,209	6,237	11,243,862	152,703
24,670,567	288,097	24,670,567	288,097	285,850	2,247	8,223,522	96,947
74,286,469	878,694	60,019,537	710,694	706,007	4,686	23,625,702	280,966
5,158,443	73,809	10,316,887	147,931	146,809	1,122	–	–
4,975,055	55,204	10,666,434	117,722	117,174	549	1,804,175	20,204
7,329,051	102,789	5,055,174	70,789	70,000	789	7,329,051	102,789
5,499,075	55,592	10,999,075	111,229	110,592	637	–	–
45,173,309	604,454	50,684,414	679,454	675,830	3,625	7,116,942	95,698
52,213,238	641,718	44,036,851	511,718	509,092	2,626	20,891,458	243,803
293,579,888	3,819,060	223,651,625	2,915,560	2,900,188	15,372	83,546,314	1,093,579
13,125,340	200,000	–	–	–	–	13,125,340	200,000
3,253,242	51,000	15,610,782	245,366	241,000	4,366	1,918,760	30,000
8,186,719	120,000	4,090,737	60,073	60,000	73	4,095,983	60,000
2,642,421	410,000	2,642,421	413,372	410,000	3,372	–	–
38,782,083	462,000	38,782,083	466,255	462,000	4,255	–	–
7,338,426	100,000	7,338,426	100,034	100,000	34	–	–
26,401,395	390,000	26,401,395	392,448	390,000	2,448	–	–
18,795,894	260,000	18,795,894	260,286	260,000	286	–	–
–	–	142,368,827	2,475,856	1,983,409	492,447	–	–
3,881,140	48,000	569,436	7,050	7,050	7	3,311,705	40,957
–	–	21,420,317	374,668	1,001,166	（626,498）	–	–
–	–	50,000,000	美金65,291千元	美金50,000千元	美金15,291千元	–	–
13,913,200	美金13,913千元	–	–	–	–	80,879,714	美金65,695千元
5,962,800	美金5,963千元	–	–	–	–	34,690,785	美金28,155千元
–	美金3,000千元	–	–	–	–	–	美金15,972千元

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
重大與關係人進、銷貨明細表

民國九十二年度
附表五

單位：新台幣千元
（除另予註明者外）

進（銷）貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進（銷）貨	金額	佔總進（銷）貨之比率%	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率（%）	
本公司	日月宏公司	本公司持股57.4%之子公司	進貨	$ 4,416,271	(27)	月結30～60天	–	–	($ 1,060,113)	23	
日月宏公司	日月光半導體製造公司	本公司之母公司	銷貨	(4,416,271)	(85)	月結30~60天	–	–	1,060,113	79	

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
重大應收關係人款項明細表

民國九十二年十二月三十一日
附表六

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額	週轉率（次）	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	台灣福雷電子公司	本公司之孫公司	$ 178,606（註1）	–	$ –	–	$ –	$ -
日月宏公司	日月光半導體製造公司	本公司之母公司	1,060,113	5.37	–	–	–	–
日月宏公司	日月欣公司	聯屬公司	132,310	5.46	–	–	–	–
日月瑞公司	日月冠公司	聯屬公司	110,711（註2）	–	–	–	–	–
台灣福雷電子公司	日月光半導體製造公司	本公司之母公司	177,061（註1）	–	–	–	–	–
台灣福雷電子公司	ISE Labs, Inc.	聯屬公司	137,653（註2）	–	–	–	–	–
ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	日月光半導體製造公司	本公司之母公司	185,557（註2）	–	–	–	–	–
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	台灣福雷電子公司	聯屬公司	150,779（註2）	–	–	–	–	–
日月欣公司	台灣福雷電子公司	聯屬公司	122,541（註1）	–	–	–	–	–

註1：主係代收代付款。
註2：係應收出售資產款。

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊

民國九十二年度
附表七

單位：新台幣千元
（除另予註明者外）

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目
本公司	ASE Holding (Bermuda) Ltd.	百慕達	從事專業性投資活動
	J & R Holding Ltd.	百慕達	從事專業性投資活動
	ASE Marketing Services Ltd.	香港	海外基地轉接訂單及客戶之服務
	ASE Japan Co.	日本	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務
	日月冠公司	楠梓加工區	資訊產品及其週邊設備之研究製造及銷售
	宏錦光公司	台北市	自有剩餘攤位及辦公大樓出租
	宏璟公司	台北市	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租業務、買賣各種建材及其進出口業務、房屋租售之介紹業務、室內設計裝潢工程
	日月宏公司	楠梓加工區	積體電路用引線架之製造組合加工及測試
	日月新公司	台北市	對各種生產事業、貿易公司及文化事業之投資
	日月興公司	台北市	對各種生產事業、貿易公司及文化事業之投資
	日月欣公司	中壢市	半導體之封裝測試業務
	環電公司	南投縣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工及銷售
	日月榮公司	台北市	從事專業性投資活動
	環信公司	台北市	從事產品設計業、資訊軟體服務業、租賃業及電訊、資訊、電子批發零售業
	集耀公司	新竹市	從事資料儲存處理設備、無線有線通信機械器材、電子零組件、電器、一般儀器製造
	美商集程公司	美國	無線通訊領域發展相關產品
日月欣公司	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動
Omniquest Industrial Limited	日月光半導體（上海）有限公司	中國大陸上海	（一）發光二極體及二極體顯示器製造 （二）印刷電路板產銷
ASE Holding (Bermuda) Ltd.	ASEP Realty Corporation	菲律賓	房地產投資、買賣及出租
	ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	菲律賓	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
	ASE Test Ltd.	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
	環電公司	南投縣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣
J & R Holding Ltd.	ASE Test Ltd.	新加坡	從事專業性投資活動
	日月瑞公司	楠梓加工區	各型積體電路之封裝及引線架之製造、加工及產製引線架、封裝測試用機器設備之租賃
	日月欣公司	中壢市	半導體之封裝測試業務
	Grand Innovation Co., Ltd.	英屬維京群島	從事專業性投資活動
Grand Innovation Co., Ltd.	美商集程公司	美　國	無線通訊領域發展相關產品
ASE Test Limited	台灣福雷電子公司	楠梓加工區	半導體產品測試服務
	日月欣公司	中壢市	半導體之封裝測試業務
	ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	從事專業性投資活動
	ASE Test Holding, Ltd.	開　曼	從事專業性投資活動
	ASE Test Finance Ltd.	模里西斯	從事專業性理財活動
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動
ASE Test Holding, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美　國	半導體產品測試服務
ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE (Korea) Inc.	韓　國	半導體封裝測試業務
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
台灣福雷電子公司	日月宏公司	楠梓加工區	積體電路用引線架之製造組合加工及測試

註1：係包括子公司出售本公司股票而認列之長期投資已實現投資損失354,787千元。
註2：該二子公司已於九十二年七月一日與本公司合併後消滅。

原始投資金額		年底持有			被投資公司本年度(損)益	本年度認列之投資(損)益	備註
本年年底	去年年底	股數	比率	帳面金額			
美金238,203千元	美金224,290千元	184,290	100.0	$ 6,205,747	($ 219,366)	($ 219,366)	子公司
美金44,577千元	美金44,577千元	12	100.0	17,193,422	400,195	400,195	子公司
美金500千元	美金500千元	500,000	100.0	958	(775)	(775)	子公司
日幣60,000千圓	–	1,200	100.0	18,462	–	–	子公司
$849,006	$849,006	19,753,830	98.8	(55,583)	(107,563)	(106,240)	子公司
390,470	390,470	39,047,000	27.3	406,131	5,922	1,617	被投資公司
2,845,913	2,845,913	119,408,060	26.4	1,012,399	(481,636)	(126,307)	被投資公司
1,435,476	1,414,500	143,547,583	57.4	981,341	168,337	10,146	子公司
–	1,000,000	–	–	–	438,285	(54,161)	子公司(註2)
–	1,000,000	–	–	–	(650,902)	(379,191)	子公司(註2)
3,654,833	3,154,833	365,483,259	57.6	5,097,879	182,837	92,486	子公司
3,623,526	3,623,526	144,936,050	21.6	3,123,672	776,285	(46,033)	被投資公司
1,350,000	1,350,000	134,999,995	90.0	1,388,822	27,053	24,335	子公司
93,750	93,750	3,750,000	25.0	–	–	–	
52,000	–	5,200,000	32.1	7,678	(105,849)	(25,820)	被投資公司
美金4,000千元	美金4,000千元	4,000,000	23.1	40,481	(138,081)	(44,322)	被投資公司
				$ 35,421,409		($ 473,436)	(註1)
美金17,800千元	美金17,800千元	17,800,000	100.0	547,245	(59,537)	(59,537)	子公司
美金17,800千元	美金14,800千元	-	100.0	美金15,972千元	(美金1,790千元)	(美金1,790千元)	子公司
美金234千元	美金234千元	20,000	100.0	美金139千元	美金2千元	美金2千元	子公司
美金57,141千元	美金57,141千元	2,423,733	100.0	美金6,312千元	(美金6,608千元)	(美金6,608千元)	子公司
美金84,889千元	美金84,889千元	11,148,000	11.2	美金95,271千元	(美金3,515千元)	(美金6,776千元)	子公司
美金80,880千元	美金66,967千元	80,879,714	70.0	美金65,695千元	美金9,151千元	美金6,406千元	子公司
美金7,044千元	美金7,044千元	13,076,181	2.0	美金6,440千元	美金22,595千元	美金231千元	被投資公司
美金100,743千元	美金100,743千元	38,902,740	39.1	美金244,372千元	(美金3,515千元)	(美金7,630千元)	子公司
美金140,532千元	美金140,532千元	465,300,000	100.0	美金150,393千元	美金3,291千元	美金3,291千元	子公司
美金29,205千元	美金29,205千元	94,016,736	14.8	美金38,586千元	美金5,513千元	美金712千元	被投資公司
美金1,218千元	美金1,218千元	1,200,001	100.0	美金347千元	(美金225千元)	(美金225千元)	子公司
美金1,200千元	美金1,200千元	1,200,001	6.9	美金357千元	(美金3,078千元)	(美金225千元)	被投資公司
美金184,092千元	美金184,092千元	300,955,033	100.0	美金318,268千元	美金34,842千元	美金34,842千元	子公司
美金52,916千元	美金52,916千元	175,500,000	27.6	美金72,063千元	美金5,513千元	美金1,330千元	被投資公司
美金66,315千元	美金66,315千元	71,428,902	100.0	美金156,160千元	(美金1,841千元)	(美金1,841千元)	子公司
美金224,681千元	美金224,681千元	5	100.0	美金110,147千元	(美金25,703千元)	(美金25,703千元)	子公司
美金2元	美金2元	2	100.0	(美金61,042千元)	(美金13,956千元)	(美金13,956千元)	子公司
美金34,691千元	美金28,729千元	34,690,785	30.0	美金28,155千元	美金9,151千元	美金2,725千元	被投資公司
美金221,145千元	美金221,145千元	26,250,000	100.0	美金110,139千元	(美金15,591千元)	(美金25,703千元)	子公司
美金100,000千元	美金100,000千元	7,613,363	100.0	美金158,862千元	美金9,275千元	美金8,116千元	子公司
美金60,000千元	美金60,000千元	159,715,000	100.0	美金156,160千元	(美金1,841千元)	(美金1,841千元)	子公司
100,000	100,000	10,000,000	4.0	73,936	168,337	6,733	被投資公司

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
衍生性金融商品資訊

民國九十二年度
附表八

一. 台灣福雷九十二年度為國外客戶提供測試服務所取得之美金外匯而短期借款及應付設備款到期時須以台幣或日圓支應，因而與金融機構簽訂外幣選擇權合約，以規避新台幣對美元及日圓匯率波動所可能造成之不利影響。截至九十二年十二月三十一日止尚未結清之外幣選擇權合約如下：

合約內容	合約金額（美金百萬元）	約定匯率	到期日
Sell USD Call / NTD Put	$ 5.00	US$1:NTD$34.08	93年1月13日
Sell USD Call / JPY Put	3.00	US$1:JPY$115	93年1月14日
Sell USD Call / JPY Put	2.00	註1	93年1月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註2	93年1月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註3	93年1月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註4	93年1月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註5	93年1月19日
Buy USD Put / NTD Call	1.00	US$1:NTD$34.35	93年1月29日
Sell USD Call / NTD Put	5.00	US$1:NTD$34.08	93年2月13日
Sell USD Call / JPY Put	2.00	註1	93年2月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註2	93年2月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註3	93年2月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註4	93年2月19日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註5	93年2月19日
Buy USD Put / NTD Call	1.00	US$1:NTD$34.38	93年2月26日
Sell USD Call / JPY Put	2.00	註1	93年3月18日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註2	93年3月18日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註3	93年3月18日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註4	93年3月18日
Buy USD Put / JPY Call	1.00	註5	93年3月18日
Sell USD Call / NTD Put	2.00	US$1:NTD$34.6	93年4月29日
Sell USD Call / NTD Put	2.00	US$1:NTD$34.6	93年5月28日

註1：若USD/JPY＞112，則約定匯率為112。
註2：若109＜USD/JPY≦112，則約定匯率為112。
註3：若108＜USD/JPY≦109，則約定匯率為113。
註4：若107＜USD/JPY≦108，則約定匯率為114。
註5：若105＜USD/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓計算。

上述外幣選擇權於九十二年十二月三十一日止按市價評估計產生兌換利益計2,255千元。

台灣福雷九十二年度承作外幣選擇權交易產生兌換損失1,038千元。

二. 日月宏公司因自銷貨取得美金收入，而部分短期借款到期時須以日幣支付，因而與金融機構簽訂外幣選擇權合約，以規避外幣匯率波動所可能造成之不利影響。截至九十二年十二月三十一日止，尚未結清之歐式外幣選擇權之合約如下：

合約內容	合約金額（美金百萬元）	約定匯率	到期日
Buy USD Put / JPY Call	$ 1.5	註1	93.01.30
Buy USD Put / JPY Call	1.5	註1	93.02.27
Buy USD Put / JPY Call	1.5	註1	93.03.31
Buy USD Put / JPY Call	1.5	註1	93.04.30
Sell USD Call / JPY Put	3.0	註1	93.01.30
Sell USD Call / JPY Put	3.0	註1	93.02.27
Sell USD Call / JPY Put	3.0	註1	93.03.31
Sell USD Call / JPY Put	3.0	註1	93.04.30
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註2	93.01.21
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註2	93.02.23
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註2	93.03.22
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註2	93.04.21
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註2	93.01.21
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註2	93.02.23
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註2	93.03.22
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註2	93.04.21
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註3	93.01.19
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註3	93.02.19
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註3	93.03.18
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註3	93.04.19
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註3	93.01.19
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註3	93.02.19
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註3	93.03.18
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註3	93.04.19
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註4	93.01.20
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註4	93.02.25
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註4	93.03.25
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註4	93.04.23
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註4	93.01.20
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註4	93.02.25
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註4	93.03.25
Sell USD Call/JPY Put	2.0	註4	93.04.23
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註5	93.02.04
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註5	93.03.04
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註5	93.04.02
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註5	93.04.28
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註5	93.02.04
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註5	93.03.04
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註5	93.04.02
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註5	93.04.28
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註6	93.02.04
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註6	93.03.04
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註6	93.04.02
Buy USD Put / JPY Call	1.0	註6	93.04.28
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註6	93.02.04
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註6	93.03.04
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註6	93.04.02

合約內容	合約金額（美金百萬元）	約定匯率	到期日
Sell USD Call / JPY Put	2.0	註6	93.04.28
Buy USD Put / JPY Call	2.0	註7	93.02.24
Buy USD Put / JPY Call	2.0	註7	93.03.24
Buy USD Put / JPY Call	2.0	註7	93.04.22
Buy USD Put / JPY Call	2.0	註7	93.05.24
Sell USD Call / JPY Put	4.0	註7	93.02.24
Sell USD Call / JPY Put	4.0	註7	93.03.24
Sell USD Call / JPY Put	4.0	註7	93.04.22
Sell USD Call / JPY Put	4.0	註7	93.05.24

註1：若US/JPY＞110.7，則約定匯率為110.7；
若109＜US/JPY≦110.7，則約定匯率為110.7；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為111.7；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為112.7；
若105＜US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓；
若合約到期日US/JPY≦105，則雙方沒有任何權利義務發生。

註2：若US/JPY＞112，則約定匯率為112；
若109＜US/JPY≦112，則約定匯率為112；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為113；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為114；
若105＜US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓；
若合約到期日US/JPY≦105，則雙方沒有任何權利義務發生。

註3：若US/JPY＞112.5，則約定匯率為112.5；
若109＜US/JPY≦112.5，則約定匯率為112.5；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為113.5；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為114.5；
若US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓。

註4：若US/JPY＞112.5，則約定匯率為112.5；
若109＜US/JPY≦112.5，則約定匯率為112.5；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為113.5；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為114.5；
若US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓。

註5：若US/JPY＞113.2，則約定匯率為112；
若112＜US/JPY≦113.2，則約定匯率為113.2；
若109＜US/JPY≦112，則約定匯率為113.2；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為114.2；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為115.2；
若105＜US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓；
若US/JPY≦105，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加一百萬日圓。

註6：若US/JPY＞112.3，則約定匯率為112；
若112＜US/JPY≦112.3，則約定匯率為112.3；
若109＜US/JPY≦112，則約定匯率為112.3；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為113.3；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為114.3；
若105＜US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓；
若US/JPY≦105，則約定以到期日之期匯率乘以合約金額再加一百萬日圓。

註7：若US/JPY＞112，則約定匯率為112；
若111＜US/JPY≦112，無交易；
若109＜US/JPY≦111，則約定匯率為111；
若108＜US/JPY≦109，則約定匯率為112；
若107＜US/JPY≦108，則約定匯率為113；
若105＜US/JPY≦107，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加二百萬日圓；
若US/JPY≦105，則約定以到期日之即期匯率乘以合約金額再加一百萬日圓。
日月宏公司截至九十二年十二月三十一日止尚未結清之外幣選擇權合約按市價評估計產生兌換利益約15,084千元。
日月宏公司九十二年度承作外幣選擇權交易產生兌換利益18,114千元。

日月光半導體製造股份有限公司及其轉投資公司
大陸投資資訊

民國九十二年度
附表九

單位：新台幣千元
（除另予註明者外）

投資公司名稱	日月欣公司	
大陸被投資公司名稱	日月光半導體（上海）有限公司	
主要營業項目	（一）發光二極體及二極體顯示器製造 （二）印刷電路板產銷	
實收資本額	美金17,800千元	
投資方式	註一	
本年年初自台灣匯出累積投資金額	美金14,800千元（註二）	
本年度匯出或收回投資金額	匯出	美金3,000千元（註二）
	收回	–
本年年底自台灣匯出累積投資金額	美金17,800千元	
本公司直接或間接投資之持股比例	100%	
本年度認列投資（損）益	（美金1,790千元）	
年底投資帳面價值	美金15,972千元	
截至本年底止已匯回投資收益	無	
本年年底累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	美金17,800千元	
經濟部投審會核准投資金額	美金32,800千元	
本公司赴大陸地區投資限額（註三）	$ 3,156,990	

註1：係透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

註2：九十一年度累積自台灣匯出美金17,800千元，其中美金14,800千元係於同年匯至大陸地區，其餘美金3,000千元則保留於第三地區並於九十二年度自第三地區匯至大陸地區。

註3：赴大陸地區投資限額計算如下：

$5,000,000×40%+（8,856,636-5,000,000）×30%=$3,156,990

五. 最近年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日合併之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日合併之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達日月光半導體製造股份有限公司及其子公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十二及九十一年度合併之經營成果及現金流量。

勤業眾信會計師事務所

會計師 曾光敏



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 陳政弘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中華民國九十三年二月六日

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

單位：新台幣千元
（惟每股面額為元）

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

代碼	資產	九十二年底 金額	%	九十一年底 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二）	$ 8,562,425	7	$ 9,829,508	9
1110	短期投資（附註二、三及二十一）	3,017,779	3	2,590,436	3
1120	應收票據	111,596	–	112,667	–
1140	應收帳款（附註四）	12,798,135	11	8,885,879	9
1160	其他應收款	206,475	–	130,310	–
120X	存貨（附註二及五）	4,691,771	4	3,131,652	3
1286	遞延所得稅資產（附註二及十九）	1,224,501	1	1,084,441	1
1291	質押定期存款（附註二十一）	167,426	–	428,743	–
1260	預付款項及其他	677,794	1	838,123	1
11XX	流動資產合計	31,457,902	27	27,031,759	26
	長期股資（附註二、六及八）				
142101	採權益法之長期投資	4,521,113	4	4,752,847	4
142102	採成本法之長期投資	1,756,542	2	1,813,887	2
1425	預付長期投資款	12,000	–	–	–
1428	其他長期投資	50,000	–	–	–
1440	其他金融資產－非流動	3,140	–	–	–
14XX	長期投資合計	6,342,795	6	6,566,734	6
	固定資產（附註二、七、二十一及二十二）				
1501	土地	3,855,379	3	3,933,173	4
1521	建築物及附屬設備	18,391,271	16	16,656,394	16
1531	機器設備	81,840,769	72	72,203,572	69
1551	運輸設備	107,400	–	104,225	–
1561	生財器具	1,781,292	1	1,579,785	1
1611	租賃資產及租賃改良	1,026,848	1	855,487	1
15X1	成本合計	107,002,959	93	95,332,636	91
15X9	減：累積折舊	48,281,935	42	39,709,319	38
		58,721,024	51	55,623,317	53
1671	在建工程	2,425,310	2	1,683,387	2
1672	在途機器及預付設備款	6,193,613	6	5,782,166	5
15XX	固定資產合計	67,339,947	59	63,088,870	60
	其他資產				
1820	存出保證金（附註二十一）	359,908	–	170,064	–
1830	遞延費用（附註二及二十二）	1,519,268	1	1,055,339	1
1860	遞延所得稅資產（附註二及十九）	2,230,229	2	1,180,773	1
1888	其他	477,960	1	269,669	–
18XX	其他資產合計	4,587,365	4	2,675,845	2
1881	合併借項（附註二及八）	4,596,234	4	5,541,808	6
1XXX	資產總計	$ 114,324,243	100	$ 104,905,016	100

代碼	負債及股東權益	九十二年底 金額	%	九十一年底 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註九及二十一）	$ 5,048,230	4	$ 3,903,994	4
2110	應付短期票券（附註九及十）	1,075,965	1	2,384,577	2
2140	應付票據及帳款	6,488,989	6	4,047,171	4
2160	應付所得稅（附註十九）	217,846	–	172,453	–
2170	應付費用（附註十五）	1,839,276	1	1,839,423	2
2224	應付設備款	4,392,340	4	4,494,828	4
2272	長期借款一年內到期部分（附註十二及二十一）	5,491,389	5	6,008,709	6
2273	應付長期投資款一年內到期部分（附註十三）	2,309,960	2	962,758	1
2288	應付租賃款一年內到期部分（附註二及十四）	164,612	–	193,714	–
2298	其他	633,438	1	382,349	–
21XX	流動負債合計	27,662,045	24	24,389,976	23
	長期附息負債				
2410	應付公司債（附註二及十一）	6,861,232	6	5,179,793	5
2420	長期借款（附註十二及二十一）	23,873,312	21	22,735,903	22
2443	應付長期投資款（附註十三）	-	–	2,364,360	2
2446	應付租賃款（附註二及十四）	105,517	–	273,660	–
24XX	長期附息負債合計	30,840,061	27	30,553,716	29
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及十五）	587,286	1	416,671	–
2860	遞延所得稅負債（附註二及十九）	34,674	–	35,658	–
2883	少數股權	10,077,575	9	10,078,329	10
28XX	其他負債合計	10,699,535	10	10,530,658	10
2XXX	負債合計	69,201,641	61	65,474,350	62
	股東權益（附註二及十六）				
3110	普通股股本－每股面額10元，九十二及九十一年底額定分別為5,150,000千股及4,550,000千股；發行分別為3,580,280千股及3,254,800千股	35,802,800	31	32,548,000	31
	資本公積				
3211	股票溢價	14,777	–	3,171,933	3
3220	庫藏股票交易	220,735	–	–	–
3270	長期投資	3,811,262	4	3,753,594	4
32XX	資本公積合計	4,046,774	4	6,925,527	7
33XX	保留盈餘	3,808,436	3	1,173,564	1
	其他調整項目				
3410	長期股權投資未實現跌價損失	(68,833)	–	(423,620)	(1)
3420	累積換算調整數	1,559,599	1	1,847,021	2
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(16,137)	–	–	–
34XX	其他調整項目合計	1,474,629	1	1,423,401	1
3510	庫藏股票－九十二及九十一年底分別為718千股及164,442千股	(10,037)	–	(2,639,826)	(2)
3XXX	股東權益合計	45,122,602	39	39,430,666	38
	負債及股東權益總計	$ 114,324,243	100	$ 104,905,016	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司
合併損益表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
（惟每股盈餘（純損）為元）

代碼		九十二年度 金額	%	九十一年度 金額	%
	營業收入（附註二及二十六）				
4110	營業收入	$ 57,862,888	101	$ 46,058,441	101
4190	減：銷貨退回及折讓	551,118	1	471,603	1
4000	營業收入淨額	57,311,770	100	45,586,838	100
5000	營業成本（附註十八）	46,466,453	81	38,492,270	84
5910	營業毛利	10,845,317	19	7,094,568	16
	營業費用（附註二、七、八、十八及二十二）				
6100	推銷費用	1,204,912	2	909,440	2
6200	管理及總務費用	4,015,850	7	4,821,384	11
6300	研究發展支出	2,354,034	4	2,048,973	4
6000	合計	7,574,796	13	7,779,797	17
6900	營業利益（損失）	3,270,521	6	(685,229)	(1)
	營業外收入及利益				
7110	利息收入（附註二十四）	114,627	–	392,593	1
7140	處分投資利益	618,857	1	101,314	–
7480	其他	336,546	1	481,526	1
7100	合計	1,070,030	2	975,433	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用（附註二及七）	1,419,352	2	1,971,227	4
7560	兌換損失－淨額（附註二及二十四）	386,844	1	397,874	1
7520	採權益法認列之投資損失（附註二及六）	240,656	–	410,348	1
7530	已實現長期股權投資損失（附註十六）	354,787	1	–	–
7880	其他	451,182	1	220,460	1
7500	合計	2,852,821	5	2,999,909	7
7900	稅前利益（損失）	1,487,730	3	(2,709,705)	(6)
8110	所得稅利益（附註二及十九）	1,278,148	2	1,140,324	2
8900	列記非常損失前純益（損）	2,765,878	5	(1,569,381)	(4)
9200	非常損失（九十一年度係加計所得稅利益11,538千元後之淨額）（附註十一）	(75,668)	–	(34,613)	–
9400	少數股權純損	52,586	–	1,733,029	4
9600	合併純益	$ 2,742,796	5	$ 129,035	–

代碼		九十二年度		九十一年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘（純損）（附註二十）				
	列計非常損失前純益（損）	$ 0.51	$ 0.80	($ 0.24)	$ 0.05
	非常損失	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.01)
	純益（損）	$ 0.49	$ 0.78	($ 0.25)	$ 0.04
9850	稀釋每股盈餘（純損）				
	列計非常損失前純益（損）	$ 0.50	$ 0.80	($ 0.24)	$ 0.05
	非常損失	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.01)
	純益（損）	$ 0.48	$ 0.78	($ 0.25)	$ 0.04

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日　　單位：新台幣千元

		資本公積				
	普通股股本	股票溢價	庫藏股票交易	處分資產增益	長期投資	合計
九十一年一月一日餘額	$ 32,548,000	$ 3,171,933	$ –	$ 23,109	$ 3,656,472	$ 6,851,514
法定公積彌補虧損	–	–	–	–	–	–
處分資產增益之資本公積轉回保留盈餘	–	–	–	(23,109)	–	(23,109)
認列被投資公司處分資產增益之資本公積轉回保留盈餘	–	–	–	–	(7,352)	(7,352)
子公司持有本公司股票轉列為庫藏股票	–	–	–	–	–	–
認列長期投資股權變動調整數	–	–	–	–	104,474	104,474
認列被投資公司長期投資回升利益	–	–	–	–	–	–
九十一年度合併純益	–	–	–	–	–	–
累積換算調整數	–	–	–	–	–	–
九十一年十二月三十一日餘額	32,548,000	3,171,933	–	–	3,753,594	6,925,527
九十一年度盈餘分配						
法定公積	–	–	–	–	–	–
董監事酬勞	–	–	–	–	–	–
員工紅利－現金	–	–	–	–	–	–
股票股利－0.3%	97,644	–	–	–	–	–
資本公積轉作股本－9.7%	3,157,156	(3,157,156)	–	–	–	(3,157,156)
子公司出售本公司股票	–	–	220,735	–	–	220,735
認列長期投資股權變動調整數	–	–	–	–	57,668	57,668
認列子公司未認列為退休金成本之淨損失調整數	–	–	–	–	–	–
九十二年度合併純益	–	–	–	–	–	–
累積換算調整數	–	–	–	–	–	–
九十二年十二月三十一日餘額	$ 35,802,800	$ 14,777	$ 220,735	$ –	$ 3,811,262	$ 4,046,774

	保留盈餘							
法定公積	未分配盈餘（待彌補虧損）	合計	長期股權投資未實現跌價損失	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	庫藏股票	股東權益合計
$ 2,912,716	($ 1,897,062)	$ 1,015,654	($ 442,246)	$ 1,973,399	$ –	$ –	$ 41,946,321
(1,876,264)	1,876,264	–	–	–	–	–	–
2,310	20,799	23,109	–	–	–	–	–
–	7,352	7,352	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	(2,639,826)	(2,639,826)
–	(1,586)	(1,586)	–	–	–	–	102,888
–	–	–	18,626	–	–	–	18,626
–	129,035	129,035	–	–	–	–	129,035
–	–	–	–	(126,378)	–	–	(126,378)
1,038,762	134,802	1,173,564	(423,620)	1,847,021	–	(2,639,826)	39,430,666
12,903	(12,903)	–	–	–	–	–	–
–	(2,280)	(2,280)	–	–	–	–	(2,280)
–	(8,000)	(8,000)	–	–	–	–	(8,000)
–	(97,644)	(97,644)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	354,787	–	–	2,629,789	3,205,311
–	–	–	–	–	–	–	57,668
–	–	–	–	–	(16,137)	–	(16,137)
–	2,742,796	2,742,796	–	–	–	–	2,742,796
–	–	–	–	(287,422)	–	–	(287,422)
$ 1,051,665	$ 2,756,771	$ 3,808,436	($ 68,833)	$ 1,559,599	($ 16,137)	($ 10,037)	$ 45,122,602

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

日月光半導體製造股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日　　單位：新台幣千元

	九十二年度	九十一年度
營業活動之現金流量		
合併純益	$ 2,742,796	$ 129,035
少數股權純損	(52,586)	(1,733,029)
折舊	12,210,910	11,841,331
攤銷	555,658	444,995
固定資產價值減損之損失	-	1,225,555
採權益法認列之投資損失	240,656	410,348
海外可轉換公司債之利息補償金	358,286	576,437
海外可轉換公司債兌換利益	(110,655)	(69,321)
海外可轉換公司債買回註銷損失	75,668	46,151
已實現長期股權投資損失	354,787	–
應付長期投資款兌換利益	(62,747)	(34,926)
處分投資利益淨額	(618,857)	(101,314)
沖迴應付長期投資款之應付利息	–	(145,238)
提列呆帳及銷貨折讓	207,018	85,823
閒置資產損失	176,841	78,120
處分固定資產損失淨額	62,792	15,668
遞延所得稅	(1,190,500)	(1,130,358)
合併借項攤銷	819,253	815,573
匯率影響數	211,640	65,858
應計退休金	170,615	122,233
其他	(3,140)	–
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	1,071	(7,482)
應收帳款	(4,119,274)	(1,950,738)
存貨	(1,560,119)	(363,216)
預付款項及其他流動資產	84,164	(231,154)
應付票據及帳款	2,441,818	1,078,392
應付所得稅	45,393	(72,165)
應付費用及其他流動負債	264,745	217,222
營業活動之淨現金流入	13,306,233	11,313,800
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(17,534,057)	(12,657,920)
非以交易為目的之短期投資淨減少（增加）	(371,561)	2,112,050
質押定期存款減少（增加）	261,317	(287,794)
出售固定資產價款	250,535	77,142
長期投資增加	(138,019)	(49,716)
購買子公司少數股權價款	(20,976)	(2,082,137)
被投資公司減資退還股款	105,536	–
子公司出售本公司股票處分價款	2,850,524	–
其他資產增加	(1,125,361)	(831,279)
投資活動之淨現金流出	(15,722,062)	(13,719,654)

	九十二年度	九十一年度
融資活動之現金流量		
長期借款增加（償還）	(102,881)	1,161,489
買回海外可轉換公司債	(4,908,389)	(1,674,053)
發行海外可轉換公司債	6,684,882	–
短期借款增加	1,161,183	2,375,322
應付長期投資款減少	(954,411)	(249,250)
應付短期票券減少	(629,086)	(1,739,263)
少數股權增加	119,368	656,246
支付董監事酬勞及員工紅利	(10,280)	–
融資活動之淨現金流入	1,360,386	530,491
匯率影響數	($ 211,640)	($ 65,858)
現金及約當現金淨減少金額	(1,267,083)	(1,941,221)
年初現金及約當現金餘額	9,829,508	11,770,729
年底現金及約當現金餘額	$ 8,562,425	$ 9,829,508
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息（不含資本化利息）	$ 1,120,215	$ 1,248,726
支付所得稅	57,633	88,884
僅有部分現金流量之投資及融資活動		
購置固定資產支付現金		
購置固定資產價款	$ 17,234,324	$ 15,749,807
應付設備款減少（增加）	102,488	(2,566,359)
應付租賃款減少（增加）	197,245	(525,528)
支付現金數	$ 17,534,057	$ 12,657,920
發行海外可轉換公司債收取現金		
發行價款	$ 6,818,000	$ –
減：發行費用	119,315	–
應付費用增加	13,803	–
收取現金	$ 6,684,882	$ –
支付現金買回註銷海外可轉換公司債		
買回註銷海外可轉換公司債價款	$ 4,908,389	$ 3,242,110
以償債基金抵付	–	(1,568,057)
支付現金	$ 4,908,389	$ 1,674,053
不影響現金流量之投資及融資活動		
子公司及曾孫公司持有本公司股票自長期投資重分類至庫藏股票及其他流動負債	$ –	$ 2,639,826
子公司出售本公司股票迴轉庫藏股票	1,405,632	–

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

六. 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事：無。

七. 列示最近二年度財務預測達成情形，說明原預測數〔含歷次更新（正）日期、更新（正）金額及更新（正）原因〕與實際達成數差異原因及經臺灣證券交易所股份有限公司及證期會處罰者，應說明處罰原因：無。

陸. 財務狀況及經營結果之檢討與分析與風險管理

一. 財務狀況比較分析表

單位:新台幣仟元

項目 \ 年度	九十二年十二月三十一日	九十一年十二月三十一日	差異	
			金額	%
流動資產	$ 15,724,356	$ 11,907,514	$ 3,816,842	32
固定資產	22,866,828	20,888,848	1,977,980	9
其他資產	2,760,994	1,440,314	1,320,680	92
資產總額	76,584,124	68,580,838	8,003,286	12
流動負債	10,287,608	11,704,753	(1,417,145)	(12)
長期負債	20,715,922	17,121,519	3,594,403	21
負債總額	31,461,522	29,150,172	2,311,350	8
股　本	35,802,800	32,548,000	3,254,800	10
資本公積	4,046,774	6,925,527	(2,878,753)	(42)
保留盈餘	3,808,436	1,173,564	2,634,872	225
股東權益總額	45,122,602	39,430,666	5,691,936	14

註1:最近兩年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目:

1. 流動資產增加,主係九十二年度為因應半導體景氣復甦,增加原料備貨908,528仟元;另營業收入成長,應收款項(含關係人)增加1,989,436仟元所致。
2. 其他資產增加,主係九十二年度本公司與設備供應商簽訂機器設備租賃合約而增加存出保證金186,835仟元及遞延所得稅資產因九十二年度取得之機器設備投資抵減增加及未使用之投資抵減金額經評估增加非流動金額所致。
3. 長期負債增加,主係九十二年九月發行歐式附轉換條件無擔保之可轉換公司債2億美元所致。
4. 資本公積減少,主係九十二年度辦理資本公積轉增資3,157,156仟元所致。
5. 保留盈餘增加,主係九十二年度之純益較上年度增加2,742,796仟元所致。

註2:最近兩年度流動負債及一年內到期之長期負債發生變動之主要原因及影響與未來因應計劃:本公司發生變動之主要原因係償還一年內到期之長期負債金額增加,致使負債金額減少,並無特別未來因應計劃。

二. 經營結果比較分析

(一) 經營結果比較分析表

單位:新臺幣仟元

	九十二年度		九十一年度		增(減)金額	增(減)變動比例(%)
	小計	合計	小計	合計		
營業收入總額	$ 31,818,730		$ 25,929,168		$ 5,889,562	
減:銷貨折讓	(330,939)		(297,392)		(33,547)	
營業收入淨額		$ 31,487,791		$ 25,631,776	5,856,015	22.8
營業成本		25,747,765		20,653,713	5,094,052	24.7
營業毛利		5,740,026		4,978,063	761,963	15.3
營業費用		2,308,059		1,791,820	516,239	28.8
營業利益		3,431,967		3,186,243	245,724	7.7
營業外收入及利益						
利息收入	47,670		268,148			
其他收入	111,735	159,405	221,358	489,506	(330,101)	(67.4)
營業外費用及損失						
利息費用	650,447		977,629			
採權益法認列之投資損失	473,436		3,143,060			
其他損失	373,857	1,497,740	191,874	4,312,563	(2,814,823)	(65.3)
稅前利益(損失)		2,093,632		(636,814)	(2,730,446)	428.8
所得稅利益		649,164		800,462	(151,298)	(18.9)
列記非常損失前利益(損失)		2,742,796		163,648	2,579,148	1,576.0
非常損失		–		(34,613)	34,613	–
純益(損)		$ 2,742,796		$ 129,035	$ 2,613,761	2,025.6

增減比例變動分析說明:

營業費用較上年度增加,主因本年度薪資結構調整及外銷佣金隨銷售金額提高所致。

營業外收入及利益較上年度減少,主因上年度從事利率交換合約及投資海外基金分別產生利息收入248,620仟元所致;營業外費用及損失較上年度減少,主因轉投資事業虧損減少,致本年度採權益法認列之投資損失較上年度減少2,669,624仟元。

非常損失係因上年度提前買回並註銷海外可轉換公司債而產生提前買回損失。

（二）營業毛利變動分析：不適用。

三. 現金流量分析

（一）最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	九十二年度	九十一年度	增減比例（%）
現金流量比率（%）	53.93	52.80	2
現金流量允當比率（%）	69.12	71.64	(4)
現金再投資比率（%）	6.63	8.72	(24)

現金再投資比率下降，主係營業活動現金流量較上年度減少，但資本支出較上年度增加所致。

（二）未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額（1）	預計全年來自營業活動淨現金流量（2）	預計全年現金流出量（3）	預計現金剩餘（不足）數額（1）+（2）−（3）	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
$ 4,839,182	$ 11,420,798	$ 24,435,395	($ 8,175,415)	$ –	$ 19,281,000

1. 現金流量變動情形分析：
   （1）營業活動：主因預計九十三年度營業淨利增加及其他營業資產負債之變動所致。
   （2）投資活動：主因預計九十三年度將購置固定資產及增加長期股權投資。
   （3）融資活動：主因預計九十三年度將償還到期之銀行借款。
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：
   本公司九十三年度預計現金不足數額將以募集參與發行海外存託憑證及公司債支應。

四. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

（一）重大資本支出之運用情形及資金來源

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形
				九十三年度
擴建廠房	銀行借款及營運資金	93.12	1,971,580	1,971,580
購置機器設備	發行美國存託憑證、銀行借款及營運資金	93.12	14,330,619	14,330,619

（二）預期可能產生效益

1. 預計可增加之產銷量、值及毛利

單位：數量千個／新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
九十三	半導體製造封裝	360,000	360,000	10,000,000	2,600,000

註：僅針對九十三年度之資本支出在九十三年度預計可能產生之效益估算。

2. 其他效益說明（如產品品質、污染防治、成本減少等）：無。

五. 最近年度轉投資政策

本公司最近年度之轉投資政策係以投資本業相關產業為主，並以核心競爭力為主要考量，對每一投資案皆經審慎評估後為之，九十二年度並無投資金額超過實收資本額百分之五之情事。

六. 風險管理之分析評估

（一）最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

延續去年度利率下滑趨勢，在經濟基本面尚未大幅改善之前，不論台幣或外幣利率均將維持向下走勢，對本公司運用貨幣市場融資工具之資金成本降低有正面助益，未來則將視貨幣市場利率走勢，適時鎖定未來利率回漲之風險。匯率部份，不論台幣或日圓均屬大區間上下浮動之格局，原則上以鎖定國際經濟重大突發事件並觀察其後續變化為管理焦點，以降低市場波動性風險為主要管理方向，因此，避險策略以採短天期現金流量避險為主，對長天期之資本支出或經常性風險部位，則採自然避險為原則。通貨膨漲之變動若持續，當原物料持續漲價，對公司營收獲利會有不利影響，目前本公司將密切觀察並適時採取必要措施。

（二）最近年度從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司並未從事高風險、高槓桿之投資，亦未有資金貸與他人之情事，本公司已依據證期會的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序，這些管理辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。對於背書保證之政策，則以事先評估其必要性及合理性為執行依據；對於衍生性商品交易政策，均視避險標的之部位大小與避險之必要性，於自然避險後採取適時適量之避險方式執行財務風險管理。

（三）最近年度研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素

1. 九十二年度之研發計劃

- 無鉛塊覆晶封裝產品（Lead free Flip Chip Package）
- 晶圓級影像感測器封裝計劃（Wafer level CMOS image sensor）
- 透明膠模鑄封裝計劃（Clear compound molded IC package）
- 微機電製微顯示器計劃（MEMS-based Micro display）

2. 九十二年度未完成之研發計劃之研發狀況

單位：新台幣仟元

項目 / 研發計畫	未完成研發計劃目前進度	應再投入之研發費用	預計完成量產時間
無鉛塊覆晶封裝產品 (Leadfree Flip Chip Package)	80%, 正在實施產品驗證測試 (Reliability Test is on going)	$ 5,000	93年第三季
晶圓級影像感測器封裝計劃	關鍵製程建立	$ 25,000	93年第四季
透明膠模鑄封裝計劃	量產線建立	$ 10,000	93年第二季
微機電製微顯示器計劃	量產線建立	$ 16,000	93年第三季

3. 未來研究計劃

- 綠色環保覆晶封裝（Green Flip Chip Package）
- 覆晶四邊扁平無接腳封裝產品（Flip Chip QFN Package）（QFN: Quad Flat No Lead）
- 晶圓級氣密式封裝技術（Wafer level hermetic packaging technology）

4. 未來研發得以成功之主要影響因素

- 完善的研發專案管理系統
- 對市場之供需狀況充分掌握
- 時程及人員能夠有效管控
- 客戶導向的組織設計與內部運作機制
- 人才培育機制之強化
- 知識管理系統之落實與強化

（四）最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

1. 本公司設有專責人員隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，負責適時諮詢法務及會計等相關專家之評估、建議及規劃因應措施。

2. 最近年度本公司並無因國內外政策及法律變動而對本公司財務業務產生重大之影響。

3. 另，本公司發行海外存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌，須遵守美國證期會及交易所制定之Sarbanes-Oxley法案及相關法規，本公司業已採取配合措施以符合該法令之規定，並將持續密切注意相關法令之發展，以儘早評估及規劃因應措施。

（五）最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施

科技的不確定性（Uncertainty）與不連續性確為半導體產業的一大挑戰，日月光透過與客戶的更密切互動來掌握客戶需求及其變化，並強化市場資訊的收集與分析來降低科技改變所帶來的影響。

（六）最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司一向秉持誠信、守法及善盡社會責任之經營理念，故本公司之企業形象一向良好，最近年度亦無企業形象改變之情事。

七. 其他重要事項：無。

柒. 上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一. 公司股權結構及股東權益		
(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式	本公司有專人負責股務相關事宜。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形	本公司每月均經由董監事及持股10%以上大股東之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東之名單，並經由與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	透過內部控制制度及相關辦法之制定及落實，稽核單位並定期監督執行情形。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
二. 董事會之組成及職責		
(一) 公司設置獨立董事之情形	本公司目前並無設置獨立董事	尚在評估規劃中
(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	本公司均定期評估簽證會計師的獨立性，目前本公司之簽證會計師與公司、董事及監察人均非關係人，獨立性並無疑慮。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
三. 監察人之組成及職責		
(一) 公司設置獨立監察人之情形	本公司目前並無設置獨立監察人	尚在評估規劃中
(二) 監察人與公司之員工及股東溝通之情形	目前公司之員工及股東均直接與本公司溝通	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
四. 建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司責成相關單位專責處理債權人、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜，員工亦設有工會定期與公司溝通。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
五. 資訊公開		
(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司已架設英文網站，並責成相關部門專責維護並定期及不定期揭露公司財務業務情形，網址為 http://www.aseglobal.com	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
(二) 公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	i. 本公司指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊並依相關規定發佈重大訊息。 ii. 本公司設有發言人及代理發言人制度，並不定期召開法人說明會，並於本公司之網站上揭露法人說明會之相關資訊。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
六. 公司設置審計委員會等功能委員會之運作情形	本公司目前並無設置審計委員會	尚在評估規劃中

七. 公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司目前係遵照相關法令執行相關作業並依公司治理守則之精神改善中，未來將考量實際運作情形及內外部環境之評估作為訂定公司治理實務守則之依據。

八. 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等）：

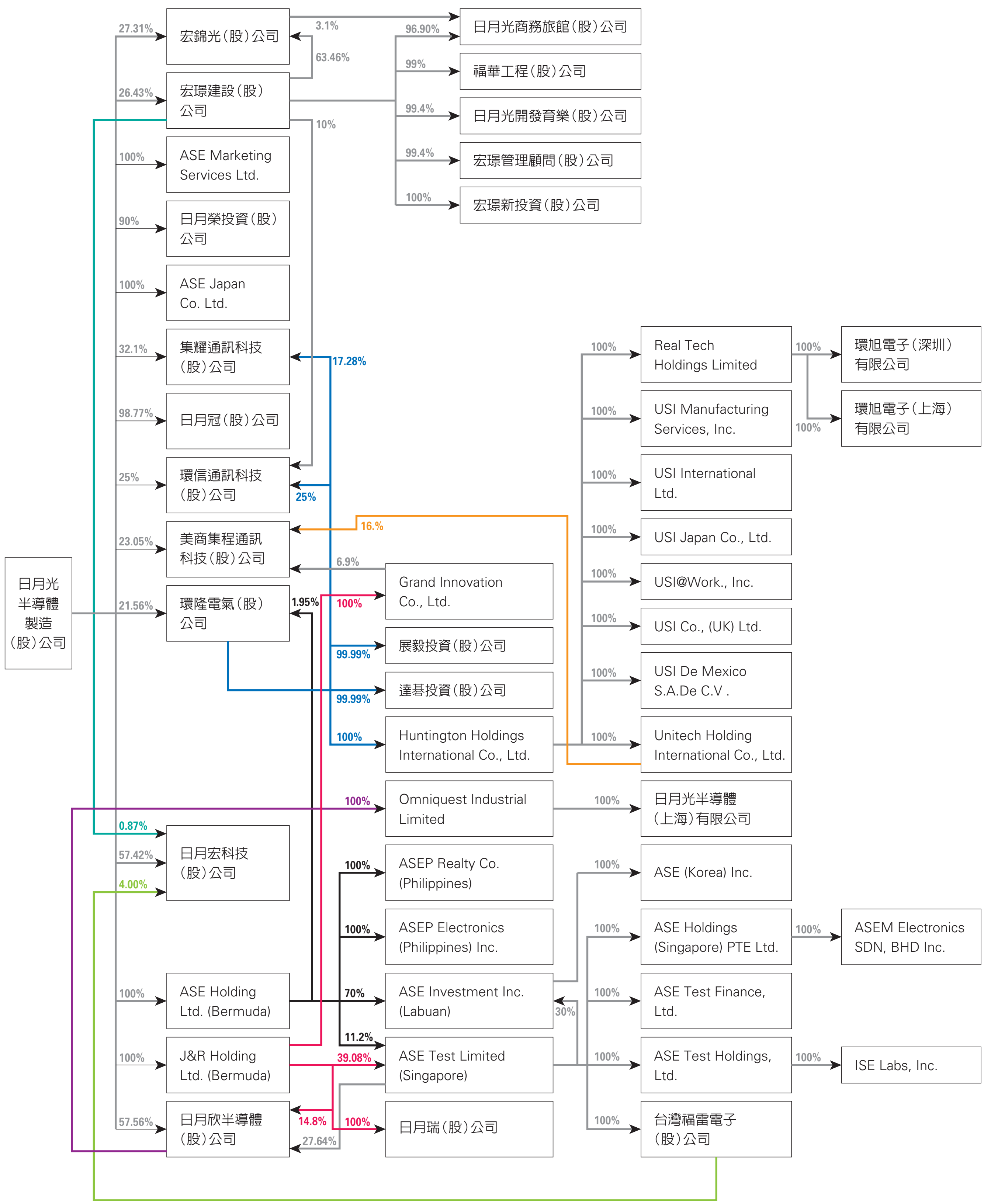
1. 董事及監察人進修之情形：本公司之董事及監察人均依其個別需求自行進修。
2. 董事出席及監察人列席董事會狀況：本公司董事除在國外，原則上均會出席董事會。本公司每次董事會議案皆會通知監察人，監察人則視情形對重要議案會列席董事會。
3. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事對利害關係議案絕對遵守利害關係人迴避原則。
4. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。

註1：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註2：如為證券商、投信投顧及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

捌. 特別記載事項

一. 關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖



（二）各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光半導體製造（股）公司	73年3月	高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號	NT$35,802,800仟元	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASE Marketing Services Ltd.	80年2月	香港	NT$16,985仟元（USD$500仟元）	海外基地轉接訂單及客戶之服務
J&R Holding Ltd.（Bermuda）	84年12月	百慕達	NT$408仟元（USD$12仟元）	從事專業性投資
日月瑞（股）公司	88年4月	高雄市楠梓加工出口區開發路三十一號4樓	NT$4,653,000仟元	各型積體電路之封裝及引線架之製造、加工及產製引線架、封裝測試用機器設備之租賃
日月榮股份有限公司	89年2月	台北市基隆路一段333號19樓	NT$1,500,000仟元	從事專業性投資
ASE Holding Ltd.（Bermuda）	79年4月	百慕達	NT$7,412,363仟元（USD$218,203仟元）	從事專業性投資
ASE Investment（Labuan）Inc.	88年6月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	NT$3,925,946仟元（USD$115,571仟元）	從事專業性投資
Omniquest Industrial Limited	89年9月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT$604,666仟元（USD$17,800仟元）	從事專業性投資
日月光半導體（上海）有限公司	（註）	上海張江高科技園區A6-2地塊	NT$604,666仟元（USD$17,800仟元）	發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷
日月宏科技（股）公司	86年12月	高雄市楠梓加工出口區開發路七十三號	NT$2,500,000仟元	積體電路用引線架之製造組合加工及測試
日月欣半導體（股）公司	88年4月	桃園縣中壢市中華路一段550號	NT$6,350,000仟元	電子零組件、通信機械器材製造
環信通訊科技（股）公司	89年9月	台北縣信義區基隆路一段420號10樓	NT$150,000仟元	從事產品設計業、資訊軟體服務業、租賃業及電訊、資訊、電子批發零售業
日月冠（股）公司	80年6月	高雄市楠梓加工出口區開發路十七號之四	NT$200,000仟元	資訊產品及其周邊設備之研究、製造及銷售
ASE Holding Electronics（Philippines）	84年11月	Lot 3,4& 5, Block 7, First Cavite Industrial Estate, Bo. Langkaan, Dasmarinas, Cavite 4114	NT$1,941,066仟元（Peso$2,423,733仟元）	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASEP Realty Co.（Philippines）	84年10月	Lot 3,4& 5, Block 7, First Cavite Industrial Estate, Bo. Langkaan, Dasmarinas, Cavite 4114	NT$7,744仟元（Peso$6,000仟元）	房地產投資、買賣及出租
ASE Test Ltd.（Singapore）	84年12月	36 Robinson Road. #18-01, City House, Singapore	NT$845,396仟元（USD$24,887仟元）	從事專業性投資
台灣福雷電子（股）公司	76年12月	高雄市楠梓加工出口區西五街十號	NT$3,010,000仟元	半導體產品測試服務
ASE Test Holdings, Ltd.	88年4月	Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.	NT$170元（USD$ 5元）	從事專業性投資
ASE Holdings（Singapore）Pte Ltd.	83年12月	10, Hoe Chiang Road, #17-02 Keppel Towers, Singapore	NT$1,429,149仟元（SGD$71,429仟元）	從事專業性投資
ASE Test Finance, Ltd.	88年6月	608 St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Mauritius	NT$68元（USD$2元）	從事專業性理財活動
ASE（Korea）Inc.	56年3月	494,Munbal-Ri,Kyoha,Paju-Si, Kyunggi-Do,Korea	NT$1,290,061仟元（USD$37,976仟元）	IC測試及封裝
ASE Electronics（M）Sdn. Bhd.	80年2月	Plot 20, Phase IV, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang	NT$2,114,978仟元（UD$62,260仟元）	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ISE Labs,Inc.	72年11月	3600 Peterson Way, Santa Clara, California, U.S.A	NT$892仟元（USD$26仟元）	半導體產品測試服務
集耀通訊科技股份有限公司	91年6月	新竹市水源街93號9樓之三	NT$162,000仟元	從事資料儲存處理設備、無線有線通信機械器材、電子零組件、電器、一般儀器製造
美商集程通訊科技股份有限公司	89年7月	777 San Antonic Road, No90, Palo Alto, CA 94303	NT$589仟元（包括普通股股本USD$3仟元及可轉換特別股股本US$14仟元）	無線通訊領域發展相關產品
Grand Innovation Co., Ltd.	90年2月	Beaufort House, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT$40,764仟元（USD$1,200仟元）	從事專業性投資
ASE Japan Co., Ltd.	92年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	NT$19,074仟元（￥60,000仟元）	從事市場行銷及顧客服務等業務
環隆電氣股份有限公司	63年2月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$6,885,000仟元	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工及銷售
展毅公司	85年10月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$436,000仟元	專業投資
達碁公司	87年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT$50,000仟元	專業投資
HHI公司	85年10月	P.O.Box 3321 Road Town,Tortola BVI	NT$3,581,525仟元（US$105,432仟元）	控股公司
環隆墨西哥公司	86年9月	Av. R. Flores Magon No. 656 Col Residencial Sta Isabel C.P. 44290 Guadalajara, Jal.	NT$1,819,054仟元（PESO$601,082仟元）	主機板及電腦系統組裝
環隆英國公司	87年4月	Steadman Place Riverside Business Park Irvine, Ayrshire Scotland UK KALL 5DN	NT$1,536,893仟元（£25,420仟元）	電腦系統組裝
環隆日本公司	89年3月	12F East Tower, Yokohama Business Park, 134 Godo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0005	NT$101,696仟元（￥320,000仟元）	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
RTH公司	89年3月	TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, B.V. I.	NT$1,083,677仟元（US$31,901仟元）	控股公司

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
環旭深圳公司	89年6月	深圳市南山區華僑城東部工業區H1棟 1、4、5層	NT$883,220仟元（US$26,000仟元）	生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售
環旭上海公司	92年1月	上海市張江高科技園區集成電路產業區龍 東大道3000號	NT$197,026仟元（US$5,800仟元）	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務
UI公司	89年2 月	6F, United Chinese Bank Building, 31-37 Des Voeux Road Central, Hong Kong	NT$3,431仟元（US$101仟元）	主機板及相關電腦週邊設備之買賣
USI-CA公司	89年10 月	685A Jarvis Drive Morgan Hill, CA 95037	NT$322,715仟元（US$9,500仟元）	電腦資訊設備之樣本製作、維修服務
USI@Work	90年2月	1320 S.E.Maynard Road, Suite 103, Cary, NC 27511	NT$5,096仟元（US$150仟元）	海外售後服務
UHI公司	86年4月	P.O.Box 3321 Road Town Tortola BVI	NT$260,822仟元（US$7,678仟元）	控股公司
宏璟建設（股）公司	75年12月	台北市信義區基隆路一段420號10樓	NT$4,758,090仟元	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租業務、買賣各種建材及其進出口業務、房屋租售之介紹業務、室內設計裝潢工程
宏璟新投資（股）公司	86年11月	台北市基隆路1段420號10樓	NT$250,000仟元	一般投資
福華工程（股）公司	56年5月	台北市基隆路1段420號3樓之2	NT$117,200仟元	營造工程之承攬
宏錦光（股）公司	81年6月	台北市基隆路1段420號10樓	NT$1,430,000仟元	自有剩餘攤位及辦公大樓出租
宏璟管理顧問（股）公司	81年9月	台北市基隆路1段420號10樓	NT$1,000仟元	大樓清潔維護等業務
日月光商務旅館（股）公司	88年1月	新竹市富群街3號	NT$195,000仟元	商務套房
日月光開發育樂（股）公司	88年4月	台北市基隆路1段420號10樓	NT$10,000仟元	遊樂園業及休閒活動場館

註：2001年7月設立日月華科技（杭州）有限公司，並於2002年9月經核准變更投資地點並更名為日月光半導體（上海）有限公司。

（三）推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

（四）整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

1. 本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業包括電子製造業、電子服務業、投資業、租賃業及建設業。

2. 日月光集團長久以來專注於提供半導體客戶完整之半導體封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝材料及性能測試之服務。此外，客戶也可透過關係企業環隆電氣（股）公司獲得完善的電子製造服務整體解決方案。

3. 大體而言本公司各關係企業間所經營業務互有關聯，其往來分工情形向以透過技術、產能、行銷以及服務之相互支援，以發揮集團最大競爭實力，創造最大綜效，鞏固本公司在業界的領導地位。

（五）各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月光半導體製造股份有限公司	董事長	張虔生	22,280,327股	0.62%
	副董事長兼總經理	張洪本	40,899,973股	1.14%
	董事	香港商微電子國際公司	691,235,417股	19.31%
	董事（代表人）	潘士華	—	—
	董事（代表人）	秦克儉	—	—
	董事（代表人）	董宏思	—	—
	董事（代表人）	陳昌益	—	—
	董事（代表人）	吳田玉	—	—
	監察人	馮美珍	63,383,829股	1.77%
	監察人	香港商微電子國際公司	691,235,417股	19.31%
	監察人（代表人）	羅瑞榮	—	—
	監察人（代表人）	何弘	—	—
	監察人（代表人）	鄭天正	—	—
	監察人（代表人）	曾元一	—	—
ASE Marketing Services Ltd.	董事	日月光半導體製造股份有限公司	499,999股	100%
	董事（代表人）	Jason C. S. Chang	—	—
	董事（代表人）	Richard H. P. Chang	—	—
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
J&R Holding Ltd. (Bermuda)	董事	日月光半導體製造股份有限公司	12股	100%
	董事（代表人）	Jason C. S. Chang	—	—
	董事（代表人）	Richard H. P. Chang	—	—
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
日月瑞股份有限公司	董事	J&R Holding Ltd. (Bermuda)	465,300,000股	100%
	董事（代表人）兼董事長	張虔生	—	—
	董事（代表人）	張洪本	—	—
	董事（代表人）	董宏思	—	—
	監察人	馮美珍	1股	0.00%
日月榮投資股份有限公司	董事	日月光半導體製造股份有限公司	134,999,995股	90%
	董事（代表人）兼董事長	張虔生	—	—
	董事（代表人）	張洪本	—	—
	董事（代表人）	董宏思	—	—
	董事（代表人）	劉詩亮	—	—
	董事	智邦科技股份有限公司	15,000,000股	10%
	董事（代表人）	黃安捷	—	—
	監察人	日月光半導體製造股份有限公司	134,999,995股	90%
	監察人（代表人）	何弘	—	—
ASE Holding Ltd. (Bermuda)	董事	日月光半導體製造股份有限公司	218,203股	100%
	董事（代表人）	Jason C. S. Chang	—	—
	董事（代表人）	Richard H. P. Chang	—	—
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
ASE Investment (Labuan) Inc.	董事	ASE Holding Ltd. (Bermuda)	80,879,714股	69.98%
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
	董事	Mathew-Willie	—	—
	董事	ASE Test Ltd. (Singapore)	34,691,271股	30.02%
	董事（代表人）	Jeffrey Chen	—	—
Omniquest Industrial Limited	董事	日月欣半導體（股）公司	17,800,000股	100%
	董事（代表人）	Richard H. P. Chang	—	—
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
	董事（代表人）	Jeffrey Chen	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月光半導體(上海)有限公司	董事	Omniquest Industrial Limited	—	100%
	董事(代表人)兼董事長	張洪本	—	—
	董事(代表人)	何弘	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
日月宏科技(股)公司	董事	張洪本	14,524,368股	5.81%
	董事	日月光半導體製造股份有限公司	143,547,583股	57.42%
	董事(代表人)兼董事長	秦克儉	—	—
	董事(代表人)兼總經理	林國洸	—	—
	董事	台灣福雷電子股份有限公司	10,000,000股	4.00%
	董事(代表人)	潘士華	—	—
	監察人	日月光半導體製造股份有限公司	143,547,583股	57.42%
	監察人(代表人)	馮美珍	—	—
	監察人(代表人)	陳昌益	—	—
日月欣半導體(股)公司	董事長	張洪本	1股	0%
	董事	新加坡商福雷電子(股)公司	175,500,000股	27.64%
	董事(代表人)	董宏思	—	—
	董事	日月光半導體製造(股)公司	365,483,259股	57.56%
	董事(代表人)	秦克儉	—	—
	董事(代表人)	李石松	—	—
	董事(代表人)	潘士華	—	—
	監察人	馮美珍	1股	0.00%
	總經理	陳天賜	—	—
環信通訊科技(股)公司	董事	日月光半導體製造股份有限公司	3,750,000股	25%
	董事(代表人)兼董事長	何 弘	—	—
	董事(代表人)	張虔生	—	—
	董事(代表人)	劉英武	—	—
	董事	環隆電氣股份限公司	3,750,000股	25%
	董事(代表人)	陳光禎	—	—
	董事	葉憲昌	1,105,000股	7.37%
	董事	狄建暉	5,000股	0.03%
	監察人	宏璟建設股份有限公司	1,500,000股	10%
	監察人(代表人)	董宏思	—	—
日月冠股份有限公司	董事長	張虔生	81,593股	0.41%
	董事	周家佩	46股	0.00%
	董事	日月光半導體製造股份有限公司	19,753,830股	98.77%
	董事(代表人)	董宏思	—	—
	監察人	日月光半導體製造股份有限公司	19,753,830股	98.77%
	監察人(代表人)	張金桃	—	—
	總經理	張洪本	9,047股	0.05%
ASE Holding Electronics (Philippines)	董事長	Chang, Fu Sing	1股	0.00%
	董事	Chiu, Tong Chin	1股	0.00%
	董事	Wang, Yung Kang	1股	0.00%
	董事	So, Stephen G.	1股	0.00%
	董事	Wu, Chung Ting	1股	0.00%
ASEP Realty Co. (Philippines)	董事長	So, Stephen G.	—	—
	董事	Chang, Fu Sing	—	—
	董事	Wu, Chung Ting	—	—
	董事	Benjamin M. Arias	—	—
	董事	Zarate, Jonathan B.	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
ASE Test Ltd. (Singapore)	董事長	Richard H.P. Chang	1,046,276股	1.05%
	董事	Leonard Y. Liu	40,000股	0.04%
	董事	J&R Holding Ltd. (Bermuda)	38,902,740股	39.08%
	董事（代表人）	Jeffrey Chen	—	—
	董事	ASE Holding Ltd. (Bermuda)	11,148,000股	11.20%
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
	董事	David Pan	4,700股	0.00%
	董事	Albert C.S. Yu	45,176股	0.05%
	董事	David D.H. Tsang	—	—
	董事	Chin Ko-Chien	36,000股	0.04%
	董事	Wang Yung-Kang	20,000股	0.02%
	董事	Alan Tien-Cheng Cheng	—	—
	董事	Sim Guan Seng	—	—
	董事	Raymond Lo	—	—
	董事	Kanapathi A/L Kappusamy	—	—
台灣福雷電子（股）公司	董事	新加坡福雷電子股份有限公司	300,955,033股	99.99%
	董事（代表人）兼董事長	張虔生 (Jason C. S. Chang)	—	—
	董事（代表人）	張洪本	—	—
	董事（代表人）	秦克儉	—	—
	董事（代表人）	劉英武	—	—
	董事（代表人）	臧大化	—	—
	董事（代表人）	潘士華	—	—
	董事（代表人）	張姚宏影	—	—
	董事（代表人）	陳昌益	—	—
	董事（代表人）	鄭天正	—	—
	董事（代表人）兼總經理	羅瑞榮	—	—
	董事（代表人）	許慶如	—	—
	監察人	新加坡福雷電子股份有限公司	300,955,033股	99.99%
	監察人（代表人）	董宏思	—	—
	監察人（代表人）	王永剛	—	—
	監察人（代表人）	余建新	—	—
ASE Test Holdings,Ltd.	董事	ASE Test Ltd. (Singapore)	5股	100%
	董事（代表人）	Jason C. S. Chang	—	—
	董事（代表人）	David Pan	—	—
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
	董事（代表人）	Jeffrey Chen	—	—
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd.	董事	ASE Test Ltd. (Singapore)	71,428,902股	100%
	董事（代表人）	Hsiang De Way	—	—
	董事（代表人）	Kanapathi A/L Kuppusamy	—	—
	董事（代表人）	Jeswant Singh s/o Darshan Singh	—	—
ASE Test Finance,Ltd.	董事	ASE Test Ltd. (Singapore)	2股	100%
	董事（代表人）	Joseph Tung	—	—
	董事（代表人）	David Hsiang	—	—
	董事（代表人）	Narghis Bundhun (Mrs)	—	—
	董事（代表人）	M.Aslam Koomar (Mr.)	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
ASE (Korea) Inc.	董事	ASE Investment (Labuan) Inc.	7,613,363股	100%
	董事(代表人)	James D. Stilson	—	—
	董事(代表人)	Richard H. P. Chang	—	—
	董事(代表人)	David Pan	—	—
	董事(代表人)	Joseph Tung	—	—
	董事(代表人)	Cheng, Tien-Cheng	—	—
	董事(代表人)	Jason C. S. Chang	—	—
ASE Electronics (M) Sdn, Bhd.	董事	ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd.	159,715,000股	100%
	董事(代表人)	Richard H. P. Chang	—	—
	董事(代表人)	Mei-Jean Chang	—	—
	董事(代表人)	David Pan	—	—
	董事(代表人)	Joseph Tung	—	—
	董事(代表人)	David Hsiang	—	—
	董事(代表人)	Kanapathi A/L Kuppusamy	—	—
ISE Labs, Inc.	董事	ASE Test Holdings, Ltd.	26,250,000股	100%
	董事(代表人)	Jason C. S. Chang	—	—
	董事(代表人)	David Pan	—	—
	董事(代表人)	Joseph Tung	—	—
	董事(代表人)	Jeffrey Chen	—	—
美商集程通訊科技股份有限公司	董事	日月光半導體製造股份有限公司	4,000,000股	23.05%
	董事(代表人)	Joseph Tung	—	—
	董事	UHI公司	2,800,000股	16.14%
	董事(代表人)	John Ho	—	—
	董事兼總經理	Kwang-Cheng Chen	2,400,000股	13.83%
	董事	Ta-Sung Lee	300,000股	1.73%
	董事	Frank Ys Lin	300,000股	1.73%
	董事	GainTech Company Limited	2,400,000股	13.83%
	董事(代表人)	Ming-Kai Tsai	—	—
	董事	Global Strategic Investment Inc.	1,200,000股	6.92%
	董事(代表人)	Beatrice Ku	—	—
集耀通訊科技(股)公司	董事	日月光半導體製造(股)公司	5,200,000股	32.10%
	董事(代表人)	何弘	—	—
	董事(代表人)	林永松	—	—
	董事(代表人)	董宏思	—	—
	董事長	陳光禎	2,000股	0.01%
	董事	Global Strategic Investment Inc.	1,400,000股	8.64%
	董事(代表人)	顧蓓華	—	—
	董事	翔發投資股份有限公司	2,400,000股	14.81%
	董事(代表人)	蔡明介	—	—
	董事	李大嵩	2,000股	0.01%
	監察人	日月光半導體製造(股)公司	5,200,000股	32.10%
	監察人(代表人)	劉詩亮	—	—
	監察人	范瑞穎	—	—
Grand Innovation Co., Ltd.	董事	J&R Holding Limited	1,200,001股	100%
	董事(代表人)	董宏思	—	—
ASE Japan Co., Ltd.	董事	日月光半導體製造股份有限公司	1,200股	100%
	董事(代表人)	Tien Yu Wu	—	—
	董事(代表人)	Sekka Mochizuki	—	—
	董事(代表人)	Hiroshi Munakata	—	—
	監察人	日月光半導體製造股份有限公司	1,200股	100%
	監察人(代表人)	Geofferey Wang	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
環隆電氣股份有限公司	董事	日月光半導體製造股份有限公司	144,936,050股	21.56%
	董事(代表人)兼董事長	張洪本	—	—
	董事(代表人)兼總經理	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	陳昌益	—	—
	董事(代表人)	劉英武	—	—
	董事(代表人)	馮源泉	—	—
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	董事	中華開發工業銀行股份有限公司	38,498,362股	5.73%
	董事(代表人)	陳瑞勳	—	—
	董事	劉畀澧	14,000股	0.00%
	董事	崔 湧	201,252股	0.03%
	監察人	日月光半導體製造股份有限公司	144,936,050股	21.56%
	監察人(代表人)	董宏思	—	—
	監察人(代表人)	許慶如	—	—
	監察人	中華開發工業銀行股份有限公司	38,498,362股	5.73%
	監察人(代表人)	張繁彥	—	—
展毅投資股份有限公司	董事	環隆電氣股份有限公司	43,599,994股	99.99%
	董事(代表人)兼董事長	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	監察人	環隆電氣股份有限公司	43,599,994股	99.99%
	監察人(代表人)	蘇丁興	—	—
達碁公司	董事	環隆電氣股份有限公司	4,999,994股	99.99%
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	監察人	環隆電氣股份有限公司	4,999,994股	99.99%
	監察人(代表人)	蘇丁興	—	—
HHI公司	董事	環隆電氣股份有限公司	105,431,840股	100%
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
環隆墨西哥公司	董事	HHI公司	601,082,435股	100%
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	黃嘉興	—	—
環隆英國公司	董事	HHI公司	25,419,968股	100%
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
環隆日本公司	董事	HHI公司	6,400股	100%
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	監察人	HHI公司	6,400股	100%
	監察人(代表人)	蘇丁興	—	—
RTH公司	董事	HHI公司	31,901,000股	100%
	董事(代表人)	張洪本	—	—
	董事(代表人)	何 弘	—	—

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
環旭深圳公司	董事	RTH公司	—	100%
	董事(代表人)	張洪本	—	—
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
	董事(代表人)	蘇丁興	—	—
環旭上海公司	董事	RTH公司	—	100%
	董事(代表人)	張洪本	—	—
	董事(代表人)	劉英武	—	—
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
UI公司	董事	HHI公司	101,100股	100%
	董事(代表人)	何 弘	—	—
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
USI-CA公司	董事	HHI公司	9,500,000股	100%
	董事(代表人)	吳輝煌	—	—
	董事(代表人)	蘇丁興	—	—
	董事(代表人)	魏鎮炎	—	—
USI@WORK	董事	HHI公司	150,000 股	100%
	董事(代表人)	Jeh Chang Lee	—	—
	董事(代表人)	Lihwa Christensen	—	—
UHI公司	董事	HHI公司	7,678,000股	100%
	董事(代表人)	黃嘉興	—	—
	董事(代表人)	何 弘	—	—
宏璟建設股份有公司	董事長	曾元一	30,000股	0.01%
	董事	鄭天正	243,764股	0.05%
	董事	王湘浩	10,000股	0.00%
	董事	周家佩	117,832股	0.03%
	董事	日月光半導體製造股份有限公司	119,408,060股	26.42%
	董事(代表人)兼總經理	簡文祥	—	—
	董事(代表人)	邱進益	—	—
	董事(代表人)	俞旭濬	—	—
	監察人	汪渡村	—	—
	監察人	周朝章	2,399,396股	0.53%
宏璟新投資股份有限公司	董事	宏璟建設股份有限公司	24,999,400股	100%
	董事(代表人)兼董事長	曾元一	—	—
	董事(代表人)	鄭天正	—	—
	董事(代表人)	簡文祥	—	—
	監察人	馮美珍	100股	0.00%
福華工程股份有限公司	董事	宏璟建設股份有限公司	116,128股	99.09%
	董事長	曾元一	—	—
	董事(代表人)	鄭天正	—	—
	董事	曾玉藻	432股	0.37%
	董事	簡文祥	—	—
	董事	周家佩	10股	0.01%
	監察人	王湘浩	—	—
宏錦光股份有限公司	董事	宏璟建設股份有限公司	90,743,500股	63.46%
	董事(代表人)董事長	曾元一	—	—
	董事(代表人)	鄭天正	—	—
	董事(代表人)	簡文祥	—	—
	監察人	馮美珍	13,209,000股	9.24%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
宏璟管理顧問股份有限公司	董事	宏璟建設股份有限公司	99,400股	99.40%
	董事（代表人）董事長	王湘浩	—	—
	董事	馮美珍	100股	0.10%
	董事	王文煒	100股	0.10%
	監察人	陳雲仙	100股	0.10%
日月光商務旅館股份有限公司	董事	宏璟建設股份有限公司	18,895,000股	96.90%
	董事（代表人）兼董事長	曾元一	—	—
	董事（代表人）	簡文祥	—	—
	董事（代表人）	鄭天正	—	—
	董事（代表人）	王湘浩	—	—
	董事（代表人）	畢乃辰	—	—
	監察人	宏璟建設股份有限公司	18,895,000股	96.90%
	監察人（代表人）	周家佩	—	—
日月光開發育樂股份有限公司	董事長	鄭士豪	1,000股	0.10%
	董事	宏璟建設股份有限公司	994,000股	99.40%
	董事（代表人）	鄭天正	—	—
	董事	項迪豪	1,000股	0.10%
	監察人	簡文祥	1,000股	0.10%

（六）各關係企業營運概況

單位：新台幣千元 / 每股盈餘為新台幣元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益（稅後）	每股盈餘（稅後）
日月光半導體製造（股）公司	35,802,800	76,584,124	31,461,522	45,122,602	31,487,791	3,431,967	2,742,796	0.78
ASE Marketing Services Ltd.	16,985	959	0	959	–	(775)	(775)	(1.55)
J&R Holding Ltd. (Bermuda)	408	17,194,544	576	17,193,968	–	(34,173)	400,194	33,349,500
日月瑞（股）公司	4,653,000	5,525,137	416,286	5,108,852	132,456	(6,237)	113,474	0.24
日月榮股份有限公司	1,500,000	1,544,782	1,647	1,543,135	0	(252)	27,053	0.18
ASE Holding Ltd. (Bermuda)	7,412,363	6,207,000	1,096	6,205,903	0	(17,226)	(219,367)	(1,005.33)
ASE Investment (Labuan) Inc.	3,925,946	5,399,586	2,211,498	3,188,088	0	(266)	311,735	2.70
Omniquest Industrial Limited	604,666	547,245	0	547,245	0	(43)	(59,537)	(3.34)
日月光半導體（上海）有限公司	604,666	1,593,431	1,050,853	542,578	0	(62,567)	(61,419)	不適用
日月宏科技（股）公司	2,500,000	9,303,051	7,455,288	1,847,763	5,225,067	102,943	168,337	0.67
日月欣半導體（股）公司	6,350,000	13,466,123	4,609,487	8,856,636	6,018,146	217,025	182,837	0.29
環信通訊科技（股）公司	150,000	52,565	0	52,565	9,417	(5,286)	9,438	0.63
日月冠（股）公司	200,000	54,913	111,188	-56,275	0	0	(107,563)	(5.38)
ASE Holding Electronics (Philippines)	1,941,066	753,354	538,942	214,412	197,057	(124,543)	(226,163)	(93.31)
ASEP Realty Co. (Philippines)	7,744	36,643	31,912	4,731	0	0	55	2.75
ASE Test Ltd. (Singapore)	845,396	25,713,412	7,166,241	18,547,170	0	(50,983)	(132,963)	(1.34)
台灣福雷電子（股）公司	3,010,000	16,525,200	5,713,643	10,811,556	6,696,202	1,061,252	1,191,337	3.96
ASE Test Holdings,Ltd.	0（註1）	3,741,708	0	3,741,708	0	0	(883,439)	(176,687,755)
ASE Holdings (Singapore) Pte Ltd.	1,429,149	1,443,933	1,759	1,442,174	0	(247)	(247)	(0.00)
ASE Test Finance,Ltd.	0（註2）	5,105,943	7,179,527	(2,073,584)	0	(18,131)	(481,191)	(240,595,531)
ASE （Korea) Inc.	1,290,061	9,345,298	4,119,403	5,225,895	6,210,557	440,489	315,507	41.44
ASE Electronics (M) Sdn,Bhd.	2,114,978	6,884,801	1,580,035	5,304,767	5,445,841	(47,511)	(65,021)	(0.41)
ISE Labs,Inc.	892	3,015,927	1,440,018	1,575,910	1,307,494	(564,379)	(535,810)	(20.41)
集耀通訊科技股份有限公司	162,000	117,747	93,828	23,919	30,214	(119,095)	(137,534)	(8.49)
美商集程通訊科技股份有限公司	589	184,606	8,982	175,624	0	(154,489)	(105,849)	(6.10)
Grand Innovation Co., Ltd.	40,764	12,423	619	11,804	–	–	(7,729)	(6.44)
ASE Japan Co., Ltd.	19,074	19,079	5	19,074	–	–	–	–
環隆電氣股份有限公司	6,885,000	20,594,409	11,590,122	9,004,287	34,814,237	64,391	776,285	1.13
展毅公司	436,000	226,913	3,849	223,064	1	(388)	62	0.001
達碁公司	50,000	30,081	134	29,947	818	751	638	0.13
HHI公司	3,581,525	3,919,502	1,562	3,917,940	1,617	(9,941)	818,087	7.76
環隆墨西哥公司	1,819,054	1,853,950	649,455	1,204,495	4,749,294	169,051	125,326	0.21
環隆英國公司	1,536,893	219,347	64,689	154,658	187,387	63,581	92,967	3.66
環隆日本公司	101,696	1,561,912	1,460,053	101,859	6,375,204	93,834	90,338	14,115.31
RTH公司	1,083,677	1,292,335	64	1,292,271	0	(178)	186,971	5.86
環旭深圳公司	883,220	4,017,348	2,898,206	1,119,142	13,352,234	251,027	213,772	不適用
環旭上海公司	197,026	423,507	253,226	170,281	0	(26,775)	(26,613)	不適用
UI公司	3,431	2,801,488	2,002,475	799,013	17,151,003	263,570	263,655	2,607.86
USI-CA公司	322,715	110,068	7,166	102,902	182,823	9,433	9,556	1.01
USI@Work	5,096	14,046	4,343	9,703	48,654	3,286	1,469	9.79
UHI公司	260,822	132,471	35	132,436	54,291	54,014	34,957	4.55
宏璟建設股份有限公司	4,758,090	7,585,655	3,132,774	4,452,881	795,357	(415,951)	(483,811)	(1.07)
宏璟新投資股份有限公司	250,000	68,282	69	68,213	31,408	29,397	29,397	1.18
福華工程股份有限公司	117,200	342,720	184,743	157,977	4,701	(29,434)	(6,341)	(54.2)
宏錦光股份有限公司	1,430,000	1,863,606	376,493	1,487,113	150,381	21,600	5,922	0.04
宏璟管理顧問股份有限公司	1,000	7,142	9,935	(2,793)	–	–	2	0.02
日月光商務旅館股份有限公司	195,000	163,959	155,568	8,391	96,312	(67,734)	(67,805)	(3.48)
日月光開發育樂股份有限公司	10,000	11,182	25	11,157	–	–	83	0.08

註1：設立資本額為美金5元。

註2：設立資本額為美金2元。

（七）關係企業合併財務報表

日月光半導體製造股份有限公司
關係企業合併財務報表會計師複核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司民國九十二及九十一年度之關係企業合併財務報表，業經本會計師依照「關係企業合併財務報表複核要點」，採行必要複核程序予以複核竣事。由於本會計師並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開關係企業合併財務報表之整體表示查核意見。

依本會計師之複核結果，並未發現上開日月光半導體製造股份有限公司民國九十二及九十一年度之關係企業合併財務報表有違反「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」、相關法令規定及一般公認會計原則而需作重大修正或調整之情事。

勤業眾信會計師事務所

會計師 曾光敏



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 陳政弘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中華民國九十三年二月六日

日月光半導體製造股份有限公司
關係企業合併資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元
（惟每股面額為元）

代碼	資產	九十二年底 金額	%	九十一年底 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二）	$ 9,909,865	7	$ 11,489,376	9
1110	短期投資（附註二、三及二十五）	4,068,979	3	3,091,374	2
1120	應收票據	267,310	–	140,065	–
1140	應收帳款（附註四及二十四）	20,852,244	15	15,157,147	12
1160	其他應收款（附註二十四）	354,043	–	386,864	–
1210	存貨（附註二及五）	8,270,629	6	6,220,047	5
1221	待售房地（附註二、六及二十五）	870,522	1	1,630,735	1
1223	待建土地（附註二、七及二十五）	2,258,528	1	2,443,528	2
1286	遞延所得稅資產（附註二及二十二）	1,305,223	1	1,163,857	1
1291	質押定期存款（附註二十五）	322,426	–	583,743	1
1260	預付款項及其他	966,236	1	1,066,601	1
11XX	流動資產合計	49,446,005	35	43,373,337	34
	長期投資（附註二、八及二十五）				
142101	採權益法之長期投資	1,512,516	1	1,596,911	1
142102	採成本法之長期投資	3,326,938	3	3,448,896	3
1425	預付長期投資款	12,000	–	–	–
1428	其他長期投資	50,000	–	–	–
14XX	長期投資合計	4,901,454	4	5,045,807	4
1440	其他金融資產	3,140	–	–	–
	固定資產（附註二、九、十五及二十五）				
1501	土地及土地改良	4,739,907	3	4,821,517	4
1521	建築物及附屬設備	19,829,204	14	18,075,412	14
1531	機器設備	86,778,672	62	75,921,251	59
1551	運輸設備	130,108	–	123,981	–
1561	生財器具	2,650,468	2	2,418,443	2
1611	租賃資產及租賃改良	1,026,848	1	855,487	1
15X1	成本合計	115,155,207	82	102,216,091	80
15X8	重估增值	6,863	–	6,863	–
15XX		115,162,070	82	102,222,954	80
15X9	減：累積折舊	51,101,704	36	41,848,842	33
		64,060,366	46	60,374,112	47
1671	在建工程	3,353,328	2	1,683,387	1
1672	在途機器及預付設備款	6,273,440	4	5,796,788	5
15XX	固定資產合計	73,687,134	52	67,854,287	53
	其他資產				
1810	出租資產－淨額（附註二及二十五）	1,109,260	1	1,189,472	1
1820	存出保證金（附註二十五）	387,692	–	191,517	–
1830	遞延費用（附註二）	1,910,618	2	1,421,834	1
1860	遞延所得稅資產（附註二及二十二）	2,789,416	2	1,701,099	1
1843	其他長期應收款－淨額（附註十）	–	–	–	–
1888	其他（附註九）	461,236	–	274,959	–
18XX	其他資產合計	6,658,222	5	4,778,881	3
1881	合併借項（附註二及十一）	5,806,776	4	6,972,950	6
1XXX	資產總計	$ 140,502,731	100	$ 128,025,262	100

代碼	負債及股東權益	九十二年底 金額	%	九十一年底 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十二及二十五）	$ 8,901,117	6	$ 8,233,668	6
2110	應付短期票券（附註十二及十三）	3,018,666	2	4,395,588	3
2140	應付票據及帳款（附註二十四）	12,522,520	9	8,667,717	7
2160	應付所得稅	391,008	–	336,265	–
2170	應付費用（附註十八）	2,669,376	2	2,371,618	2
2224	應付設備款	4,392,340	3	4,494,828	4
2262	預收房地款（附註二及六）	13,415	–	1,978	–
2272	長期借款一年內到期部分（附註十五及二十五）	5,625,389	4	6,934,967	5
2273	應付長期投資款一年內到期部分（附註二及十六）	2,309,960	2	962,758	1
2288	應付租賃款一年內到期部分（附註二及十七）	164,612	–	193,714	–
2298	其他	975,519	1	628,436	1
21XX	流動負債合計	40,983,922	29	37,221,537	29
	長期附息負債				
2410	應付公司債（附註二及十四）	6,861,232	5	5,179,793	4
2420	長期借款（附註十五及二十五）	26,429,085	19	22,892,623	18
2443	應付長期投資款（附註二及十六）	–	–	2,364,360	2
2446	應付租賃款（附註二及十七）	105,517	–	273,660	–
24XX	長期附息負債合計	33,395,834	24	30,710,436	24
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及十八）	840,382	1	590,904	–
2860	遞延所得稅負債（附註二及二十二）	34,674	–	35,658	–
2883	其他股權	20,107,407	14	20,017,714	16
2888	其他（附註二及八）	17,910	–	18,347	–
28XX	其他負債合計	21,000,373	15	20,662,623	16
2XXX	負債合計	95,380,129	68	88,594,596	69
	股東權益（附註二及十九）				
3110	普通股股本－每股面額10元，九十二及九十一年底額定分別為5,150,000千股及4,550,000千股；發行分別為3,580,280千股及3,254,800千股	35,802,800	25	32,548,000	26
	資本公積				
3211	股票溢價	14,777	–	3,171,933	2
3220	庫藏股票交易	220,735	–	–	–
3270	長期投資	3,811,262	3	3,753,594	3
32XX	資本公積合計	4,046,774	3	6,925,527	5
33XX	保留盈餘	3,808,436	3	1,173,564	1
	其他調整項目				
3410	長期股權投資未實現跌價損失	(68,833)	–	(423,620)	–
3420	累積換算調整數	1,559,599	1	1,847,021	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(16,137)	–	–	–
34XX	其他調整項目合計	1,474,629	1	1,423,401	1
3510	庫藏股票－九十二及九十一年底分別為718千股及164,442千股	(10,037)	–	(2,639,826)	(2)
3XXX	股東權益合計	45,122,602	32	39,430,666	31
	負債及股東權益總計	$ 140,502,731	100	$ 128,025,262	100

後附之附註係本關係企業合併財務報表之一部分。

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

日月光半導體製造股份有限公司
關係企業合併損益表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
（惟每股盈餘（純損）為元）

代碼		九十二年度 金額	%	九十一年度 金額	%
	營業收入（附註二及二十四）				
4110	銷貨收入	$ 99,727,751	101	$ 78,373,873	101
4190	減：銷貨退回及折讓	1,493,276	2	1,073,080	1
4100	銷貨收入淨額	98,234,475	99	77,300,793	100
4510	營建收入淨額	775,486	1	235,118	–
4000	營業收入淨額	99,009,961	100	77,535,911	100
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註二十一）	83,694,068	84	67,201,503	87
5500	營建成本	1,050,033	1	286,578	–
5000	營業成本合計	84,744,101	85	67,488,081	87
5910	營業毛利	14,265,860	15	10,047,830	13
	營業費用（附註二、十一、二十一及二十四）				
6100	推銷費用	2,449,705	3	1,950,627	3
6200	管理及總務費用	5,047,253	5	5,821,846	8
6300	研究發展支出	3,163,175	3	2,609,071	3
6000	合計	10,660,133	11	10,381,544	13
6900	營業利益（損失）	3,605,727	4	(333,714)	–
	營業外收入及利益				
7110	利息收入（附註二十八）	124,769	–	412,659	1
7140	處分投資利益	624,454	1	146,738	–
7480	其他（附註二十四）	477,382	–	889,186	1
7100	合計	1,226,605	1	1,448,583	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用（附註二及九）	1,667,402	2	2,305,243	3
7560	兌換損失－淨額（附註二及二十八）	284,536	–	277,548	–
7521	採權益法認列之投資損失（附註二及八）	145,798	–	474,486	1
7522	採成本法認列之持久性跌價損失	55,000	–	158,041	–
7530	已實現長期股權投資損失（附註十九）	354,787	–	–	–
7880	其他	573,664	1	758,939	1
7500	合計	3,081,187	3	3,974,257	5
7900	稅前利益（損失）	1,751,145	2	(2,859,388)	(3)
8110	所得稅利益（附註二及二十二）	1,255,113	1	1,120,039	1
8900	列記非常損失前純益（損）	3,006,258	3	(1,739,349)	(2)
9200	非常損失（九十一年度係加計所得稅利益11,538千元後之淨額）（附註十四）	(75,668)	–	(34,613)	–
9400	其他股權純損（益）	(187,794)	–	1,902,997	2
9600	合併純益	$ 2,742,796	3	$ 129,035	–

代碼		九十二年度		九十一年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘（純損）（附註二十三）				
	列計非常損失前純益（損）	$ 0.51	$ 0.80	($ 0.24)	$ 0.05
	非常損失	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.01)
	純益（損）	$ 0.49	$ 0.78	($ 0.25)	$ 0.04
9850	稀釋每股盈餘（純損）				
	列計非常損失前純益（損）	$ 0.50	$ 0.80	($ 0.24)	$ 0.05
	非常損失	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.01)
	純益（損）	$ 0.48	$ 0.78	($ 0.25)	$ 0.04

後附之附註係本合併關係企業財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

二. 內部控制制度執行狀況

（一）內部控制聲明書

日月光半導體製造股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：九十三年三月二十三日

本公司民國92年1月1日至92年12月31日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

1. 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

2. 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

3. 本公司係依據財政部證券暨期貨管理委員會訂頒「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

4. 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

5 本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度（含對子公司之監理），包括與營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

6. 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

7. 本聲明書業經本公司民國93年3月23日董事會通過，出席董事5人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

日月光半導體製造股份有限公司

董事長：張虔生  簽章

總經理：張洪本  簽章

（二）委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情事。

三. 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見：無。

四. 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無

五. 最近年度及截至年報刊印日止子公司取得及處分本公司股票之情形及其設定質權之情形

92年12月31日　單位:新台幣仟元;股;%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股%	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資(損)益	截至年底止持有股數及金額	設定質權情形(註)	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
日月新投資(股)公司	1,000,000	自有資金	100%	92年	— —	142,368,827股 $ 2,475,856	$ 492,447	— $ —	—	—	—
日月興投資(股)公司	1,000,000	自有資金	100%	92年	— —	21,420,317股 $ 374,668	($ 626,498)	— $ —	—	—	—
台灣福雷電子(股)公司	3,000,000	自有資金	50.27%	92年	65,271 —	— —	—	持股數:717,984股 帳面金額 $21,278 轉列庫藏股金額 $19,696	—	—	—

註:對本公司之經營結果及財務狀況並無影響。

六. 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

(一) 股東會之重要決議

召開日期	重要決議
92.06.19 召開92年 股東會	1. 承認本公司九十一年度決算表冊案。 2. 承認本公司九十一年度盈餘分派案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 訂定本公司「背書保證作業程序」案。 6. 修訂本公司公司章程中額定股本修訂案。 7. 訂定本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 8. 提請股東會授權董事會於適當時機選擇以現金增資參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資或發行國內外可轉換公司債募集資金案。 9. 提請股東會授權董事會視於考量資金募集急迫性,得以私募方式辦理上開現金增資參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資或發行國內外可轉換公司債募集資金案。 10. 修訂本公司「公司章程」案。

（二）董事會之重要決議

開會日期	重要決議
92.01.16	本公司以新台幣500,000仟元參與日月欣半導體股份有限公司之現金增資案。
92.03.28	1. 為承認本公司民國九十一年度營業報告書及財務報表提請監察人查核，並民國九十二年股東常會報告案。 2. 為請承認本公司民國九十一年度盈餘分派議案，提請監察人查核，並提民國九十二年股東常會報告案。 3. 為本公司截至民國九十一年十二月三十一日止之背書保證總額及資金貸與他人金額，並提民國九十二年股東常會報告案。 4. 修訂本公司「第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」，並提民國九十二年股東常會報告案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並提請民國九十二年股東常會討論案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，並提請民國九十二年股東常會討論案。 7. 訂定本公司「背書保證作業程序」，原本公司之「對外背書保證辦法」停止適用，並提請民國九十二年股東常會討論案。 8. 修訂本公司章程中額定股本，並提請民國九十二年股東常會討論。 9. 為配合擴廠計劃及改善資本結構，以民國九十一年度應分派之股東紅利新台幣97,644,000元，另自股票溢價資本公積中提撥新台幣3,157,156,000元，合計新台幣3,254,800,000元，計325,480,000股，每股面額新台幣10元，轉作資本，並提請民國九十二年股東常會討論案。 10. 提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程、相關法令規定及說明段之各項辦理原則，選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資或發行國內外可轉換公司債之方式籌措資金案。 11. 本公司於辦理上開現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資或發行國內外可轉換公司債時，如因考量實際市場狀況及為確保資金募集完成之可行性與急迫性，以支應資金需求，擬提請股東會授權董事會得以私募方式募集資金，並提請民國九十二年股東常會討論案。 12. 修訂本公司「公司章程」，並提請民國九十二年股東常會討論案。 13. 為本公司董事任期已屆滿，並提請民國九十二年股東常會進行改選案。 14. 本公司民國九十二年股東常會召開之日期、地點及議程。
92.04.15	決議擬與宏璟建設股份有限公司簽訂合建契約以合作興建智慧型廠辦大樓。
92.04.18	聘任本公司營運長張虔生先生擔任執行長（CEO）案。
92.05.27	決議為本公司之子公司ASE TEST FINANCE LIMITED提供背書保證以向花旗銀行（聯貸主辦行）申請聯貸貸款美元壹億伍仟萬元。
92.06.20	1. 選舉張虔生為董事長及張洪本為副董事長。 2. 變更本公司與日月新投資股份有限公司及日月興投資股份有限公司合併案之合併基準日為九十二年七月一日。
92.07.30	為配合子公司ASE Investment（Labuan）Inc.支付併購摩托羅拉韓國廠股權之期款，決議通過ASE Holding Ltd.再對ASE Investment（Labuan）Inc.增加投資USD13,913,200。
92.08.01	訂定增資發行新股配股基準日及增資基準日為九十二年八月三十日。
92.08.05	本公司為支應償還銀行借款之資金需求，決議募集與發行海外可轉換公司債，發行總額暫訂以美金2億元為上限。
92.08.22	通過為本公司民國九十一年度第二次員工認股權憑證之發行數量及認股權人名冊。
92.10.27	決議與華通電腦股份有限公司合資設立IC基板公司，新公司名稱暫定為日月光華通科技股份有限公司。
92.10.28	1. 決議採吸收合併方式與日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司進行合併，以本公司為合併後之存續公司，日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司為消滅公司。日月欣半導體股份有限公司以普通股股票1股換發本公司普通股股票0.85股，日月宏科技股份有限公司以普通股股票1股換發本公司普通股股票0.5股，本公司預計因本合併案增加發行282,315,437股予消滅公司股東。 2. 決議為配合辦理本合併案增資發行新股282,315,437股。

開會日期	重要決議
92.11.19	1. 決議以現金增資發行普通股不超過300,000仟股，用於參與發行海外存託憑證以籌措資金。 2. 為因應本公司九十二年度現金增資參與發行海外存託憑證發行規模之需要，決議邀請本公司股東香港商微電子國際公司（下稱「售股股東」），總計提撥不超過本公司普通股45,000,000股之現有股份，共同參與本公司此次參與發行海外存託憑證之計劃。 3. 為支應償還銀行借款之資金需求，決議募集與發行海外可轉換公司債籌措資金，發行總額暫定以美金150,000仟元為上限。
92.12.19	為因應業務需求擬募集中長期資金決議發行有擔保公司債，發行總額為新台幣貳拾柒億伍仟萬元整。
92.12.30	1. 為配合提昇整體競爭力所導入之ERP系統，決議自93年1月1日起將原物料存貨成本計價方式由原採用之月加權平均法改為移動平均法。 2. 決議轉投資孫公司ASE Holding Electronics（Philippines）Inc. 結束營業。
93.02.02	決議透過子公司J&R Holding Ltd.購買NEC Yamagata, Ltd.位於山形縣之IC封裝測試廠，並於民國九十三年二月三日與J&R Holding Ltd.、NEC Electronics Corporation及NEC Yamagata, Ltd.共同簽署股權買賣合約並與NEC Electronics Corporation簽署封裝測試服務合約。
93.03.03	為因應營運需要，決議將保留公司債可轉換股份金額由新台幣30億元擬提高為45億元。
93.03.24	1. 為請承認本公司民國九十二年度營業報告書及財務報表，提請監察人查核，並提報民國九十三年股東常會報告案。 2. 為請承認本公司民國九十二年度盈餘分派議案，提請監察人查核，並提報民國九十三年股東常會報告案。 3. 為本公司截至民國九十二年十二月三十一日止之背書保證總額及資金貸與他人金額，並提報民國九十三年股東常會報告案。 4. 為本公司擬以盈餘及員工紅利轉增資發行新股，並提請民國九十三年股東常會討論案。 5. 本公司為支應未來產能擴充計劃 、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司長期發展之資金需求，並使資金募集管道更形多元化及彈性化，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程 、相關法令規定及說明段之各項辦理原則，選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資或發行國內外可轉換公司債之方式籌措資金，並提請民國九十三年股東常會討論案。 6. 本公司於辦理上開現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資或發行國內外可轉換公司債時，如因考量實際市場狀況及為確保資金募集完成之可行性與急迫性，以支應資金需求，擬提請股東會授權董事會得以私募方式募集資金，並提請民國九十三年股東常會討論案。 7. 擬請股東會同意解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制。 8. 修訂本公司「公司章程」並提請民國九十三年股東常會討論案。 9. 本公司監察人任期屆滿，並提請民國九十三年股東常會進行改選案。 10. 本公司民國九十三年股東常會召開之日期、地點及議程。

七. 最近年度及截至年報刊印日止，公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

八. 其他必要補充說明事項：無。

玖. 其他事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

92.12.19勤衆（高）9200775號

受文者：日月光半導體製造股份有限公司

主旨：貴公司發生證券交易法第三十六條第二項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，本會計師依發行人募集與發行有價證券處理準則第五條之規定，就其對財務報告之影響表示意見，敬請 查照。

說明：

一. 貴公司於民國九十二年十月二十八日與子公司日月欣半導體股份有限公司（日月欣公司）及日月宏科技股份有限公司（日月宏公司）簽訂合併契約。依證券交易法第三十六條第二項第二款及證券交易法施行細則第七條之規定，係屬對股東權益或證券價格有重大影響之事項， 貴公司就此事項對九十二年前三季財務報告影響之聲明如附件。

二. 依該契約之規定，此合併案採取吸收合併方式，以 貴公司為存續公司，日月欣公司及日月宏公司則分別因合併而解散。合併基準日預計訂為九十三年七月一日，約定股份換發比例分別為1股日月欣公司股份換發 貴公司股份0.85股及1股日月宏公司股份換發貴公司股份0.5股。 貴公司將因此合併案而預計增發282,315千股之普通股。

三. 本會計師依發行人募集與發行有價證券處理準則第五條之規定，複核上述合併契約及其他有關文件並與 貴公司相關人員討論，認為此事項如同 貴公司之聲明，對 貴公司九十二年前三季財務報告並無重大影響。

勤業衆信會計師事務所

會計師 曾光敏



日精月進 世紀之光

2004年我們歡喜慶祝日月光集團的20歲生日
日月光以堅定的信念與亮麗成績許諾未來：
致力創新，創造價值，持續領先！

日月光半導體製造股份有限公司

負責人：張虔生

中華民國九十三年三月二十六日　刊印

Maximum with Minimum

日月光半導體製造股份有限公司
www.aseglobal.com